Panel PC 300

Anwenderhandbuch

Version: 1.20 (Oktober 2008)

Best. Nr.: MAPPC300-GER

Alle Angabe entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, markenoder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines Kapitel 2: Technische Daten Kapitel 3: Inbetriebnahme **Kapitel 4: Software** Kapitel 5: Normen und Zulassungen Kapitel 6: Zubehör

Kapitel 7: Wartung und Instandhaltung Anhang A Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Bestellnummernindex Stichwortverzeichnis

Kapitel 1: Allgemeines	13
1. Handbuchhistorie	
2. Sicherheitshinweise	14
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	14
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen	
2.2.1 Verpackung	
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung	
2.3 Vorschriften und Maßnahmen	
2.4 Transport und Lagerung	
2.5 Montage	
2.6 Betrieb	
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	16
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase	16
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme	
3. Gestaltung von Sicherheitshinweisen	
4. Richtlinien	
5. Bestellnummern	
5.1 Panel PC 300	18
5.2 Automation Panel 900	18
5.2.1 Automation Panel 10,4" VGA	18
5.2.2 Automation Panel 12,1" SVGA	18
5.2.3 Automation Panel 15" XGA	
5.2.4 Automation Panel 17" SXGA	19
5.2.5 Automation Panel 19" SXGA	
5.3 Software	19
5.4 Zubehör	20
Kapitel 2: Technische Daten	21
1. Einleitung	21
1.1 Features	
1.2 Aufbau / Konfiguration	
2. Gesamtgerät	
2.1 Umgebungstemperaturen	
2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben	
2.3 Leistungsverbrauch	
2.4 Allgemeine Geräteschnittstellen	
2.4.1 Ethernetanschluss - ETH1	26
2.4.2 Ethernetanschluss - ETH2	
2.4.3 Spannungsversorgung +24 VDC	
2.4.4 Status LEDs	28
2.4.5 Power Taster	
2.4.6 Reset Taster	29
2.4.7 Serielle Schnittstelle COM	29
2.4.8 CompactFlash Slot CF	
2.4.9 Batterie	
2.4.10 USB Anschluss (über AP900)	32

3. Einzelkomponenten	
3.1 Panel PC 300 Einschub	
3.1.1 Variante mit 256 MB SDRAM 5PC310.L800-00	
3.1.2 Variante mit 512 MB SDRAM 5PC310.L800-01	
3.2 Automation Panel 900	37
3.2.1 Automation Panel 5AP920.1043-01	37
3.2.2 Automation Panel 5AP980.1043-01	43
3.2.3 Automation Panel 5AP981.1043-01	
3.2.4 Automation Panel 5AP982.1043-01	
3.2.5 Automation Panel 5AP920.1214-01	61
3.2.6 Automation Panel 5AP920.1505-01	67
3.2.7 Automation Panel 5AP980.1505-01	73
3.2.8 Automation Panel 5AP981.1505-01	79
3.2.9 Automation Panel 5AP920.1706-01	
3.2.10 Automation Panel 5AP920.1906-01	91
Kapitel 3: Inbetriebnahme	. 97
1. PPC300 Montage in einem Automation Panel 900	97
1.1 Hardwarekompatibilitäten mit Automation Panel 900	97
1.2 Fixierung im Automation Panel 900	98
2. Montagevorschriften eines Automation Panel 900	
2.1 Einbaulagen	100
3. Kabelfixierung	
4. Funktionserdelasche	102
5. Tasten- und Ledkonfigurationen	103
5.1 Automation Panel 10,4" VGA	104
5.1.1 Automation Panel 5AP981.1043-01	
5.1.2 Automation Panel 5AP982.1043-01	105
5.1.3 Automation Panel 5AP980.1043-01	106
5.2 Automation Panel 15" XGA	107
5.2.1 Automation Panel 5AP981.1505-01	107
5.2.2 Automation Panel 5AP980.1505-01	. 108
Kapitel 4: Software	
1. BIOS Einstellungen	
1.1 Allgemeines	
1.2 Summary Screen	
1.3 BIOS Einstellungen	112
1.3.1 Main Menu	112
1.3.2 Time	113
1.3.3 Date	114
1.3.4 Motherboard Device Configuration	115
1.3.5 Memory and Cache Optimization	123
1.3.6 System Clock/PLL Configuration	
1.3.7 Power Management	
1.3.8 Device Information	

	1.3.9 Miscellaneous Configuration	128
	1.3.10 Boot Order	129
	1.3.11 Load Defaults	131
	1.3.12 Save Values Without Exit	132
	1.3.13 Exit Without Save	133
	1.3.14 Save values and Exit	
	1.4 BIOS Defaultwerte	
	1.4.1 Motherboard Device Configuration	
	1.4.2 Memory and Cache Optimization	
	1.4.3 System Clock/PLL Configuration	
	1.4.4 Power Management	
	1.4.5 Device Information	
	1.4.6 Miscellaneous Configuation	
	1.4.7 Boot Order	
	1.4.8 Wiederherstellen der BIOS Defaultwerte	137
	1.5 BIOS und Firmware (MTCX) Upgrade	
	1.5.1 BIOS Upgrade Vorgang	
	1.5.2 MTCX Firmware Upgrade	
	1.5.3 User Boot Logo	
	1.6 CMOS Backup	
	Windows CE	
	2.1 Allgemeines	
	2.1.1 Vorteile / Features	
	2.2 Unterschiede der verschiedenen CE Versionen (Pro - ProPlus)	
	2.3 Installation	
	2.3.1 B&R eMbedded OS Installer	
3.	Windows XP embedded	
	3.1 Allgemeines	143
	3.2 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)	
	3.3 Installation	
	Automation Device Interface - ADI	
K	apitel 5: Normen und Zulassungen	147
	Gültige europäische Richtlinien	
	Normenübersicht	
	Störaussendungsanforderungen (Emission)	
	3.1 Netzgebundene Emission	
	3.1 Netzgebundene Emission	148
	Störfestigkeitsanforderung (Immunität)	
	4.1 Elektrostatische Entladung (ESD)	
	4.2 Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)	
	4.3 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)	
	4.4 Stoßspannungen (Surge)	
	4.5 Leitungsgeführte Störgrößen	
	4.6 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen	
	4.7 Spannungseinbrüche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen	154

5. Mechanische Bedingungen 1. Vibration Betrieb 5. 2. Vibration Transport (verpackt) 1. S. Schock Betrieb 5. 4. Schock Transport (verpackt) 5. Kippfallen 5. 5. Kippfallen 5. Kippfallen 5. 6. Klimabedingungen 6. Il Worst Case Betrieb 6. 1. Worst Case Betrieb 6. Trockene Wärme 6. 2. Trockene Kälte 6. Freier Fall (verpackt) 6. 4. Große Temperaturschwankungen 6. Femperaturschwankungen im Betrieb 6. 5. Temperaturschwankungen im Betrieb 6. Feuchte Wärme konstant (Lager) 6. 7. Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Iterdungswiderstand 7. 2. Hochspannung 7. Restspannung 7. 3. Restspannung 7. Ableitstrom 7. 5. Überlast 7. Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8. Sonstige Prüfungen 8. 1. Schutzart 8. Sonstige Prüfungen 8. 1. Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. Teln3 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2. 1. Allgemeines 2. Bestelldaten 3. 1 Technische Daten 3. Technische Daten 3. 2 Technische Daten 3. 1 Bestelldaten 3. 2 Technische Daten <th>4.8 Gedampite Schwingungen</th> <th> 155</th>	4.8 Gedampite Schwingungen	155
5.2 Vibration Transport (verpackt) 5.3 Schock Betrieb 5.4 Schock Transport (verpackt) 5.5 Kippfallen 5.6 Freier Fall (verpackt) 6. Klimabedingungen 6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Kälte 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 5.2 Honsiche Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5.2 Wontage 6. USB Memory Stick 6. 1 Allgemeines		
5.3 Schock Betrieb 5.4 Schock Transport (verpackt) 5.5 Kippfallen 5.6 Freier Fall (verpackt) 6.6 Freier Fall (verpackt) 6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Wärme 6.3 Trockene Kälte 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
5.3 Schock Betrieb 5.4 Schock Transport (verpackt) 5.5 Kippfallen 5.6 Freier Fall (verpackt) 6.6 Freier Fall (verpackt) 6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Wärme 6.3 Trockene Kälte 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines	5.2 Vibration Transport (verpackt)	157
5.5 Kippfallen 5.6 Freier Fall (verpackt) 6. Klimabedingungen 6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Wärme 6.3 Trockene Kälte 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6. 1 Allgemeines	5.3 Schock Betrieb	157
5.6 Freier Fall (verpackt) 6. Klimabedingungen 6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Wärme 6.5 Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick	5.4 Schock Transport (verpackt)	157
5.6 Freier Fall (verpackt) 6. Klimabedingungen 6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Wärme 6.5 Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick	5.5 Kippfallen	158
6. Klimabedingungen 6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Käite 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5.1 Bestelldaten 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
6.1 Worst Case Betrieb 6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Kälte 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5.2 Wontage 6. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
6.2 Trockene Wärme 6.3 Trockene Kälte 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6.0 USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6.0 USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
6.3 Trockene Kälte 6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.3 Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
6.4 Große Temperaturschwankungen 6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb 6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
6.6 Feuchte Wärme zyklisch 6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager) 7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3.1 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
7. Sicherheit 7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
7.1 Erdungswiderstand 7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3.1 Bestelldaten 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
7.2 Hochspannung 7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Frsatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
7.3 Restspannung 7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
7.4 Ableitstrom 7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
7.5 Überlast 7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7.6 Bauteildefekt 7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schniittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
7.7 Spannungsbereich 8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
8. Sonstige Prüfungen 8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
8.1 Schutzart 8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen 10. Internationale Zulassungen 11. Übersicht 11. Übersicht 12. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 12.1 Allgemeines 12.2 Bestelldaten 12.3 Technische Daten 13. Ersatz CMOS Batterien 13.1 Bestelldaten 13.2 Technische Daten 14. Einschubstreifenvordrucke 15. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 15.1 Bestelldaten 15.2 Montage 16. USB Memory Stick 16.1 Allgemeines 17.		
8.2 Verschmutzungsgrad 9. Internationale Zulassungen Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
 Wapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines 		
Kapitel 6: Zubehör 1. Übersicht 2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
1. Übersicht	7. Internationale Zalassungeri	100
1. Übersicht	V	407
2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker 2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
2.1 Allgemeines 2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
2.2 Bestelldaten 2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
2.3 Technische Daten 3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines	<u> </u>	
3. Ersatz CMOS Batterien 3.1 Bestelldaten 3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines	2.2 Bestelldaten	169
3.1 Bestelldaten 1 3.2 Technische Daten 1 4. Einschubstreifenvordrucke 1 4.1 Bestelldaten 1 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 1 5.1 Bestelldaten 1 5.2 Montage 1 6. USB Memory Stick 1 6.1 Allgemeines 1		
3.2 Technische Daten 4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines	3. Ersatz CMOS Batterien	171
4. Einschubstreifenvordrucke 4.1 Bestelldaten 5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines	3.1 Bestelldaten	171
4.1 Bestelldaten		
5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) 5.1 Bestelldaten 5.2 Montage 6. USB Memory Stick 6.1 Allgemeines		
5.1 Bestelldaten		
5.2 Montage		
6. USB Memory Stick	5.1 Bestelldaten	174
6.1 Allgemeines	5.2 Montage	174
	6. USB Memory Stick	
	o. o o =o	175
6.2 Bestelldaten		

6.3 Technische Daten	
6.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung	177
6.4 Lieferumfang	177
6.5 Erzeugung eines bootbaren (bootable) USB Memory Sticks	178
6.5.1 Was wird benötigt?	178
6.5.2 Vorgangsweise	178
7. USB Media Drive - 5MD900.USB2-01	179
7.1 Features	179
7.2 Technische Daten	180
7.3 Abmessungen	182
7.4 Abmessungen mit Frontklappe	
7.4.1 Einbau in Wanddurchbrüche	
7.5 Lieferumfang	
7.6 Schnittstellen	
7.7 Montage	
7.7.1 Einbaulagen	184
7.8 Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive	185
7.8.1 Technische Daten	
7.8.2 Abmessungen	
7.8.3 Montage	
7.8.4 Einbau in Wanddurchbrüche	
8. CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	
8.1 Allgemeines	
8.2 Bestelldaten	
8.3 Technische Daten	
8.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung	
8.4 Abmessungen	
8.5 Lebensdauerberechnung	
olo Eddollouduoi bolloulling	
Kapitel 7: Wartung und Instandhaltung	199
1. Batteriewechsel	
2. Reinigung	
Vermeidung des Einbrenneffekts bei LCD / TFT Monitoren	
3.1 Was kann man dagegen tun?	
4. Austausch der Leuchtstofflampen	
4.1 Allgemeines	
4.2 Vorgangsweise	
4.2.2 Vorgangsweise Automation Panel 10,4"	204
4.2.4 Vorgangsweise Automation Panel 15"	206
Anhang A	200
1. Touch Screen - Elo Accu Touch	
1.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung	
1.2 Kalibrierung	210

1.2.1 Windows CE	210
1.2.2 Windows XP embedded	210
1.3 Reinigung	
2. Dekorfolie	
3. Blickwinkel	213
4. B&R Key Editor	214
5. B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit	
5.1 Installation	217
6. Glossar	218

Kapitel 1 • Allgemeines

Information:

B&R ist bemüht den gedruckten Anwenderhandbuchstand so aktuell wie möglich zu halten. Eine eventuell neuere Version des Anwenderhandbuches kann daher auch immer zuerst in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

1. Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderungen
1.00	18.10.2007	- Erste Version
1.10	31.03.2008	 - Vibration / Schockangaben überarbeitet. - Temperaturangaben -45° / +45° und mit Rittalgehäuse ergänzt.
1.20	20.10.2008	Compact Flash auf CompactFlash geändert. Anpassung im Normenbereich. Ergänzung der 512 MB RAM Panel PC 300 Variante 5PC310.L800-01. B&R Key Editor aktualisiert. ADI Development Kit hinzugefügt.

Tabelle 1 : Handbuchhistorie

2. Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- Elektrische Baugruppen mit Gehäuse
 - ... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse
 - ... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen.
 - Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!

- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

• ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).

Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

Allgemeines • Sicherheitshinweise

2.5 Montage

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreie Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Allgemeines • Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

3. Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Sachschäden.
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 2: Gestaltung von Sicherheitshinweisen

4. Richtlinien



Alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) wurden nach den geltenden europäischen Bemaßungsnormen erstellt!

5. Bestellnummern

5.1 Panel PC 300

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5PC310.L800-00	AP Slide-In PC LX800 256 MB RAM 256 MB SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); 2 x ETH 10/100; RS232; Batterie; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	siehe Seite 33
5PC310.L800-01	AP Slide-In PC LX800 512 MB RAM 512 MB SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); 2 x ETH 10/100; RS232; Batterie; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	siehe Seite 35

Tabelle 3: Bestellnummern Panel PC 300 Steckkarten

5.2 Automation Panel 900

5.2.1 Automation Panel 10,4" VGA

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5AP920.1043-01	AP920 TFT C VGA 10,4in T Automation Panel AP920; 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 2 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 37
5AP980.1043-01	AP980 TFT C VGA 10,4in F T Automation Panel AP980, 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 10 Soft-keys und 28 Funktionstasten; 2 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 43
5AP981.1043-01	AP981 TFT C VGA 10,4in F T Automation Panel AP981 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 10 Soft-keys; 28 Funktions- und 20 Systemtasten; 2 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 49
5AP982.1043-01	AP982 TFT C VGA 10,4in F T Automation Panel AP982 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 44 Funktions- und 20 Systemtasten; 2 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 55

Tabelle 4: Bestellnummern Automation Panel 10,4" VGA

5.2.2 Automation Panel 12,1" SVGA

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5AP920.1214-01	AP920 TFT C SVGA 12.1in T Automation Panel AP920; 12,1" SVGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 3 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 61

Tabelle 5: Bestellnummern Automation Panel 12,1" SXGA

5.2.3 Automation Panel 15" XGA

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5AP920.1505-01	AP920 TFT C XGA 15in T Automation Panel AP920; 15" XGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 3 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 67
5AP980.1505-01	AP980 TFT C XGA 15in F T Automation Panel AP980, 15" XGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 12 Soft-keys und 20 Funktionstasten; 3 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 73
5AP981.1505-01	AP981 TFT C XGA 15in F T Automation Panel AP981 15" XGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 12 Soft-keys; 20 Funktions- und 92 Systemtasten; 3 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 79

Tabelle 6: Bestellnummern Automation Panel 15" XGA

5.2.4 Automation Panel 17" SXGA

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5AP920.1706-01	AP920 TFT C SXGA 17in T Automation Panel AP920; 17" SXGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 3 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 85

Tabelle 7: Bestellnummern Automation Panel 17" SXGA

5.2.5 Automation Panel 19" SXGA

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5AP920.1906-01	AP920 TFT C SXGA 19in T Automation Panel AP920; 19" SXGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 3 USB 2.0 Schnittstellen; Einschub für Automation Panel Link bzw. PPC300; Schutzart IP65 (frontseitig). Versorgung 24 VDC.	siehe Seite 91

Tabelle 8: Bestellnummern Automation Panel 19" SXGA

5.3 Software

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5SWWCE.0523-ENG	WinCE5.0 Pro PPC300 LX800 Microsoft Windows CE 5.0 Professional englisch inklusive Lizenz; für PPC300 Geräte 5PC310.L800-00 und 5PC310.L800-01, CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MB).	siehe Seite 141
5SWWCE.0623-ENG	WinCE5.0 ProPlus PPC300 LX800 Microsoft Windows CE 5.0 Professional Plus englisch inklusive Lizenz; für PPC300 Geräte 5PC310.L800-00 und 5PC310.L800-01, CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MB).	siehe Seite 141
5SWWXP.0423-ENG		

Tabelle 9: Bestellnummern Software

Allgemeines • Bestellnummern

5.4 Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
0TB103.9	Stecker 24V 5.08 3p Schraubklemme Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Schraubklemme, 2,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.	siehe Seite 169
0TB103.91	Stecker 24V 5.08 3p Federzugklemme Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Federzugklemme, 2,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.	siehe Seite 169
0AC201.9	Lithium Batterien 5 Stk. Lithium Batterien 5 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	siehe Seite 171
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stk. Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	siehe Seite 171
5AC900.104X-03	Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP951.1043-01 und 5A981.1043-01, für 1 Gerät.	siehe Seite 172
5AC900.104X-04	Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP952.1043-01 und 5A982.1043-01, für 1 Gerät.	siehe Seite 172
5AC900.104X-05	Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP980.1043-01, für 3 Geräte.	siehe Seite 172
5AC900.150X-01	Einschubstreifenvordruck 15 " für Automation Panel 5AP951.1505-01, 5AP980.1505-01 und 5A981.1505-01, für 4 Geräte.	siehe Seite 172
5AC900.1200-00	USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) Frontseitige USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) für Automation Panel 900 und Panel PC 700 Geräten.	siehe Seite 174
5MMUSB.2048-00	USB Memory Stick 2 GB SanDisk USB 2.0 Memory Stick 2 GB	siehe Seite 175
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Drive DVD-RW/CD-RW FDD CF USB USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, Compact- Flash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC; (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	siehe Seite 179
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 64 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle.	siehe Seite 187
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 128 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	siehe Seite 187
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 256 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	siehe Seite 187
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	siehe Seite 187
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1024 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	siehe Seite 187
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2048 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	siehe Seite 187
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4096 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	siehe Seite 187
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8192 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	siehe Seite 187

Tabelle 10: Bestellnummern Zubehör

Kapitel 2 • Technische Daten

1. Einleitung

Der Panel PC 300 (kurz PPC300) Einschub erweitert die Automation Panel 900 (kurz AP900) Displayeinheiten zu einem embedded PC für Applikationen unter Windows CE und Windows XP embedded. Der PPC300 unterstützt Auflösungen von VGA (10,4") bis SXGA (19").

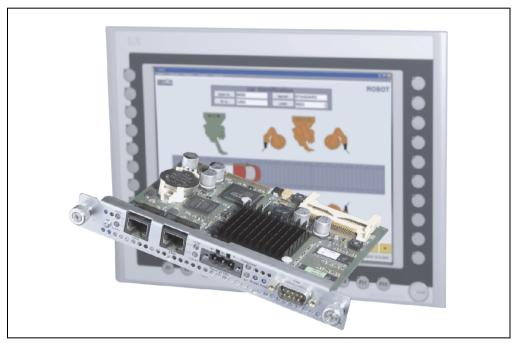


Abbildung 1: Panel PC 300 Einschub

Technische Daten • Einleitung

Der PPC300 wird mit Hilfe einfachster Einschubtechnik in den beim AP900 vorhandenen Einschubsteckplatz eingesteckt und mit den beiden Fixierschrauben (max. Anzugsmoment 0,5 Nm) fest mit dem AP900 verbunden. Nähere Informationen für den Einbau siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "PPC300 Montage in einem Automation Panel 900", auf Seite 97.



Abbildung 2: PPC300 montiert im AP900

1.1 Features

- Prozessor 500 MHz
- 256 oder 512 MB SDRAM
- CompactFlash Slot (Typ I)
- 24 VDC Versorgungsspannung
- 2x Ethernet 10/100 MBit Schnittstellen.
- BS232 Schnittstelle
- Echtzeituhr (batteriegepuffert)
- Status LEDs
- Power / Reset Taster
- USB 2.0 Unterstützung (in Verbindung mit Windows XP embedded)
- Lüfterloser Betrieb
- BIOS

1.2 Aufbau / Konfiguration

Der Panel PC 300 Einschub kann mit Automation Panel 900 Displayeinheiten betrieben werden. Für den Betrieb sind daher folgende Einzelkomponenten erforderlich:

- Panel PC 300 Einschubkarte
- Automation Panel 900 Displayeinheit (10,4" bis 19")

2. Gesamtgerät

Als Gesamtgerät wird ein PPC300 montiert in einem AP900 bezeichnet.

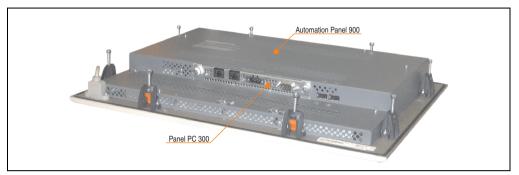


Abbildung 3: Gesamtgerät - PPC300 und AP900

2.1 Umgebungstemperaturen

In Abhängigkeit der Einbaulagen (Spezifikation siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 2.1 "Einbaulagen", auf Seite 100) zeigt die nachfolgende Tabelle die min. und max. spezifizierten Umgebungstemperaturen der Kombination aus AP900 mit PPC300 im Betrieb.

	Einbaulage AP900		
PPC300 + Automation Panel 900 ohne Rittalgehäuse	0°	bis -45° Display oben	bis +45° Display unten
5AP920.1043-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +50 °C
5AP980.1043-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +50 °C
5AP981.1043-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +50 °C
5AP982.1043-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +50 °C
5AP920.1214-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +50 °C
5AP920.1505-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +45 °C
5AP980.1505-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +45 °C
5AP981.1505-01	0 +50 °C	0 +50 °C	0 +45 °C
5AP920.1706-01	0 +40 °C	0 +40 °C	0 +35 °C
5AP920.1906-01	0 +40 °C	0 +40 °C	0 +40 °C
PPC300 + Automation Panel 900 mit Rittalgehäuse	0°	bis -45° Display oben	bis +45° Display unten
5AP920.1043-01	0 +45 °C	0 +45 °C	0 +45 °C
5AP980.1043-01	0 +45 °C	0 +45 °C	0 +45 °C
5AP981.1043-01	0 +45 °C	0 +45 °C	0 +45 °C
5AP982.1043-01	0 +45 °C	0 +45 °C	0 +45 °C

Tabelle 11: Umgebungstemperaturen in Abhängigkeit der Einbaulage

Technische Daten • Gesamtgerät

Genauere Informationen zur Temperatur in Abhängigkeit der spezifizierten Luftfeuchtigkeit sind den "Technischen Daten" der Einzelkomponenten zu entnehmen.

2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgend aufgelisteten Angaben zeigen die minimalste und maximalste Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von +30 °C für Betrieb bzw. Lagerung und Transport.

Komponente	Betrieb	Lagerung / Transport
5PC310.L800-00	5 - 90 %	5 - 90 %
5PC310.L800-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP920.1043-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP980.1043-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP981.1043-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP982.1043-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP920.1214-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP920.1505-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP980.1505-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP981.1505-01	5 - 90 %	5 - 90 %
5AP920.1706-01	20 - 90 %	5 - 90 %
5AP920.1906-01	20 - 90 %	5 - 90 %

Tabelle 12: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur sind den "Technischen Daten" der Einzelkomponenten zu entnehmen.

2.3 Leistungsverbrauch

Der Gesamtverbrauch setzt sich aus dem Verbrauch des PPC300 und der eingesetzten AP900 Gerätevariante zusammen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den typischen Verbrauch jeder einzelnen Komponente an. Die Summe beider ergibt den Gesamtverbrauch. Die Werte sind auch den "Technischen Daten" der Einzelkomponenten zu entnehmen.

Komponente	typisch	maximal	maximal mit USB
5PC310.L800-00 bzw. 5PC310.L800-01	5,5 W	8 W	8 W
5AP920.1043-01	10 W	13 W	19 W
5AP980.1043-01	10 W	13 W	20 W
5AP981.1043-01	10 W	14 W	21 W
5AP982.1043-01	10 W	14 W	21 W
5AP920.1214-01	12 W	15 W	21 W
5AP920.1505-01	24 W	31 W	41 W
5AP980.1505-01	24 W	32 W	42 W
5AP981.1505-01	24 W	32 W	42 W
5AP920.1706-01	27 W	36 W	46 W
5AP920.1906-01	27 W	38 W	48 W
Summe			

Tabelle 13: Leistungshaushalt in Abhängigkeit der Einbaulage

Angaben zum Einschaltstrom sind den "Technischen Daten" jeder einzelnen Automation Panel 900 Variante zu entnehmen.

2.4 Allgemeine Geräteschnittstellen

Die nachfolgenden Geräteschnittstellen gelten sowohl für den Panel PC 300 Einschub 5PC310.L800-00 wie auch für 5PC310.L800-01.

2.4.1 Ethernetanschluss - ETH1

Ethernet Anschluss (ETH1) ¹⁾				
Controller	Intel 82551ER			
Verkabelung	S/STP (Ka	ategorie 5)	RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female	
Übertragungsge- schwindigkeit	10/100 MBit/s ²⁾			
XE Boot möglich	-		10/100	
LED	Ein	Aus		
10/100 - grün	100 MBit/s	10 MBit/s		
Lnk/Act - orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ether- net Netzwerk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)	Lnk/Act ETH1	

Tabelle 14: Ethernet Anschluss (ETH1)

- Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Beide Betriebsarten möglich. Umschaltung erfolgt automatisch.

2.4.2 Ethernetanschluss - ETH2

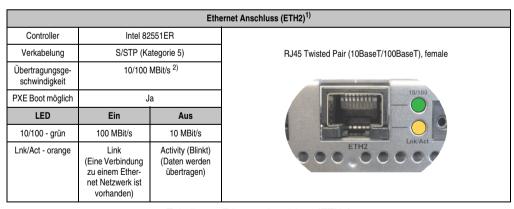


Tabelle 15: Ethernet Anschluss (ETH2)

- Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Beide Betriebsarten möglich. Umschaltung erfolgt automatisch.

Der Ethernetanschluss ETH2 ist PXE Boot kompatibel. Um das PXE Setup Menü aufzurufen ist während des Starts die Tastenkombination "Strg + S" zu drücken.

2.4.3 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem PPC300 Einschub zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern abgesichert (10A, flink, aufgelötet).

	Spannungsversorgung			
	verpolungssicher	3 polig, male		
Pin	Beschreibung			
1	+	+ 1 - Pow		
2	Funktionserde	1 2 3		
3	-	2 3 0 6		
Zubehör		Act Power 24 VDC CF		
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	POWER 24 VDC		
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme			

Abbildung 4: Spannungsversorgungsanschluss

Erdung

Achtung!

Die Funktionserde (Pin 2) ist möglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu empfehlen den größt möglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Technische Daten • Gesamtgerät

2.4.4 Status LEDs

LED	Farbe		Bedeutung
	grün	ein	Zustand S0: PPC300 eingeschaltet.
Power	rot	ein	Das System befindet sich im Stromspar- Standby Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend- to-Disk)
	gelb	ein	Steht dem Anwender frei zur
User	grün	aus	Verfügung (kann z.B. über die ADI Library direkt ein- bzw. ausgeschaltet werden - nur im S0 Zustand möglich).
CF	orange	ein	IDE Zugriff (Lesen, Schreiben) auf die CompactFlash Karte.

Tabelle 16: Technische Daten Status LEDs

2.4.5 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstützung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitäten.

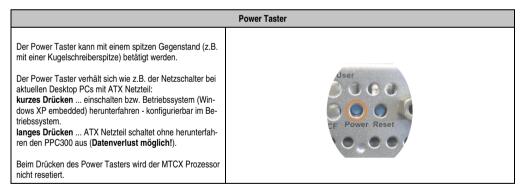


Tabelle 17: Power Taster

2.4.6 Reset Taster

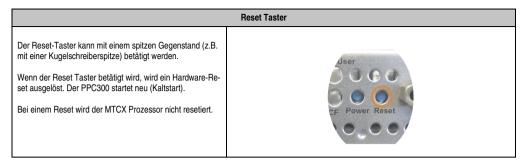


Tabelle 18: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.4.7 Serielle Schnittstelle COM

Der PPC300 verfügt über eine PC-kompatible serielle Schnittstelle mit 16 Byte FIFO. Diese steht dem Anwender als allgemein nutzbare Schnittstelle zur Verfügung (z.B. Fremdankopplungen, Barcode lesen, usw.).

Serielle Schnittstelle COM				
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt			
UART	16C550, 16 Byte FIFO			
Übertragungsgeschwindigkeit	bis 115 kBaud	9-poliger DSUB Stecker		
Pin	Belegung			
1	DCD	СОМ		
2	RxD			
3	TxD			
4	DTR	set 6 9		
5	GND			
6	DSR			
7	RTS			
8	CTS			
9	RI			

Tabelle 19: Pinbelegung COM

Interrupt und Adressbereich der Schnittstelle kann im BIOS Setup geändert werden. Defaulteinstellung siehe Abschnitt "BIOS Defaultwerte", auf Seite 135.

Technische Daten • Gesamtgerät

2.4.8 CompactFlash Slot CF

Der PPC300 ist mit einem über eine IDE Schnittstelle verbundenen CompactFlash Slot (Typ I) auf dem Baseboard ausgestattet.

Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden. Verfügbare CompactFlash Karten siehe Tabelle 10 "Bestellnummern Zubehör", auf Seite 20.

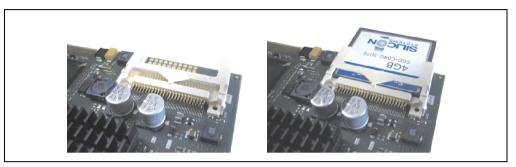


Abbildung 5: CompactFlash Slot

Die Zugriffsmethode (PIO, MDMA oder UDMA) wird durch die verwendete CompactFlash Karte bestimmt. Die Geschwindigkeit kann im BIOS Setup geändert werden. Defaulteinstellung siehe Abschnitt "BIOS Defaultwerte", auf Seite 135.

2.4.9 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) sowie individuell gespeicherte BIOS Einstellungen sicher und befindet sich auf dem Baseboard. Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens 4 Jahre (bei 50°C, 6 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Pufferdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

	Batterie Datterie			
Batterie Typ Tauschbar Lebensdauer	Renata 950 mAh (CR2477N) Ja 4 Jahre ¹⁾			
Zubehör	Kurzbeschreibung			
0AC201.9	Lithium Batterien 5 Stk. Lithium Batterien 5 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	annum J. C.		
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stk. Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle			
		The state of the s		

Tabelle 20: Technische Daten Batterie

1) Bei 50 °C, 6 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40 %.

Informationen zum Wechseln der Batterie siehe Kapitel 7 "Wartung und Instandhaltung", Abschnitt 1 "Batteriewechsel", auf Seite 199.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten unter Motherboard Device Information - Thermal Configuration (siehe Seite 122) angezeigt kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden. Mögliche Batteriezustände sind OK und Bad.

Technische Daten • Gesamtgerät

2.4.10 USB Anschluss (über AP900)

Für die USB Schnittstellen werden die in den AP900 Displays integrierten USB Schnittstellen (2 bei 10,4" und 3 ab 12,1") front- wie auch rückseitig genutzt.

Der Anschluss von USB Peripheriegeräten ist direkt wie auch über einen weiteren USB Hub möglich.

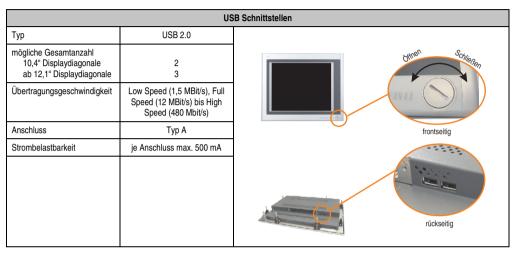


Tabelle 21: USB Schnittstellen

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3. Einzelkomponenten

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Einzelkomponenten (Panel PC 300 und Automation Panel 900) in allen verfügbaren Varianten beschrieben.

3.1 Panel PC 300 Einschub

3.1.1 Variante mit 256 MB SDRAM 5PC310.L800-00

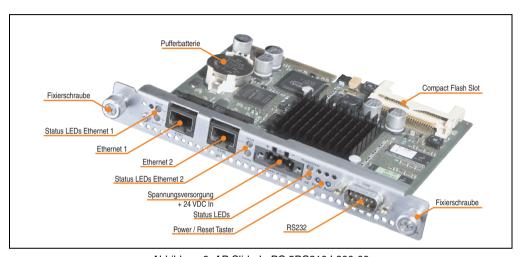


Abbildung 6: AP Slide-In PC 5PC310.L800-00

Technische Daten

Ausstattung	5PC310.L800-00
Bootloader / Betriebssystem	BIOS (Beschreibung siehe Abschnitt "BIOS Einstellungen", auf Seite 109)
Prozessor Typ Erweiterter Befehlssatz L1 Cache L2 Cache Floating Point Unit (FPU) Kühlung Art	Geode LX800 500 MHz, 32-Bit x86 MMX Technologie, 3D Now 128 kByte (64 kByte I-Cache / 64 kByte D-Cache) 128 kByte Ja Passiv (Kühlkörper)
Speicher Typ Größe	DDR SDRAM 256 MB
Echtzeituhr (RTC) Batteriegepuffert Genauigkeit	Ja bei 25 °C typ. 30 ppm (2,5 Sekunden) ¹⁾ pro Tag

Tabelle 22: Technische Daten 5PC310.L800-00

Technische Daten • Einzelkomponenten

Ausstattung	5PC310.L800-00
Batterie Typ Tauschbar Lebensdauer Stützkondensator ²⁾ (bei Batteriewechsel) Pufferzeit	Renata 950 mAh Ja 4 Jahre ³⁾ 10 Minuten
Ethernet 1 (ETH1) Controller Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Kabel	Intel 82551ER 10/100 Mbps RJ45 Twisted Pair (10 Base T / 100 Base T) S/STP (Kategorie 5)
Ethernet 2 (ETH2) Controller Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Kabel	Intel 82551ER 10/100 Mbps RJ45 Twisted Pair (10 Base T / 100 Base T) S/STP (Kategorie 5)
Serielle Schnittstelle (COM) Typ UART Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt 16C550 kompatibel, 16 Byte FIFO max. 115 kBaud 9-pol D-Sub
Reset Taster	Ja, von außen zugänglich
Power Taster	Ja, von außen zugänglich
LEDs	1x CF (gelb) 1x kombiniert Power (rot bzw. grün) und User (gelb) 2x Ethernet 1 - 10/100 (grün) und Link Act (gelb) 2x Ethernet 2 - 10/100 (grün) und Link Act (gelb)
USB Schnittstelle Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	realisiert über AP900 Displayeinheit (siehe Abschnitt "USB Anschluss (über AP900)", auf Seite 32 USB 2.0 2 Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Fixierschrauben maximales Anzugsmoment	2 0,5 Nm
Spannungsversorgung Spannungsbereich Nennstrom Einschaltstrom Leistungsaufnahme Galvanische Trennung	über AP900 18 - 30 VDC siehe Technische Daten der AP900 Gerät siehe Technische Daten der AP900 Gerät 5,5 W typisch, 8 W max. Ja
Ableitwiderstand	1 ΜΩ
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 233 g

Tabelle 22: Technische Daten 5PC310.L800-00

- 1) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 50 ppm (4 Sekunden) worst case 100 ppm (8 Sekunden).
- 2) Ab Revision C0 vorhanden.
- Typische Lebensdauer (bei 50% Pufferbetrieb, Temperaturverhältnisse 25°C im ausgeschalteten Zustand bzw. 50°C im eingeschalteten Zustand).

Maximale Lebensdauer im 24h Betrieb (ohne Pufferbetrieb) 6 Jahre bei 25°C bzw. 5 Jahre bei 50°C. Maximale Lebensdauer im ausgeschalteten Zustand 3 Jahre bei 25°C bzw. 2 Jahr bei 50°C.

3.1.2 Variante mit 512 MB SDRAM 5PC310.L800-01

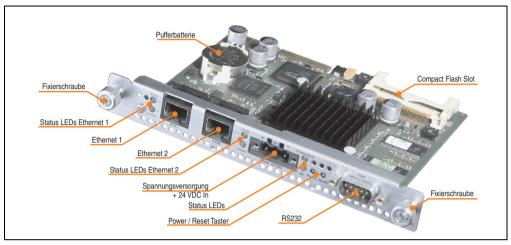


Abbildung 7: AP Slide-In PC 5PC310.L800-01

Technische Daten

Ausstattung	5PC310.L800-01
Bootloader / Betriebssystem	BIOS (Beschreibung siehe Abschnitt "BIOS Einstellungen", auf Seite 109)
Prozessor Typ Erweiterter Befehlssatz L1 Cache L2 Cache Floating Point Unit (FPU) Kühlung Art	Geode LX800 500 MHz, 32-Bit x86 MMX Technologie, 3D Now 128 kByte (64 kByte I-Cache / 64 kByte D-Cache) 128 kByte Ja Passiv (Kühlkörper)
Speicher Typ Größe	DDR SDRAM 512 MB
Echtzeituhr (RTC) Batteriegepuffert Genauigkeit	Ja bei 25 °C typ. 30 ppm (2,5 Sekunden) ¹⁾ pro Tag
Batterie Typ Tauschbar Lebensdauer Stützkondensator ²⁾ (bei Batteriewechsel) Pufferzeit	Renata 950 mAh Ja 4 Jahre ³⁾ 10 Minuten
Ethernet 1 (ETH1) Controller Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Kabel	Intel 82551ER 10/100 Mbps RJ45 Twisted Pair (10 Base T / 100 Base T) S/STP (Kategorie 5)

Tabelle 23: Technische Daten 5PC310.L800-01

Technische Daten • Einzelkomponenten

Ausstattung	5PC310.L800-01
Ethernet 2 (ETH2) Controller Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Kabel	Intel 82551ER 10/100 Mbps RJ45 Twisted Pair (10 Base T / 100 Base T) S/STP (Kategorie 5)
Serielle Schnittstelle (COM) Typ UART Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt 16C550 kompatibel, 16 Byte FIFO max. 115 kBaud 9-pol D-Sub
Reset Taster	Ja, von außen zugänglich
Power Taster	Ja, von außen zugänglich
LEDs	1x CF (gelb) 1x kombiniert Power (rot bzw. grün) und User (gelb) 2x Ethernet 1 - 10/100 (grün) und Link Act (gelb) 2x Ethernet 2 - 10/100 (grün) und Link Act (gelb)
USB Schnittstelle Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	realisiert über AP900 Displayeinheit (siehe Abschnitt "USB Anschluss (über AP900)", auf Seite 32 USB 2.0 2 Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Fixierschrauben maximales Anzugsmoment	2 0,5 Nm
Spannungsversorgung Spannungsbereich Nennstrom Einschaltstrom Leistungsaufnahme Galvanische Trennung	über AP900 18 - 30 VDC siehe Technische Daten der AP900 Gerät siehe Technische Daten der AP900 Gerät 5,5 W typisch, 8 W max. Ja
Ableitwiderstand	1 ΜΩ
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	ca. 233 g

Tabelle 23: Technische Daten 5PC310.L800-01

- 1) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 50 ppm (4 Sekunden) worst case 100 ppm (8 Sekunden).
- 2) Ab Revision C0 vorhanden.
- Typische Lebensdauer (bei 50% Pufferbetrieb, Temperaturverhältnisse 25°C im ausgeschalteten Zustand bzw. 50°C im eingeschalteten Zustand).

Maximale Lebensdauer im 24h Betrieb (ohne Pufferbetrieb) 6 Jahre bei 25°C bzw. 5 Jahre bei 50°C. Maximale Lebensdauer im ausgeschalteten Zustand 3 Jahre bei 25°C bzw. 2 Jahr bei 50°C.

Kapitel 2 Technische Daten

3.2 Automation Panel 900

3.2.1 Automation Panel 5AP920.1043-01

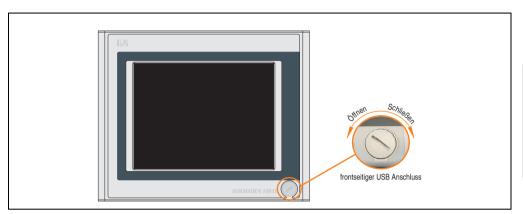


Abbildung 8: Vorderansicht 5AP920.1043-01

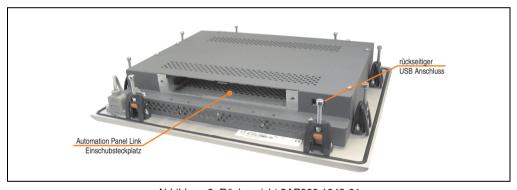


Abbildung 9: Rückansicht 5AP920.1043-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP920.1043-01
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision D0
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 2 (1x frontseitig, 1x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 10,4 in (264 mm) 262144 Farben VGA, 640 x 480 Bildpunkte 300:1 Richtung R / Richtung L = 70° Richtung U = 40° / Richtung D = 70° 350 cd/m² 50000 Stunden
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %
Tasten Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	
Elektrische Eigenschaften	
Versorgung Nennspannung Nennstrom ³⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Einschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 10 W, maximal 13 W bzw. 19 W mit USB ja
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁴⁾ grau ⁴⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾ ähnlich Pantone 42TCV ⁴⁾ umlaufende Rundschnur
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	323 mm 260 mm 55 mm

Tabelle 24: Technische Daten 5AP920.1043-01

Mechanische Eigenschaften	5AP920.1043-01
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾
Gewicht	ca. 2,9 kg
Umwelt Eigenschaften	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -30 °C +70 °C -30 °C +70 °C
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 40
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300.) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Meereshöhe	max. 3000 m

Tabelle 24: Technische Daten 5AP920.1043-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- 2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 3) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 4) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

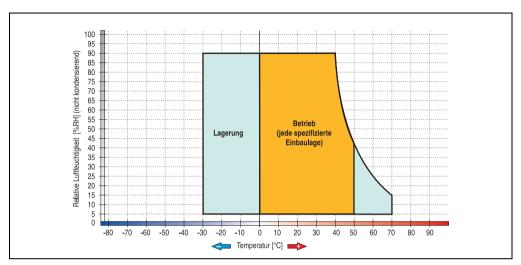


Abbildung 10: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1043-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

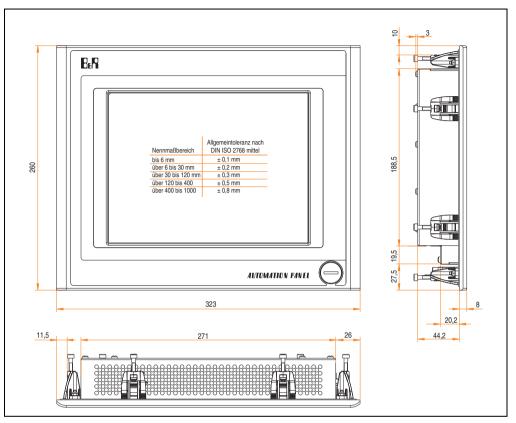


Abbildung 11: Abmessungen 5AP920.1043-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 920 TFT VGA 10,4in mit Touch Screen

Tabelle 25: Lieferumfang 5AP920.1043-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

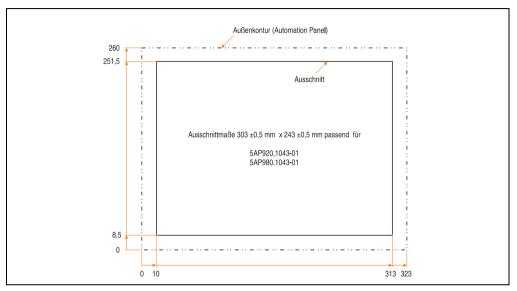


Abbildung 12: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1043-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.2 Automation Panel 5AP980.1043-01

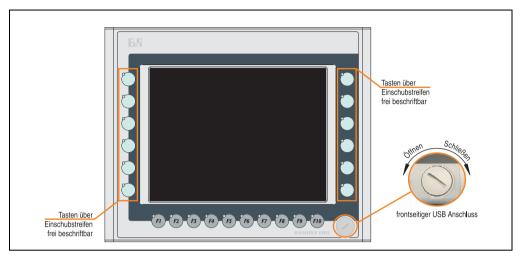


Abbildung 13: Vorderansicht 5AP980.1043-01

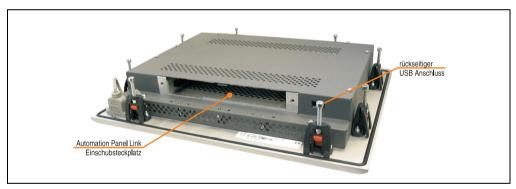


Abbildung 14: Rückansicht 5AP980.1043-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP980.1043-01
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision D0
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 2 (1x frontseitig, 1x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 10,4 in (264 mm) 262144 Farben VGA, 640 x 480 Bildpunkte 300:1 Richtung R / Richtung L = 70° Richtung U = 40° / Richtung D = 70° 350 cd/m² 50000 Stunden
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %
Tasten/LED ³⁾ Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	12 mit LED (gelb) 10 mit LED (gelb) > 10 ⁶ Betätigungen bei 1 ±0,3 bis 3 ±0,3 N Bestätigungskraft typisch 12 mcd (gelb)

Vorsicht!

Das gleichzeitige Betätigen von mehr als 2 Tasten kann zu so genannten Phantomkeys führen und unter Umständen unbeabsichtigte Aktionen auslösen.

Elektrische Eigenschaften	
Versorgung Nennspannung Nennstrom ⁴⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 10 W (ohne LED), maximal 13 W bzw. 20 W mit USB ja
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Farbe Einschubstreifen (grau) Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁵⁾ grau ⁵⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 42CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 42PCV ⁵⁾ umlaufende Rundschnur

Tabelle 26: Technische Daten 5AP980.1043-01

Mechanische Eigenschaften	5AP980.1043-01
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	323 mm 260 mm 55 mm
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾
Gewicht	ca. 2,9 kg
Umwelt Eigenschaften	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -30 °C +70 °C -30 °C +70 °C
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 46
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300.) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Meereshöhe	max. 3000 m

Tabelle 26: Technische Daten 5AP980.1043-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 3) Die Tasten bzw. LED Funktionen k\u00f6nnen mit dem B\u00ekR Key Editor, zu finden im Downloadbereich der B\u00ekR Homepage (www.br-automation.com) oder auf der B\u00ekR HMI Treiber \u00ek Utilities DVD (Best. Nr. 5SWHMI.0000-00), frei parametriert werden.
- 4) Der Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 5) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

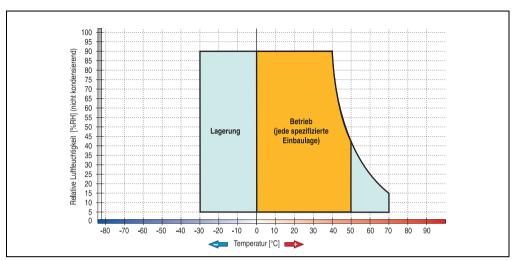


Abbildung 15: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP980.1043-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

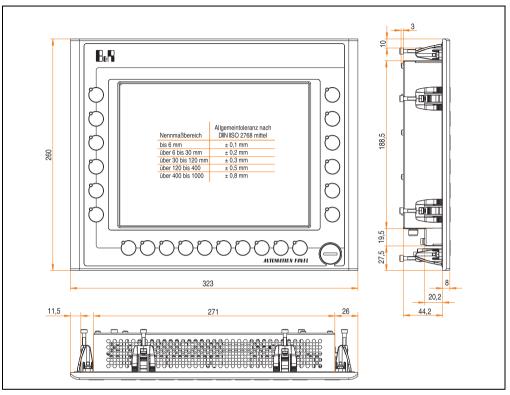


Abbildung 16: Abmessungen 5AP980.1043-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 980 TFT VGA 10,4in mit Touch Screen und Tasten
2	Einschubstreifen unbedruckt (sind in der Front eingeschoben)

Tabelle 27: Lieferumfang 5AP980.1043-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

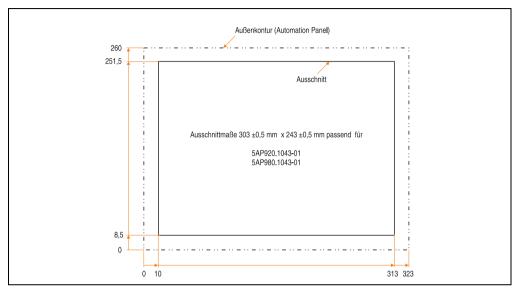


Abbildung 17: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP980.1043-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.3 Automation Panel 5AP981.1043-01

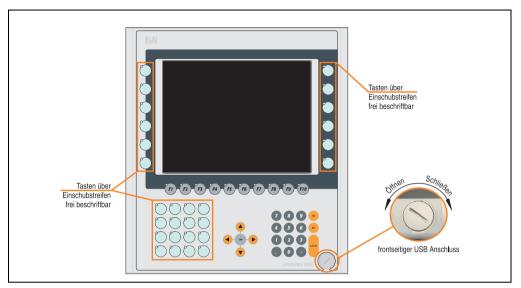


Abbildung 18: Vorderansicht 5AP981.1043-01

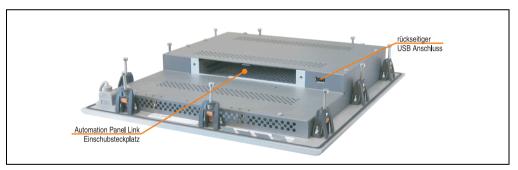


Abbildung 19: Rückansicht 5AP981.1043-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP981.1043-01
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision D0
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 2 (1x frontseitig, 1x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 10,4 in (264 mm) 262144 Farben VGA, 640 x 480 Bildpunkte 300:1 Richtung R / Richtung L = 70° Richtung U = 40° / Richtung D = 70° 350 cd/m² 50000 Stunden
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %
Tasten/LED ³⁾ Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	28 mit LED (gelb) 10 mit LED (gelb) - 15 ohne LED 5 ohne LED > 10 ⁶ Betätigungen bei 1 ±0,3 bis 3 ±0,3 N Bestätigungskraft typisch 12 mcd (gelb)

Vorsicht:

Das gleichzeitige Betätigen von mehr als 2 Tasten kann zu so genannten Phantomkeys führen und unter Umständen unbeabsichtigte Aktionen auslösen.

Elektrische Eigenschaften	
Versorgung Nennspannung Nennstrom ⁴⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 10 W (ohne LED), maximal 14 W bzw. 21 W mit USB ja
Mechanische Eigenschaften	
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	323 mm 358 mm 55 mm

Tabelle 28: Technische Daten 5AP981.1043-01

Mechanische Eigenschaften	5AP981.1043-01
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Farbe orange Tasten Farbe dunkelgraue Tasten Farbe Einschubstreifen (grau) Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁵⁾ grau ⁵⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 42TCV ⁵⁾ ähnlich Pantone 151CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 43TCV ⁵⁾ ähnlich Pantone 43DCV ⁵⁾ ühnlich Pantone 43DCV ⁵⁾ umlaufende Rundschnur
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾
Gewicht	ca. 3,6 kg
Umwelt Eigenschaften	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -30 °C +70 °C -30 °C +70 °C
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 52
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Meereshöhe	max. 3000 m

Tabelle 28: Technische Daten 5AP981.1043-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com)
 zum Download bereit.
- 3) Die Tasten bzw. LED Funktionen k\u00f6nnen mit dem B\u00ekR Key Editor, zu finden im Downloadbereich der B\u00ekR Homepage (www.br-automation.com) oder auf der B\u00ekR HMI Treiber \u00ek Utilities DVD (Best. Nr. 5SWHMI.0000-00), frei parametriert werden.
- 4) Der Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 5) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

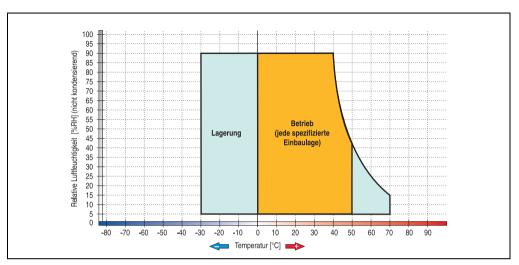


Abbildung 20: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP981.1043-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

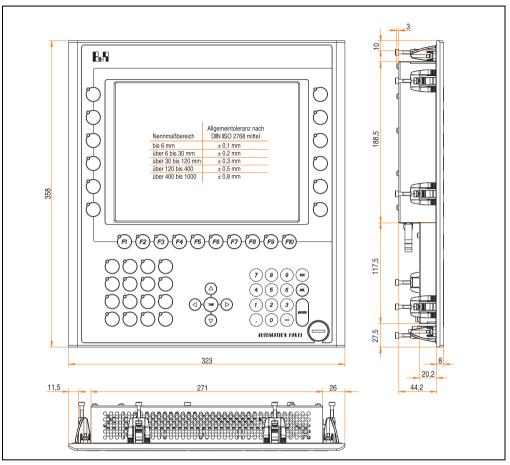


Abbildung 21: Abmessungen 5AP981.1043-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 981 TFT VGA 10,4in mit Tasten und Touch Screen
6	Einschubstreifen unbedruckt (sind in der Front eingeschoben)

Tabelle 29: Lieferumfang 5AP981.1043-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

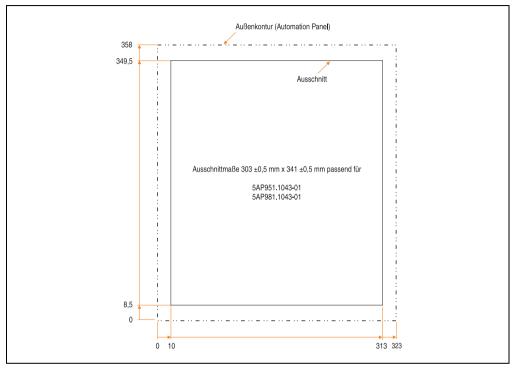


Abbildung 22: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP981.1043-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

Kapitel 2 Technische Daten

3.2.4 Automation Panel 5AP982.1043-01

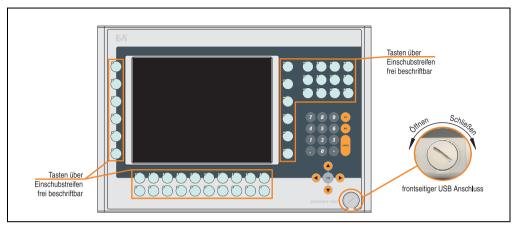


Abbildung 23: Vorderansicht 5AP982.1043-01

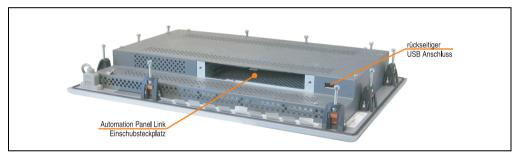


Abbildung 24: Rückansicht 5AP982.1043-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP982.1043-01
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision D0
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 2 (1x frontseitig, 1x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 10,4 in (264 mm) 262144 Farben VGA, 640 x 480 Bildpunkte 300:1 Richtung R / Richtung L = 70° Richtung U = 40° / Richtung D = 70° 350 cd/m² 50000 Stunden
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %
Tasten/LED ³⁾ Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	44 mit LED (gelb)

Vorsicht:

Das gleichzeitige Betätigen von mehr als 2 Tasten kann zu so genannten Phantomkeys führen und unter Umständen unbeabsichtigte Aktionen auslösen.

Elektrische Eigenschaften	
Versorgung Nennspannung Nennstrom ⁴⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 10 W (ohne LED), maximal 14 W bzw. 21 W mit USB ja
Mechanische Eigenschaften	
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	423 mm 288 mm 55 mm

Tabelle 30: Technische Daten 5AP982.1043-01

Mechanische Eigenschaften	5AP982.1043-01
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Farbe orange Tasten Farbe dunkelgraue Tasten Farbe Einschubstreifen (grau) Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁵⁾ grau ⁵⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 427CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 151CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 431CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 431CV ⁵⁾ ühnlich Pantone 429CV ⁵⁾ umlaufende Rundschnur
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾
Gewicht	ca. 3,9 kg
Umwelt Eigenschaften	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -30 °C +70 °C -30 °C +70 °C
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 58
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Meereshöhe	max. 3000 m

Tabelle 30: Technische Daten 5AP982.1043-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com)
 zum Download bereit.
- 3) Die Tasten bzw. LED Funktionen k\u00f6nnen mit dem B\u00ekR Key Editor, zu finden im Downloadbereich der B\u00ekR Homepage (www.br-automation.com) oder auf der B\u00ekR HMI Treiber \u00ek Utilities DVD (Best. Nr. 5SWHMI.0000-00), frei parametriert werden.
- 4) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 5) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

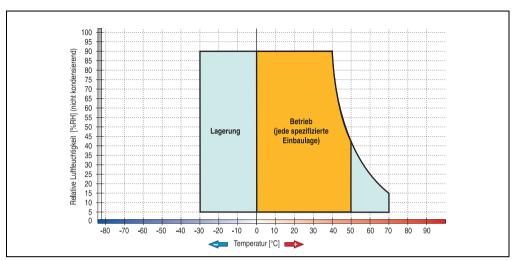


Abbildung 25: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP982.1043-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

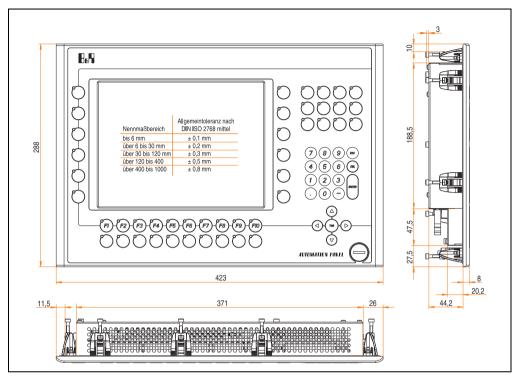


Abbildung 26: Abmessungen 5AP982.1043-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 982 TFT VGA 10,4in mit Touch Screen und Tasten
16	Einschubstreifen 6 unbedruckt - 10 teilweise bedruckt "F1-F10" (sind in der Front eingeschoben)

Tabelle 31: Lieferumfang 5AP982.1043-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

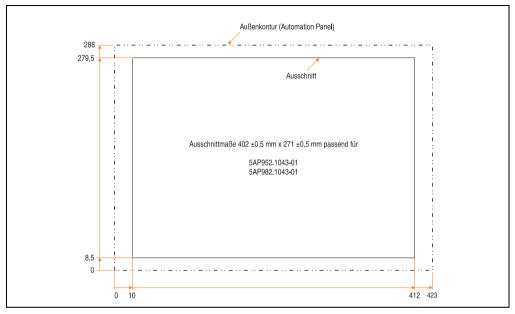


Abbildung 27: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP982.1043-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.5 Automation Panel 5AP920.1214-01

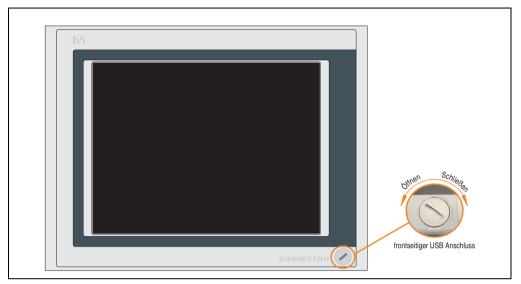


Abbildung 28: Vorderansicht 5AP920.1214-01

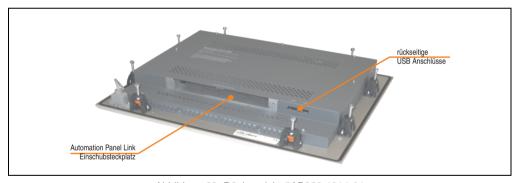


Abbildung 29: Rückansicht 5AP920.1214-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP920.1214-01
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision C0
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 3 (1x frontseitig, 2x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 12,1 in (307 mm) 262144 Farben SVGA, 800 x 600 Bildpunkte 300:1 Richtung R / Richtung L = 70° Richtung U = 50° / Richtung D = 60° 350 cd/m² 50000 Stunden
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %
Tasten/LED Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	
Elektrische Eigenschaften	
Versorgung Nennspannung Nennstrom ³⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 12 W, maximal 15 W bzw. 21 W mit USB ja
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁴⁾ grau ⁴⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾ ähnlich Pantone 42TCV ⁴⁾ umlaufende Rundschnur
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	362 mm 284 mm 54 mm

Tabelle 32: Technische Daten 5AP920.1214-01

Mechanische Eigenschaften	5AP920.1214-01
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾
Gewicht	ca. 3,4 kg
Umwelt Eigenschaften	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -30 °C +70 °C -30 °C +70 °C
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 64
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Meereshöhe	max. 3000 m

Tabelle 32: Technische Daten 5AP920.1214-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- 2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 3) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 4) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

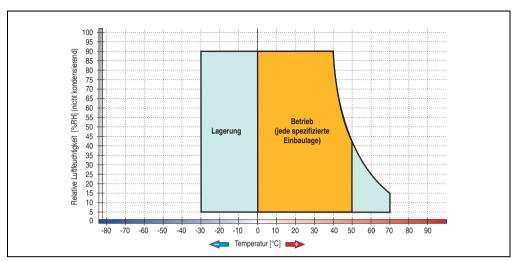


Abbildung 30: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1214-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

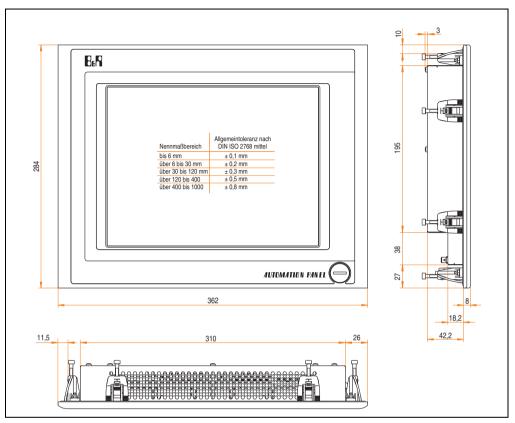


Abbildung 31: Abmessungen 5AP920.1214-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 920 TFT XGA 15in mit Touch Screen

Tabelle 33: Lieferumfang 5AP920.1214-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

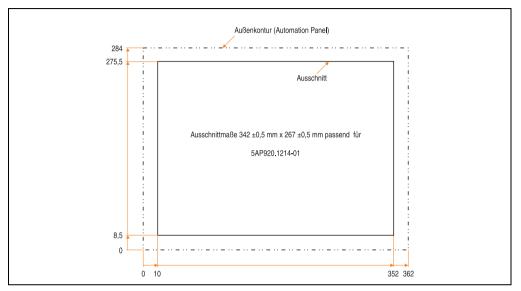


Abbildung 32: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1214-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.6 Automation Panel 5AP920.1505-01

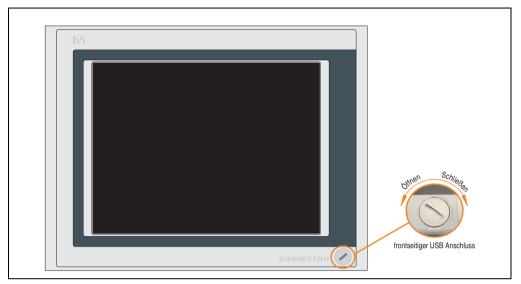


Abbildung 33: Vorderansicht 5AP920.1505-01

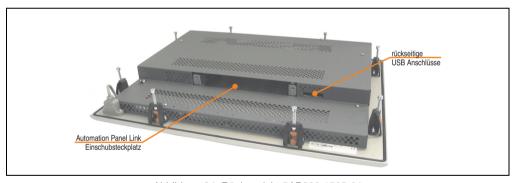


Abbildung 34: Rückansicht 5AP920.1505-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP920.1505-01
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision C0
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 3 (1x frontseitig, 2x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 15 in (381 mm) 16,7 Mio. XGA, 1024 x 768 Bildpunkte 400:1 Richtung R / Richtung L = 85° Richtung U / Richtung D = 85° 250 cd/m² 50000 Stunden
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %
Tasten/LED Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	
Elektrische Eigenschaften	
Versorgung Nennspannung Nennstrom ³⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 24 W, maximal 31 W bzw. 41 W mit USB ja
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁴⁾ grau ⁴⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾ ähnlich Pantone 42TCV ⁴⁾ umlaufende Rundschnur
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	435 mm 330 mm 54 mm

Tabelle 34: Technische Daten 5AP920.1505-01

Mechanische Eigenschaften	5AP920.1505-01
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾
Gewicht	ca. 5,1 kg
Umwelt Eigenschaften	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -25 °C +60 °C -25 °C +60 °C
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 70
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Meereshöhe	max. 3000 m

Tabelle 34: Technische Daten 5AP920.1505-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- 2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 3) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 4) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

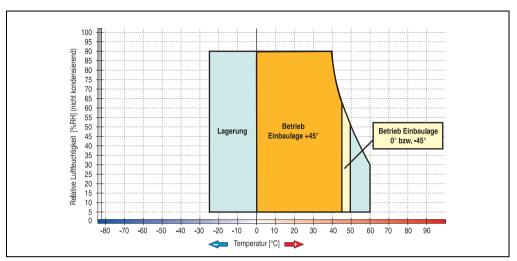


Abbildung 35: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1505-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

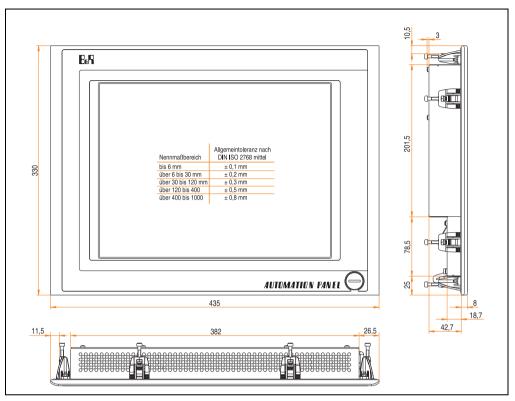


Abbildung 36: Abmessungen 5AP920.1505-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 920 TFT XGA 15in mit Touch Screen

Tabelle 35: Lieferumfang 5AP920.1505-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

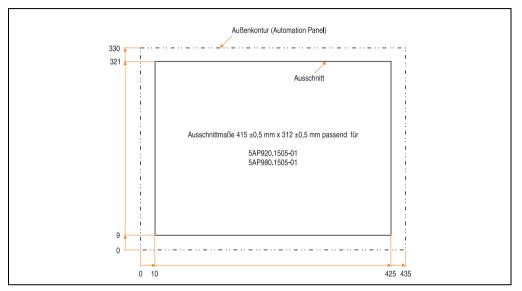


Abbildung 37: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1505-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.7 Automation Panel 5AP980.1505-01

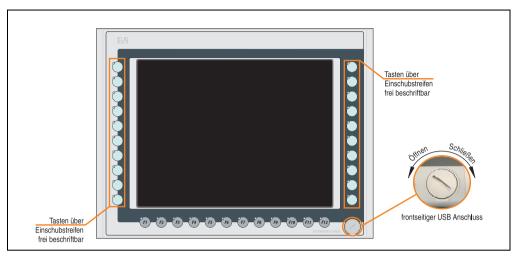


Abbildung 38: Vorderansicht 5AP980.1505-01

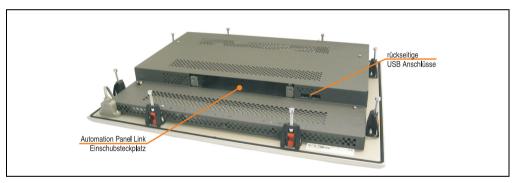


Abbildung 39: Rückansicht 5AP980.1505-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP980.1505-01	
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision C0	
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 3 (1x frontseitig, 2x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA	
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 15 in (381 mm) 16,7 Mio. XGA, 1024 x 768 Bildpunkte 400:1 Richtung R / Richtung L = 85° Richtung U / Richtung D = 85° 250 cd/m² 50000 Stunden	
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %	
Tasten/LED ³⁾ Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	20 mit LED (gelb) 12 mit LED (gelb) > 10 ⁶ Betätigungen bei 1 ±0,3 bis 3 ±0,3 N Bestätigungskraft typisch 12 mcd (gelb)	

Vorsicht:

Das gleichzeitige Betätigen von mehr als 2 Tasten kann zu so genannten Phantomkeys führen und unter Umständen unbeabsichtigte Aktionen auslösen.

Elektrische Eigenschaften	
Versorgung Nennspannung Nennstrom ⁴⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 24 W (ohne LED), maximal 32 W bzw. 42 W mit USB ja
Mechanische Eigenschaften	
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Farbe Einschubstreifen (grau) Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁵⁾ grau ⁵⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 42CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 42CV ⁵⁾ umlaufende Rundschnur

Tabelle 36: Technische Daten 5AP980.1505-01

Mechanische Eigenschaften	5AP980.1505-01	
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	435 mm 330 mm 54 mm	
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾	
Gewicht	ca. 5,1 kg	
Umwelt Eigenschaften		
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -25 °C +60 °C -25 °C +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 76	
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g	
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms	
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig	
Meereshöhe	max. 3000 m	

Tabelle 36: Technische Daten 5AP980.1505-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 3) Die Tasten bzw. LED Funktionen k\u00f6nnen mit dem B\u00ekR Key Editor, zu finden im Downloadbereich der B\u00ekR Homepage (www.br-automation.com) oder auf der B\u00ekR HMI Treiber \u00ek Utilities DVD (Best. Nr. 5SWHMI.0000-00), frei parametriert werden.
- 4) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 5) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

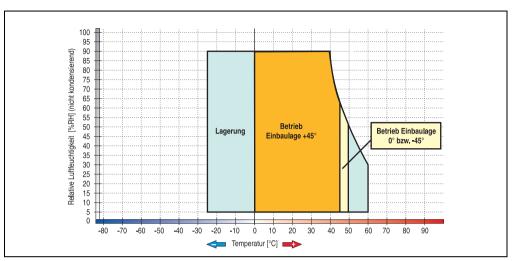


Abbildung 40: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP980.1505-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

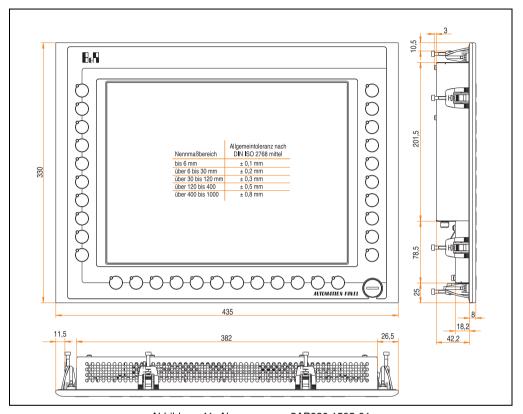


Abbildung 41: Abmessungen 5AP980.1505-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 980 TFT XGA 15in mit Touch Screen
2	Einschubstreifen undbedruckt (sind in der Front eingeschoben)

Tabelle 37: Lieferumfang 5AP980.1505-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

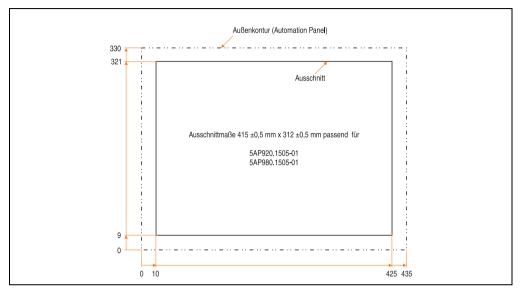


Abbildung 42: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP980.1505-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.8 Automation Panel 5AP981.1505-01

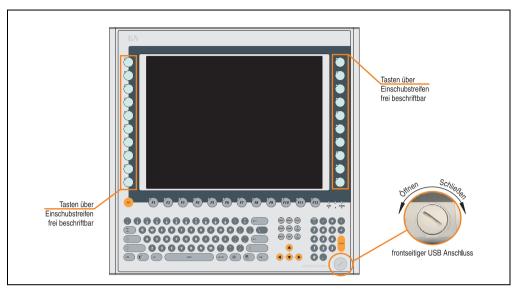


Abbildung 43: Vorderansicht 5AP981.1505-01

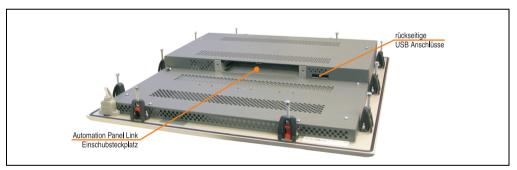


Abbildung 44: Rückansicht 5AP981.1505-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP981.1505-01
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision C0
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 3 (1x frontseitig, 2x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 15 in (381 mm) 16,7 Mio. XGA, 1024 x 768 Bildpunkte 400:1 Richtung R / Richtung L = 85° Richtung U / Richtung D = 85° 250 cd/m² 50000 Stunden
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %
Tasten/LED ³⁾ Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	20 mit LED (gelb) 12 mit LED (gelb) 15 ohne LED 77 ohne LED > 10 ⁶ Betätigungen bei 1 ±0,3 bis 3 ±0,3 N Bestätigungskraft typisch 12 mcd (gelb)

Vorsicht:

Das gleichzeitige Betätigen von mehr als 2 Tasten kann zu so genannten Phantomkeys führen und unter Umständen unbeabsichtigte Aktionen auslösen.

Elektrische Eigenschaften		
Versorgung Nennspannung Nennstrom ⁴⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 µs typisch 24 W (ohne LED), maximal 32 W bzw. 42 W mit USB ja	
Mechanische Eigenschaften		
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	435 mm 430 mm 54 mm	

Tabelle 38: Technische Daten 5AP981.1505-01

Mechanische Eigenschaften	5AP981.1505-01	
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Farbe orange Tasten Farbe dunkelgraue Tasten Farbe Einschubstreifen (grau) Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁵⁾ grau ⁵⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 427CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 151CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 431CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 431CV ⁵⁾ ühnlich Pantone 429CV ⁵⁾ umlaufende Rundschnur	
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾	
Gewicht	ca. 5,9 kg	
Umwelt Eigenschaften		
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -25 °C +60 °C -25 °C +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 82	
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g	
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms	
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig	
Meereshöhe	max. 3000 m	

Tabelle 38: Technische Daten 5AP981.1505-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com)
 zum Download bereit
- 3) Die Tasten bzw. LED Funktionen k\u00f6nnen mit dem B\u00ekR Key Editor, zu finden im Downloadbereich der B\u00ekR Homepage (www.br-automation.com) oder auf der B\u00ekR HMI Treiber \u00ek Utilities DVD (Best. Nr. 5SWHMI.0000-00), frei parametriert werden.
- 4) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 5) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

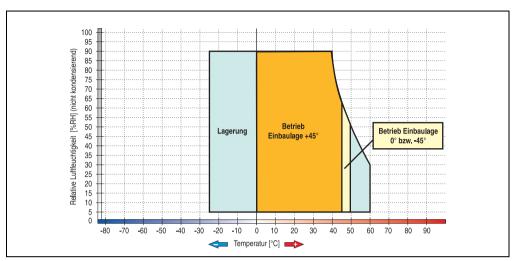


Abbildung 45: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP981.1505-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

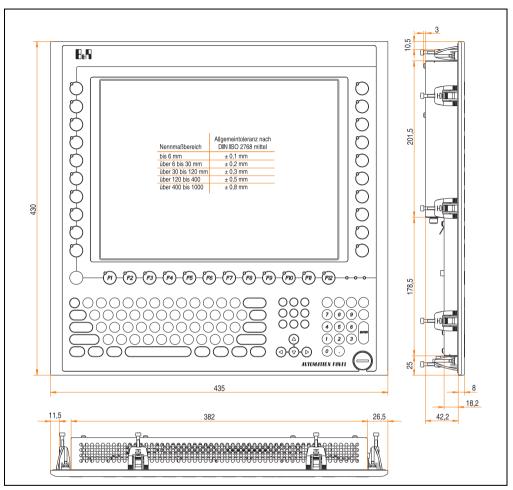


Abbildung 46: Abmessungen 5AP981.1505-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 981 TFT VGA 15in mit Touch Screen und Tasten
2	Einschubstreifen 2 unbedruckt (sind in der Front eingeschoben)

Tabelle 39: Lieferumfang 5AP981.1505-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

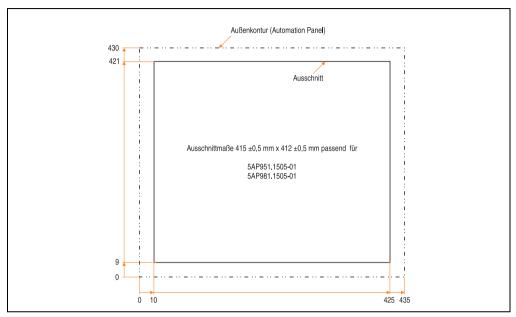


Abbildung 47: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP981.1505-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.9 Automation Panel 5AP920.1706-01

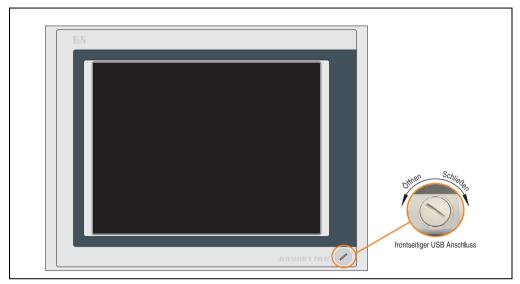


Abbildung 48: Vorderansicht 5AP920.1706-01

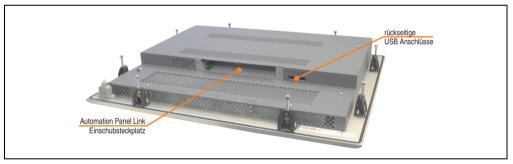


Abbildung 49: Rückansicht 5AP920.1706-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP920.1706-01	
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision C0	
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 3 (1x frontseitig, 2x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA	
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 17 in (431 mm) 16,7 Mio. 16,7 Mio. SXGA, 1024 Bildpunkte 600:1 Richtung R / Richtung L = 75° Richtung U = 75° / Richtung D = 60° 250 cd/m² 50000 Stunden²)	
Touch Screen ³⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %	
Tasten/LED Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	-	
Elektrische Eigenschaften		
Versorgung Nennspannung Nennstrom ⁴⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 27 W, maximal 36 W bzw. 46 W mit USB ja	
Mechanische Eigenschaften		
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁵⁾ grau ⁵⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾ ähnlich Pantone 42TCV ⁵⁾ umlaufende Rundschnur	
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	477 mm 390 mm 59 mm	

Tabelle 40: Technische Daten 5AP920.1706-01

Mechanische Eigenschaften	5AP920	.1706-01	
Gehäuse Lackierung		Metall ähnlich Pantone 432CV ⁵⁾	
Gewicht	ca.	7 kg	
Umwelt Eigenschaften	5AP920.1706-01 < Rev. D0	5AP920.1706-01 ab Rev. D0	
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -20 °C +60 °C -20 °C +60 °C	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -25 °C +60 °C -25 °C +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramn	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 88	
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 3,5 mm Amp 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g	
Schock Betrieb Lager Transport	30 g,	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms	
Schutzart		IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig	
Meereshöhe	max. 3	max. 3000 m	

Tabelle 40: Technische Daten 5AP920.1706-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- 2) Revision < D0 Lebensdauer begrenzt auf 30000 Stunden.
- 3) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 4) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 5) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

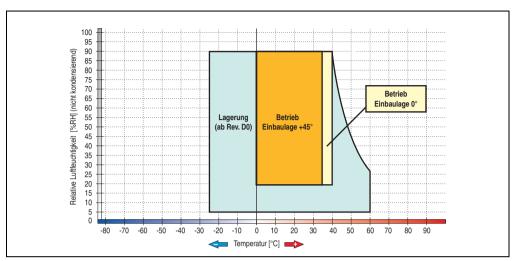


Abbildung 50: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1706-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

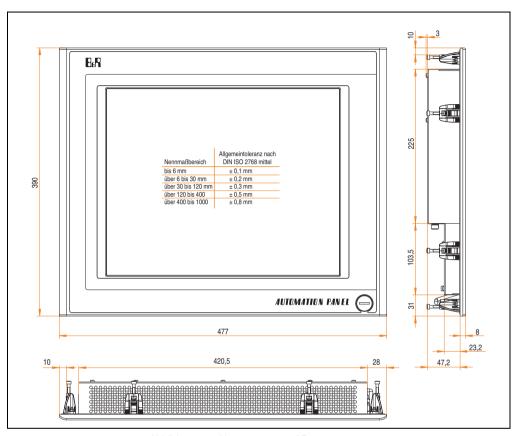


Abbildung 51: Abmessungen 5AP920.1706-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente
1	Automation Panel 920 TFT SXGA 17in mit Touch Screen

Tabelle 41: Lieferumfang 5AP920.1706-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

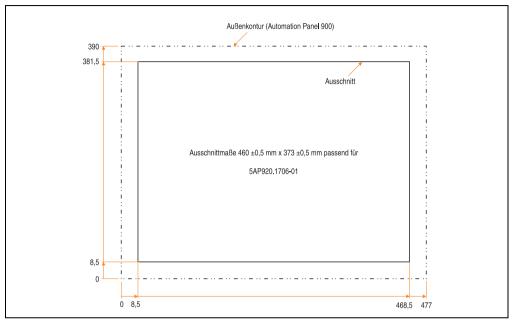


Abbildung 52: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1706-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

3.2.10 Automation Panel 5AP920.1906-01

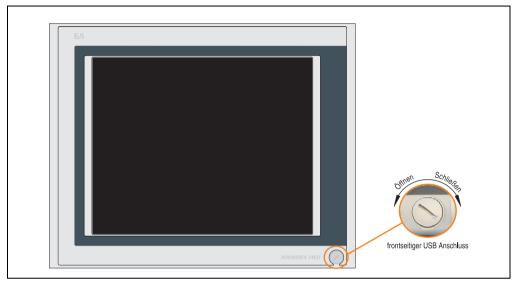


Abbildung 53: Vorderansicht 5AP920.1906-01

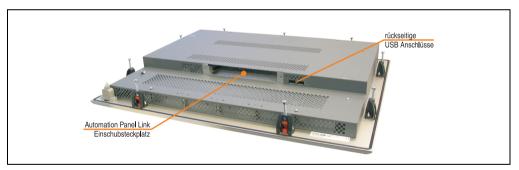


Abbildung 54: Rückansicht 5AP920.1906-01

Technische Daten

Ausstattung	5AP920.1906-01	
Einbaukompatibel für PPC300 Einschub	ab Revision C0	
USB Schnittstelle ¹⁾ Typ Anzahl Übertragungsgeschwindigkeit Anschluss Strombelastbarkeit	USB 2.0 3 (1x frontseitig, 2x rückseitig) Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s) Typ A je Anschluss max. 500 mA	
Display Typ Diagonale Farben Auflösung Kontrast Blickwinkel (siehe Seite 213) horizontal vertikal Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Half Brightness Time	TFT 19 in (482 mm) 16,7 Mio. SXGA, 1280 x 1024 Bildpunkte 600:1 Richtung R / Richtung L = 75° Richtung U = 75° / Richtung D = 60° 250 cd/m² 35000 Stunden	
Touch Screen ²⁾ Technologie Controller Transmissionsgrad	analog, resistiv Elo, seriell, 12 Bit bis zu 78 %	
Tasten/LED Funktionstasten Softkey Tasten Cursor Block Numerischer Block Sonstige Tasten Lebensdauer einer Taste Lichtstärke der LED	-	
Elektrische Eigenschaften		
Versorgung Nennspannung Nennstrom ³⁾ Einschaltstrom Leistungsaufnahme (ohne Elnschub) Galvanische Trennung	über PPC300 24 VDC ± 25 % (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) maximal 3,2 A (aufgedruckt auf der Gehäuserückseite) typisch 6 A, maximal 30 A für < 300 μs typisch 27 W, maximal 38 W bzw. 48 W mit USB ja	
Mechanische Eigenschaften		
Front Trägerrahmen Design Dekorfolie Farbe dunkler Rand ums Display Farbe heller Hintergrund Dichtung	Aluminium, natur eloxiert ⁴⁾ grau ⁴⁾ Polyester ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾ ähnlich Pantone 427CV ⁴⁾ umlaufende Rundschnur	
Außenabmessungen Breite Höhe Tiefe	527 mm 421 mm 62 mm	

Tabelle 42: Technische Daten 5AP920.1906-01

Mechanische Eigenschaften	5AP920.1906-01	
Gehäuse Lackierung	Metall ähnlich Pantone 432CV ⁴⁾	
Gewicht	ca. 8,1 kg	
Umwelt Eigenschaften	5AP920.1906-01 < Rev. D0	5AP920.1906-01 ab Rev. D0
Umgebungstemperatur Betrieb Lager Transport	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -20 °C +60 °C -20 °C +60 °C	siehe "Umgebungstemperaturen", auf Seite 23 -25 °C +60 °C -25 °C +60 °C
Luftfeuchtigkeit	siehe "Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung", auf Seite 94	
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lager Transport	2 - 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 0,5 g 2 - 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 - 200 Hz: 1 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g 2 - 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 - 200 Hz: 2 g / 200 - 500 Hz: 4 g	
Schock Betrieb Lager Transport	15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms	
Schutzart	IP20 rückseitig (nur mit gestecktem PPC300) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig	
Meereshöhe	max. 3000 m	

Tabelle 42: Technische Daten 5AP920.1906-01 (Forts.)

- 1) USB Geräte wie auch ein USB Hub können direkt am Automation Panel angeschlossen werden.
- 2) Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.
- 3) Der angegebene Wert bezieht sich auf das Automation Panel Gerät mit gestecktem PPC300.
- 4) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

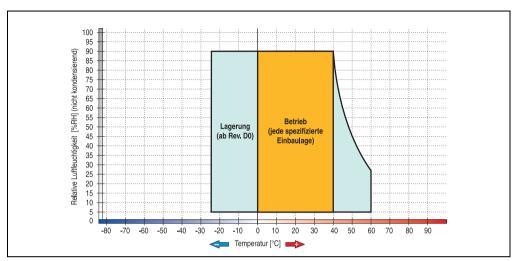


Abbildung 55: Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1906-01

Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1 °C pro 1000 Metern ab 500 Meter NN.

Abmessungen

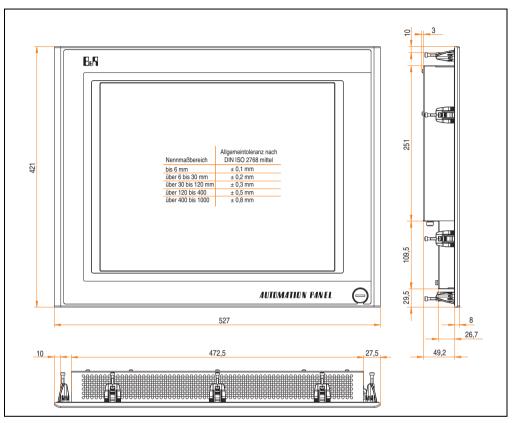


Abbildung 56: Abmessungen 5AP920.1906-01

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Automation Panel sind folgende Komponenten enthalten:

Anzahl	Komponente	
1	Automation Panel 920 TFT SXGA 19in mit Touch Screen	

Tabelle 43: Lieferumfang 5AP920.1906-01

Einbau in Wanddurchbrüche

Das Automation Panel wird mit den vormontierten Klemmblöcken z.B. in Wanddurchbrüche eingebaut. Dazu muss ein Ausschnitt entsprechend folgender Zeichnung erstellt werden.

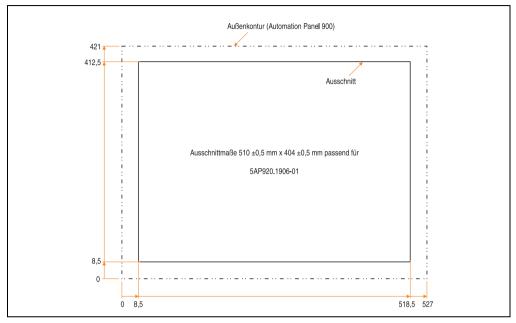


Abbildung 57: Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1906-01

Weitere Informationen bezüglich Montage und Einbaulage siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme" ab Seite 97.

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1. PPC300 Montage in einem Automation Panel 900

Die Montage darf nicht unter Spannung erfolgen. Der PPC300 Einschub wird rückseitig in den Automation Panel Link Slot des AP900 geschoben. Dabei ist auf den richtigen Sitz des PPC300 in den beiden Führungsleisten (links und rechts) des AP900 zu achten.

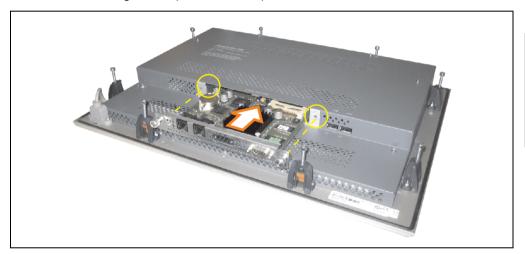


Abbildung 58: PPC300 Montage im AP900

1.1 Hardwarekompatibilitäten mit Automation Panel 900

Der Panel PC 300 Einschub kann bei folgenden AP900 Geräten und ab folgenden Revisionen eingesetzt werden:

- 5AP920.1043-01 Rev. D0
- 5AP980.1043-01 Rev. D0
- 5AP981.1043-01 Rev. D0
- 5AP982.1043-01 Rev. D0
- 5AP920.1214-01 Rev. C0
- 5AP920.1505-01 Rev. C0
- 5AP980.1505-01 Rev. C0

Inbetriebnahme • PPC300 Montage in einem Automation Panel 900

- 5AP981.1505-01 Rev. C0
- 5AP920.1706-01 Rev. C0
- 5AP920.1906-01 Rev. C0

1.2 Fixierung im Automation Panel 900

Mit den beiden Fixierschrauben wird der PPC300 danach fest mit dem AP900 verbunden (max. Anzugsmoment 0,5 Nm).



Abbildung 59: PPC300 im AP900 fixieren

Kapitel 3 nbetriebnahme

2. Montagevorschriften eines Automation Panel 900

Die Automation Panel 900 Geräte werden mit den an der Displayeinheit befindlichen Klemmblöcken (verschiedene Ausführungen möglich) vorzugsweise in Wanddurchbrüchen montiert. Die Ausschnittmaße des Durchbruches für das jeweilige Automation Panel 900 Gerät ist den technischen Daten zu entnehmen (siehe Kapitel 2 "Technische Daten" ab Seite 21).

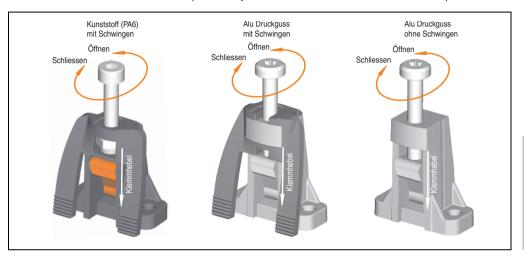


Abbildung 60: Klemmblöcke

Die Klemmblöcke sind für eine max. Stärke des zu klemmenden Materials von 10 mm ausgelegt, minimal beträgt die Materialstärke 2 mm.

Für das Anziehen bzw. Lösen der Schraube wird bei den Kunststoff Klemmblöcken ein Innensechskantschlüssel (Gr. 3) und bei den Alu Druckguss Klemmblöcken ein Torx Schraubendreher (Gr. 20) oder ein großer Schlitzschraubendreher benötigt. Das maximale Anzugsmoment des Klemmblockes beträgt 0,5 Nm. Ein Automation Panel 900 Gerät muss an einer planen Oberfläche montiert werden, Unebenheiten können beim Anziehen der Schrauben zu Beschädigungen des Displays führen.

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und hinter dem Automation Panel ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeichnung entnommen werden.

2.1 Einbaulagen

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen die spezifizierten Einbaulagen der Automation Panel Geräte.

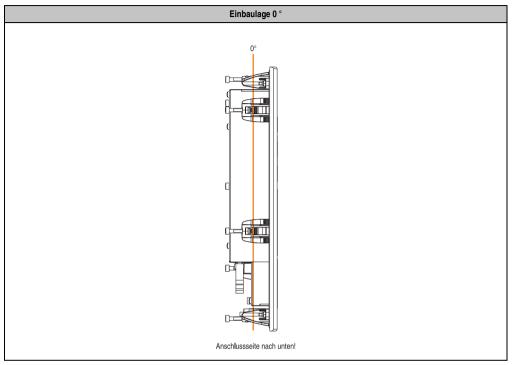


Tabelle 44: Einbaulage 0 °

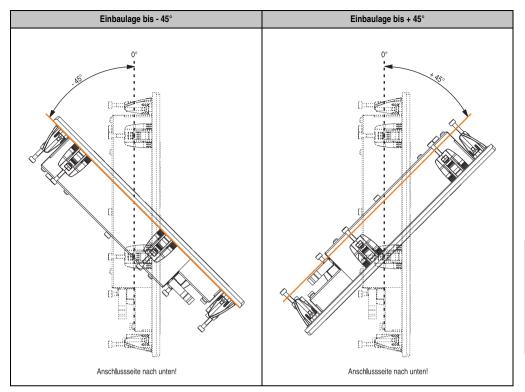


Tabelle 45: Einbaulagen -45 $^{\circ}$ und +45 $^{\circ}$

Warnung!

Auf Grund der geänderten Thermik bei einigen Einbaulagen, z.B. +/- 45°, können die maximal spezifizierten Umgebungstemperaturen bei einigen Automation Panel 900 wie bei der Einbaulage 0° im Betrieb nicht erreicht werden. Die hierfür geltenden Grenzwerte siehe Tabelle 11 "Umgebungstemperaturen in Abhängigkeit der Einbaulage", auf Seite 23.

3. Kabelfixierung

Dem Automation Panel liegen Kabelschellen bei, mit welchen die angeschlossenen Kabel auf der Rückseite am unteren Ende des Automation Panel Gehäuses fixiert werden können.

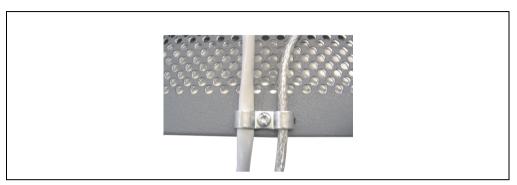


Abbildung 61: Kabelschellenfixierung

4. Funktionserdelasche

Auf der Rückseite links neben dem Automation Panel Link Steckplatz befindet sich eine Funktionserdelasche. Die Erdungslasche (Funktionserde) muss mittels 6,3mm Flachstecker auf kürzestem Weg und so niederohmig wie möglich (z.B. Kupferband, jedoch mindestens 2,5mm²) mit einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschranks verbunden werden.

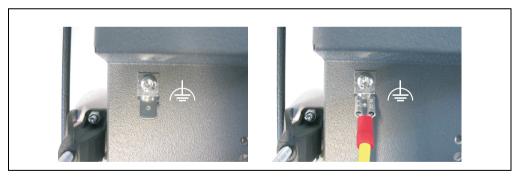


Abbildung 62: Funktionserdelasche

5. Tasten- und Ledkonfigurationen

Jede Taste bzw. LED kann individuell konfiguriert und somit an die Anwendung angepasst werden. Zu diesem Zweck stehen verschiedene B&R Werkzeuge zur Verfügung:

B&R Key Editor für Windows Betriebssysteme

Tasten und LEDs von jedem Gerät werden vom Matrixcontroller in einer Bitfolge zu je 128 Bits verarbeitet.

Die Positionen, welche die Tasten und LEDs in der Matrix besitzen werden als Hardwarenummern dargestellt. Die Hardwarenummern können z.B. mit dem B&R Key Editor und dem B&R Control Center direkt am Zielsystem ausgelesen werden.

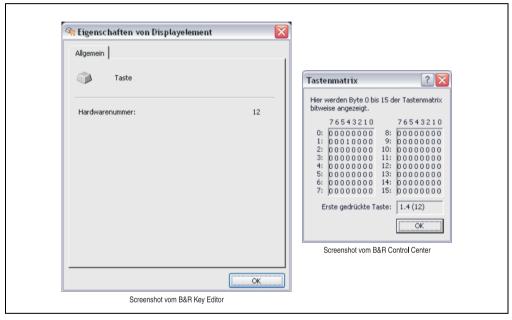


Abbildung 63: Beispiel - Hardwarenummer im B&R Key Editor bzw. im B&R Control Center

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Positionen der Tasten und LEDs in der Matrix. Diese werden wie folgt dargestellt:

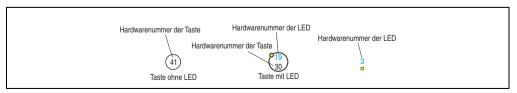


Abbildung 64: Darstellung - Tasten und LEDs in der Matrix

Inbetriebnahme • Tasten- und Ledkonfigurationen

5.1 Automation Panel 10,4" VGA

5.1.1 Automation Panel 5AP981.1043-01

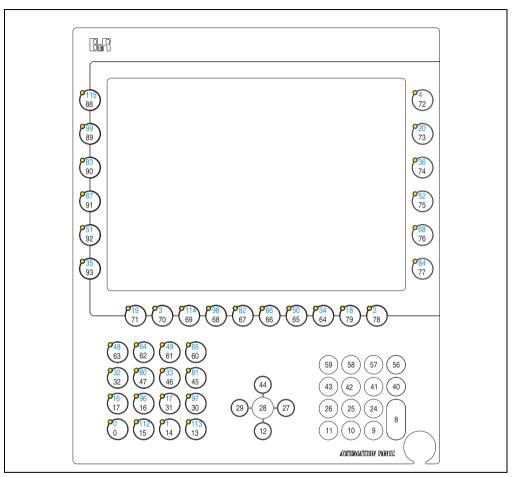


Abbildung 65: Hardwarenummern - 5AP981.1043-01

5.1.2 Automation Panel 5AP982.1043-01

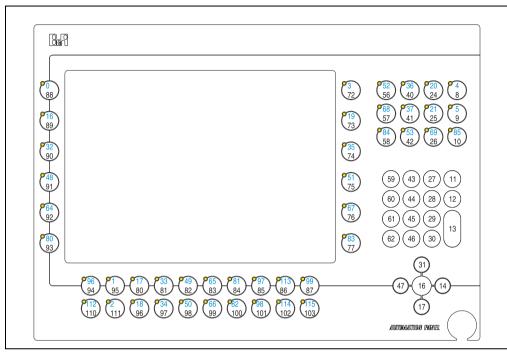


Abbildung 66: Hardwarenummern - 5AP982.1043-01

Inbetriebnahme • Tasten- und Ledkonfigurationen

5.1.3 Automation Panel 5AP980.1043-01

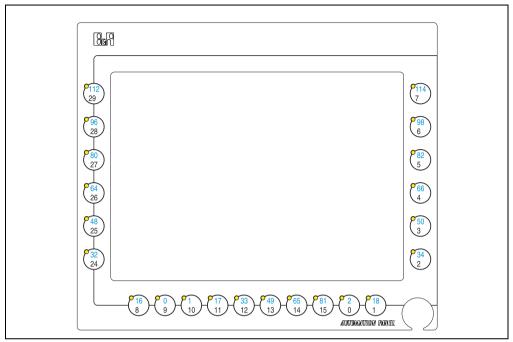


Abbildung 67: Hardwarenummern - 5AP980.1043-01

5.2 Automation Panel 15" XGA

5.2.1 Automation Panel 5AP981.1505-01

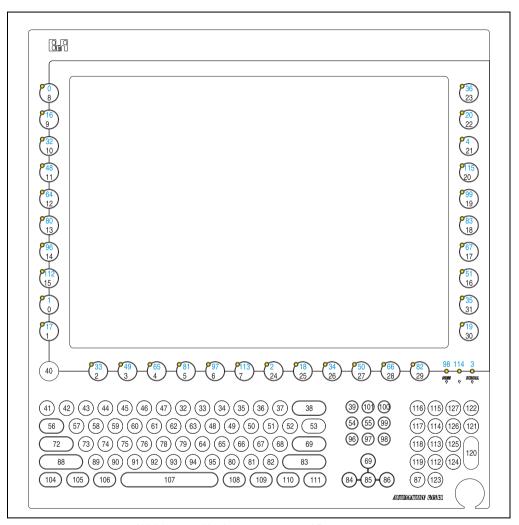


Abbildung 68: Hardwarenummern - 5AP981.1505-01

Inbetriebnahme • Tasten- und Ledkonfigurationen

5.2.2 Automation Panel 5AP980.1505-01

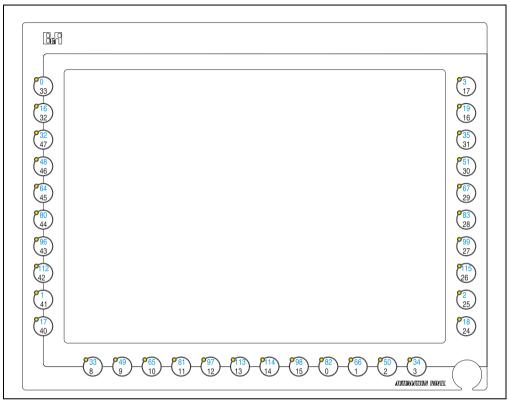


Abbildung 69: Hardwarenummern - 5AP980.1505-01

Kapitel 4 • Software

1. BIOS Einstellungen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.03. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für "Basic Input and Output System". Es ist die grundlegendste standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei den Panel PC 300 Geräten wird ein von B&R modifiziertes BIOS verwendet.

Das BIOS Setup ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS RAM gespeichert.

Das CMOS RAM ist ein nullspannungssicherer Speicher (wird durch eine Batterie gepuffert), d.h. die Informationen in diesem Speicher bleiben auch im spannungslosen Zustand des Panel PC's erhalten.

Sofort nach Einschalten der Spannungsversorgung des Panel PC 300 wird das BIOS aktiviert.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation im CMOS RAM, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

1.2 Summary Screen

Abbildung 70: Summary Screen

Deaktivierung dieses Summary Screens siehe Abschnitt 1.3.9 "Miscellaneous Configuration", auf Seite 128.

Um im BIOS Setup Änderungen vorzunehmen, muss beim Hochfahren des Panel PC 300 Gerätes die "Entf" Taste - vor dem Erscheinen des Summary Screens - gedrückt werden, sobald die Nachricht "Press DEL for Setup" erscheint (während des POST):

Falls die Nachricht verschwindet, bevor "Entf" gedrückt¹⁾ wurde, muss der PPC300 neu gebootet werden, um in das BIOS Setup zu gelangen.

Achtung!

Generell gilt: Man sollte nur jene Einstellungen ändern, deren Bedeutung man wirklich versteht. Auf keinen Fall sollten Einstellungen ohne Grund geändert werden. Die BIOS Einstellungen wurden von B&R sorgfältig ausgewählt und garantieren optimale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Selbst kleine Änderungen der Einstellungen können zur Instabilität des Systems führen!

Information:

Die von B&R empfohlenen Einstellungen können mit "Load Defaults" geladen werden.

Folgende Tasten¹⁾ können im BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Objekt.
Cursor →	Zum nächsten Objekt.
ESC	Untermenüs verlassen.
Enter oder hervorgehobenen Buchstaben als Shortcut drücken	In das ausgewählte Menü wechseln.
F1 bzw. ALT+H	Einblenden eines Hilfe-Fensters, in dem die möglichen Werte für das markierte Objekt beschrieben sind. Um aus dem Hilfefenster auszusteigen, Esc drücken. In einem Hilfefenster kann mit Cursor ↑, Cursor ↓, Pos1, Ende, Bild Up, Bild Down navigiert werden, wenn der Hilfetext länger als der anzeigbare Bereich ist.
Pos1	Man springt zum ersten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
Ende	Man springt zum letzten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
ALT+Q bzw. ALT+X	Man gelangt ins BIOS Hauptmenü.
- (Minus)	Numerischen Wert vermindern oder vorhergehenden Parameterwert auswählen.
+ (Plus)	Numerischen Wert erhöhen oder nächsten Parameterwert auswählen.

Tabelle 46: Biosrelevante Tasten

Die Eingabe von Zeichen und die Bedienung der BIOS Setup Seiten kann durch Anschluss einer USB Tastatur oder durch bei Tastendisplays durch ein passendes parametriertes Tastenfeld durchführen.

1.3 BIOS Einstellungen

1.3.1 Main Menu

Unmittelbar nach Drücken der Taste "Entf" beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Main Menu

T. Time 21:56:12
D. Date 09/17/2007
B. Motherboard Device Configuration
M. Memory and Cache Optimization
C. System Clock/PLL Configuration
P. Power Management
I. Device Information
H. Miscellaneous Configuration
O. Boot Order
L. Load Defaults
S. Save Values Without Exit
Q. Exit Without Save
X. Save values and Exit

Set the current time in the RTC
```

Abbildung 71: Main Menu

Die einzelnen Menüpunkte werden in den folgenden Abschnitten jeweils ausführlich erklärt.

Shortcutaufruf	BIOS Setup Menü	Funktion
Т	Time 21:56:12	Hier kann man die Systemzeit konfigurieren.
D	Date 09/17/2007	Hier kann man das Systemdatum konfigurieren.
В	Motherboard Device Configuration	Hier kann man Motherboard Ressourcen konfigurieren.
М	Memory and Cache Optimization	Hier kann man Einstellungen für die Speicherverwaltung vornehmen.
С	System Clock/PLL Configuration	Hier kann man die Einstellungen für das Timing vornehmen.
P	Power Management	Einstellen von verschiedenen APM (Advanced Power Management) Optionen.
I	Device Information	Hier werden wichtige Parameter (z.B. Temperatur, Mode/Node Stellung, usw.) eines Mobile Panel Gerätes angezeigt.
Н	Miscellaneous Configuration	Hier kann man die verschiedenen BIOS Einstellungen konfigurieren (Summary Screen, Halt On Errors, usw.)
0	Boot Order	Hier kann die Bootreihenfolge festgelegt werden.
L	Load Defaults	Laden der optimalen BIOS Einstellungen für beste Performance.

Tabelle 47: Übersicht BIOS Hauptmenü Funktionen

Shortcutaufruf	BIOS Setup Menü	Funktion	
s	Save Values without Exit	BIOS Werte sichern ohne das BIOS Setup zu verlassen.	
Q Exit without Save So beendet man das BIOS Setup ohne eventuell gemachte Veränderungen zu		So beendet man das BIOS Setup ohne eventuell gemachte Veränderungen zu speichern.	
Х	Save Values and Exit	Mit dieser Option werden die Einstellungen gespeichert und das BIOS Setup beendet.	

Tabelle 47: Übersicht BIOS Hauptmenü Funktionen (Forts.)

1.3.2 Time

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice
                               = Main Menu :
T. Time 21:56:12
D. Date 02/28/2007
B. Motherboard Device Configuration
M. Memory and Cache Optimization
C. System Clock/PLL Configuration
P. Power Management
I. Device Information
H. Miscellaneous Configuration
O. Boot Order
L. Load Defaults
S. Save Values Without Exit
Q. Exit Without Save
X. Save values and Exit
              Main Menu/T. Time
TIME as HH:MM[:SS] (Seconds are optional)
```

Abbildung 72: Time

Hier wird die aktuell eingestellte Systemzeit angezeigt. Die Zeit wird nach Ausschalten des Panel PC 300 Gerätes durch eine Batterie (CMOS-Batterie siehe Abschnitt "Batterie", auf Seite 31) gepuffert.

Durch Auswahl des Punktes "Time" und nachfolgendem Bestätigen durch "Return" oder durch den Shortcut "T" kann eine neue Systemzeit eingegeben werden. Das Format HH:MM[:SS] muss wie im nachfolgenden Beispiel eingegeben werden:

Beispiel: Zeit auf 13:00:00 einstellen.

Eingabe über Tastatur kann auf 3 verschiedene Arten erfolgen:

- 13:00:00 durch "Return" bestätigen
- 13:00 durch "Return" bestätigen
- 13: durch "Return" bestätigen

Information:

Wenn man eine deutsche Tastatur verwendet, wird ":" durch Drücken der Taste "Shift+ö" eingegeben.

1.3.3 Date

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice
                               — Main Menu =
T. Time 21:56:12
D. Date 02/28/2007
B. Motherboard Device Configuration
M. Memory and Cache Optimization
C. System Clock/PLL Configuration P. Power Management
I. Device Information
H. Miscellaneous Configuration
O. Boot Order
L. Load Defaults
S. Save Values Without Exit
Q. Exit Without Save
X. Save values and Exit
                   _____ Main Menu/D. Date =
Date as MM/DD/YYYY
```

Abbildung 73: Date

Hier wird das aktuelle Systemdatum angezeigt. Das Datum wird nach Ausschalten des Panel PC 300 Gerätes durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.

Durch Auswahl des Punktes "Date" und nachfolgendem Bestätigen durch "Return" oder durch den Shortcut "D" kann ein neues Systemdatum eingegeben werden. Das Format MM:DD:YYYY muss wie im nachfolgenden Beispiel eingeben werden:

Beispiel: Datum auf 12.02.2007 einstellen.

Eingabe über Tastatur:

12/02/2007 - durch "Return" bestätigen

Information:

Wenn man eine deutsche Tastatur verwendet, wird "/" durch Drücken der Taste "-" (neben der "Shift" Taste) eingegeben.

1.3.4 Motherboard Device Configuration

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Motherboard Device Configuration
B. I/O Configuration
B. I/O Configuration
F. Video and Flat Panel Configuration
G. PCI Configuration
U. USB Configuration
T. Thermal Configuration
R. Return Main Menu

Set configuration for Hard Drive, Floppy Drive and Flash devices
```

Abbildung 74: Motherboard Device Configuration

Shortcutaufruf	BIOS Setup Menü	Funktion
Α	Drive Configuration	Einstellungen für Floppy Laufwerk und CompactFlash Karte.
В	I/O Configuration	Konfigurieren der I/O Geräte.
F	Video and Flat Panel Configuration	Anzeigen der Videoeinstellungen und Konfiguration der Displayparameter Auflösung, Helligkeit und Kontrast.
G	PCI Configuration	Konfiguration der PCI Bus Einstellungen.
U	USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.
Т	Thermal Configuration	Anzeige der Temperaturen.
R	Return to Main Menu	Rückkehr zum BIOS Hauptmenü.

Tabelle 48: BIOS Motherboard Device Configuration Menü

Motherboard Device Configuration - Drive Configuration

```
The state of drives's PIO/MDMA/UDMA capabilities

XpressROM Setup

XpressROM Setup

XpressROM Setup

ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Drive Configuration

IDE Configuration

IDE BIOS Support: Enabled

DMA/UDMA BIOS Support: Enabled

Force mode for CF Card: Auto

Boot Support Configuration

Floppy BIOS Support: Enabled

CD-ROM Boot BIOS Support: Enabled

USB BIOS Support: Enabled

USB BIOS Support: Enabled
```

Abbildung 75: Motherboard Device Configuration - Drive Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IDE BIOS Support	Anzeige der IDE Konfiguration des Panel PC 300.	keine	-
DMA/UDMA BIOS Support	Anzeige der DMA/UDMA BIOS Support Unterstützung der gesteckten Compact- Flash Karte.	keine	-

Tabelle 49: BIOS Drive Configuration Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Force mode for CF Card	transfermode von bzw. zu einer Compact- Flash Karte einstellen.	Auto	Es wird der schnellste von der gesteckten Com- pactFlash Karte unterstützte Mode automatisch verwendet.
	Information: Wird ein Mode eingestellt, welcher von	PIO 0 (3,3 MByte/s)	Manuelle Einstellmöglichkeit des PIO (programmierten Input/Output) Modus.
	der CompactFlash nicht unterstützt	PIO 1 (5,2 MByte/s)	
	wird, so wird der schnellste unterstütz- te Modus eingestellt.	PIO 2 (8,3 MByte/s)	
		PIO 3 (11,1 MByte/s)	
		PIO 4 (16,6 MByte/s)	
		MDMA 0 (4,2 MByte/s)	Manuelle Einstellmöglichkeit des MDMA (Multi-
		MDMA 1 (13,3 MByte/s)	word DMA) Modus.
		MDMA 2 (16,6 MByte/s)	
		UDMA 0 (16,6 MByte/s)	Manuelle Einstellmöglichkeit des UDMA (Ultra- DMA) Modus.
		UDMA 1 (25,0 MByte/s)	
		UDMA 2 (33,3 MByte/s)	
		UDMA 3 (44,4 MByte/s)	
		UDMA 4 (66,6 MByte/s)	
		UDMA 5 (100,0 MByte/s)	
Floppy BIOS Sup-	Hier kann der Floppy Support (USB) akti-	Enabled	Floppy Support aktiviert.
port	viert/deaktiviert werden.	Disabled	Floppy Support deaktiviert.
	Hier kann der CD-ROM Boot BIOS Support aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	CD-ROM Boot Support aktiviert. Das Booten von einem angeschlossenen USB CD ROM Laufwerk wird ermöglicht.
		Disabled	CD-ROM Boot Support deaktiviert.
USB BIOS Support	Hier kann der USB BIOS Support akti-	Enabled	USB BIOS Support aktiviert.
	viert/deaktiviert werden.	Disabled	USB BIOS Support deaktiviert.

Tabelle 49: BIOS Drive Configuration Menü (Forts.)

Motherboard Device Configuration - I/O Configuration

```
XpressROM Setup

F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

I/O Configuration

COM C: 0x3f8 IRQ 4

COM D: 0x2f8 IRQ 3

Configure the external UART.
```

Abbildung 76: Motherboard Device Configuration - I/O Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COM C	M C Hier können Einstellungen der seriellen COM Schnittstelle am PPC300 vorgenommen werden. Information: Der Port kann nicht den selben Adressbereich und Interrupt wie COM D verwenden.	Disabled	Keine Zuweisung. Die serielle Schnittstelle ist deaktiviert.
		0x3f8 IRQ 4	Diesen Adressbereich und Interrupt verwenden.
		0x2f8 IRQ 3	
		0x3e8 IRQ 4	
		0x2e8 IRQ 3	
		0x3f8 IRQ 12	
		0x2f8 IRQ 11	
		0x3e8 IRQ 12	
		0x2e8 IRO 11	

Tabelle 50: BIOS Super I/O Configuration Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung	
COM D	Hier können Einstellungen der COM D, welche für den Touch Screen eines AP900 reserviert ist, vorgenommen werden. Information: Der Port kann nicht den selben Adressbereich und Interrupt wie COM C verwenden.	Disabled	Keine Zuweisung. Der Touch Screen beim AP900 wird deaktiviert und funktioniert nicht.	
		, ,	0x3f8 IRQ 4	Diesen Adressbereich und Interrupt verwenden.
		0x2f8 IRQ 3		
		0x3e8 IRQ 4		
		0x2e8 IRQ 3		
		0x3f8 IRQ 12		
		0x2f8 IRQ 11		
		0x3e8 IRQ 12		
		0x2e8 IRQ 11		

Tabelle 50: BIOS Super I/O Configuration Menü (Forts.)

Motherboard Device Configuration - Video and Flat Panel

```
XpressROM Setup

F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Video and Flat Panel

Graphics Memory: 008
Output Display: Flat Panel

Flat Panel Configuration
  Type: TFT
  Contrast: AUTO
  Brightness: AUTO

Select graphics memory size. Use even numbers of MBytes only.
```

Abbildung 77: Motherboard Device Configuration - Video and Flat Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Graphics Memory	Anzeige der aktuellen Grafikspeichergrö- ße, die vom Hauptspeicher reserviert wird.	2 - 254	Die ausgewählte MB Größe wird vom Hauptspei- cher für die Videoanzeige reserviert.
Output Display	Auswahl des Anzeigemodus	keine	Anzeige des Displaysausgabegerätes.
Туре	Auswahl des Automation Panel 900 Typs	keine	Typanzeige

Tabelle 51: BIOS Video Configuration Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Contrast	Einstellung des Kontrast für LCD Displays.	Auto	Keine Auswirkung, da alle AP900 ein TFT Display besitzen.
		0% bis 100%	Keine Auswirkung, da alle AP900 ein TFT Display besitzen.
Brightness	Einstellung der Hintergrundbeleuchtungs- stärke des Displays.	Auto	Die optimale Helligkeit wird über die Factory Set- tings automatisch konfiguriert. Dabei wird ein Hel- ligkeitswert zwischen 100% und 0% eingestellt.
		0% bis 100%	Manuelle Einstellung der gewünschten Helligkeit innerhalb der Grenzwerte der Factory Settings.

Tabelle 51: BIOS Video Configuration Menü (Forts.)

Motherboard Device Configuration - PCI Configuration

```
XpressROM Setup

F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

PCI Configuration

PCI Interrupt Steering

PCI INTA#: IRQ 10

PCI INTC#: IRQ 5

PCI INTD#: IRQ 7

Enable/Disable INTA# to IRQ steering
```

Abbildung 78: Motherboard Device Configuration - PCI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI INTA#	Einstellung des IRQ für den VGA Kontroller.	Disabled	Es wird kein IRQ reserviert.
		3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 oder 15	Zuweisen dieses IRQs.
	I INTB# Einstellung des IRQ für den Audio Kontroller.	Disabled	Es wird kein IRQ reserviert.
		3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 oder 15	Zuweisen dieses IRQs.
PCI INTC#	Einstellung des IRQ für die ETH1 Schnittstelle.	Disabled	Es wird kein IRQ reserviert. Die ETH1 Schnittstelle funktioniert nicht.
		3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 oder 15	Zuweisen dieses IRQs.

Tabelle 52: BIOS PCI Configuration Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI INTD#	Einstellung des IRQ für die ETH2 und USB Schnittstellen.	Disabled	Es wird kein IRQ reserviert. ETH2 und die USB Schnittstellen am AP900 funktionieren nicht.
		3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 oder 15	Zuweisen dieses IRQs.

Tabelle 52: BIOS PCI Configuration Menü (Forts.)

Motherboard Device Configuration - USB Configuration

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

USB 2.0 Settings
OHCI: Enabled
EHCI: Enabled
OTC: Disabled
OTC: Disabled
Overcurrent reporting: Disabled
Port 4 assignment: Host

Enable/Disable OHCI FCI header
```

Abbildung 79: Motherboard Device Configuration - USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
OHCI	Ein-/ Ausschalten des USB Support	Enabled	Aktivierung des USB-Ports.
	1.0/ 1.1 (OHCI - Open Host Controller Interface).	Disabled	Deaktivierung des USB-Ports.
EHCI	Ein-/ Ausschalten des USB Support 2.0	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	(EHCI=Enhanced Host Controller Interface).	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
UDC	Ein-/ Ausschalten des USB Device cont- rollers. Bei Ein wird im BIOS nur der PCI config Space aktiviert	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
OTG	Ein-/ Ausschalten des On-to-Go device.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	Im BIOS wird der PCI Config Space aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	nt repor- Mit dieser Funktion wird bei Überlastung des USB Hubs automatisch eine Fehler- meldung (z.B. bei Windows XP embed- ded) an das System gesendet.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
ting		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 53: BIOS USB Configuration Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Port 4 assignment	Mit dieser Option kann der USB Port 4 konfiguriert werden. Der USB Port 4 wird beim PPC300 nicht verwendet, somit hat diese Option keine Funktion.	Host	Arbeitet als Host.
		Device	Arbeitet als Device.
		Not used	Im BIOS wird der Defaultwert (=Host) zugeteilt.

Tabelle 53: BIOS USB Configuration Menü

Motherboard Device Configuration - Thermal Configuration

```
XpressROM Setup

F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Thermal Configuration

Temperatures

CPU Intern: 55°C
Board I/O: 42°C
Display: 35°C

Fan: ORPM
CMOS Battery: OK

Close Sub Menu
```

Abbildung 80: Motherboard Device Configuration - Thermal Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CPU Intern	Anzeige der aktuellen internen Prozessor Temperatur.	keine	-
Display	Anzeige der aktuellen Display Temperatur.	keine	-
Board I/O	Anzeige der aktuellen Board I/O Temperatur.	keine	-
Fan	Lüfterumdrehungsanzeige des ausgewählten Panels.	keine	-
CMOS Battery	Hier wird der Batteriestatus der eingebauten CMOS Batterie angezeigt. Mögliche Anzeigen: OK - Batterie in Ordnung, Bad - Batterie muss getauscht werden.	keine	

Tabelle 54: BIOS Thermal Configuration Menü

1.3.5 Memory and Cache Optimization

Warnung!

Diese Parameter sind nur für Systemdesigner, Servicepersonal und entsprechend qualifizierte Anwender von Interesse. Man sollte nur jene Einstellungen ändern, deren Bedeutung man wirklich versteht.

Die falsche Einstellung der "Memory Optimization" Werte, kann zu Instabilität oder sogar zu Nichtbooten des ganzen Systems führen. Wenn sich nun der PPC300 nicht mehr booten lässt, können durch 3-maliges Drücken des Reset Tasters die BIOS Default Werte wiederhergestellt werden (siehe Abschnitt 1.4.8 "Wiederherstellen der BIOS Defaultwerte", auf Seite 137).

Information:

Detailliertere Informationen über die Bedeutung und Auswirkung der Einstellungen kann man auch dem entsprechenden Prozessor Handbuch entnehmen.

```
XpressROM Setup

F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Memory and Cache Optimization

Cache Mode: Write-Back
Cache Allocate: Disabled

Refresh Rate: Auto
```

Abbildung 81: Memory and Cache Optimization

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Cache Mode	Unter Cache Mode werden die Schreibzu- griffe auf den Cache festgelegt.	Write-Back	Die Daten werden nur bei Bedarf in den Haupt- speicher geschrieben (Hauptspeicher und Cache haben nicht den gleichen Informationsinhalt).
		Write-Through	Die Daten werden in den Cache und in den Hauptspeicher geschrieben.
Cache Allocate	Der Cache wird in verschiedene Speicherebenen aufgeteilt.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
Refresh Rate	Hier kann der Refresh Zyklus eingestellt	Auto	Automatische Auswahl des Wertes.
	werden. Hinweis: Eingabe der Taktfrequenz, den Rest er- ledigt der Chipsatz.	15µs, 3µs, 7µs, 31µs, 62µs oder 125µs	Manuelle Einstellung des Wertes.

Tabelle 55: BIOS Memory and Cache Optimization Menü

1.3.6 System Clock/PLL Configuration

```
XpressROM Setup

F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

System Clock/PLL Configuration

Clock Mode

Clock Determined By: H/W Strapping

Manual PLL Settings

CPU Multiplier: 500 MHz

RAM Multiplier: 333 MHz
```

Abbildung 82: System Clock/PLL Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Clock Determined By	Mit dieser Option kann der Prozssortakt eingestellt werden.	H/W Strapping	Automatische Einstellung der Werte "CPU Multiplier" bzw. "RAM Multiplier".
		Manual Settings	Manuelle Einstellung der Werte (CPU Multiplier und RAM Multiplier).

Tabelle 56: System Clock/PLL Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CPU Multiplier	Unter dieser Option kann der Multiplikator der CPU ausgewählt werden. Nur auswählbar wenn "Clock Determind By" auf " Manual Setting" gestellt ist.	233, 266, 300, 333, 366, 400, 433, 466 oder 500 MHz	Manuelle Einstellung des Wertes.
RAM Multiplier	Unter dieser Option kann der Multiplikator des RAM ausgewählt werden.	200, 233, 266, 300, 333, 366 oder 400 MHz	Manuelle Einstellung des Wertes.

Tabelle 56: System Clock/PLL Configuration

1.3.7 Power Management

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

BIOS PM at Boot: Disabled

APM Available: Yes
ACPI Available: Yes
S1 Clocks: Off

CPU Clock Gating: Enabled
Chipset Clock Gating: Enabled
Power Button Configuration
Power Loss Control: Power On
Power Button: ACPI Mode

BIOS will turn on Legacy PM before booting the OS.
```

Abbildung 83: Power Management

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
BIOS PM at Boot	Das Power Management ist schon wäh-	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	rend der Bootphase aktiv.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
APM Available	Unter dieser Option wird eingestellt, ob	Yes	Aktivierung der Funktion.
	das Betriebssystem die Power Manage- ment Einstellungen des BIOS verändem darf.	No	Deaktivierung der Funktion.
ACPI Available	Bei der ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Option handelt es sich um eine erweiterte PnP und Power Management-Funktion.	Yes	Aktivierung der Funktion.
		No	Deaktivierung der Funktion.
S1 Clocks	Mit dieser Option kann der Prozessor "still gelegt" werden. Ist erst dann aktiv, wenn der Prozessor in diesen Status versetzt wird.	Off	Deaktivierung der Funktion.
		On	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 57: BIOS Power Management Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CPU Clock Gating	Die Clockleitungen werden im Falle eines	Enabled	Aktivierung der Funktion.
	PM für Geräte die an dem Chipset bzw. der CPU hängen ausgeschaltet.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Chipset Clock	Die Clocks werden nie ausgeschaltet.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Gating		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Loss Control	Diese Option legt fest was nach einem Stromausfall passieren soll.	Power On	Gerät schaltet wieder ein.
		Stay Off	Gerät bleibt ausgeschaltet.
Power Button	Diese Option legt fest, welche Funktion der Power Taster haben soll.	ACPI Mode	Wird der Power Button für die Dauer von 4 Se- kunden gedrückt, dann wird der PPC300 ohne herunterfahren des Betriebssystems ausgeschal- tet.
		Instant Off	Schaltet sofort aus.

Tabelle 57: BIOS Power Management Menü (Forts.)

1.3.8 Device Information

Abbildung 84: Device Information

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
MTCX FPGA	Hier wird die FPGA Firmwareversion angezeigt.	keine	-
MTCX PX32	Hier wird die MTCX Firmwareversion angezeigt.	keine	-
MTCX KCF	Hier wird die KCF (Key Configuration File) Version angezeigt.	keine	-
BIOS	Hier wird die BIOS Version angezeigt.	keine	-

Tabelle 58: BIOS Device Information Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
FACT	Hier wird die Version der Factory Settings angezeigt.	keine	
ETH2 PXE	Hier wird die MAC Adresse der ETH2 Schnittstelle angezeigt.	keine	-
ETH1	Hier wird die MAC Adresse der ETH1 Schnittstelle angezeigt.	keine	-
Factory Settings			
Device ID	Hexwertanzeige der Gerätekennung des Panel PC 300 Einschubes.	keine	-
Comp. ID	Hier wird die Kompatibilitätskennung des Panel PC 300 Einschubes angezeigt.	keine	
Serial Nr.	Hier wird die Serialnummer des Panel PC 300 Einschubes angezeigt.	keine	-
Product Name	Hier wird der Produktname des Panel PC 300 Einschubes angezeigt.	keine	-
User ID	Hier wird die Benutzererkennung des Pa- nel PC 300 Einschubes angezeigt. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem An- wender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen "B&R Control Cen- ter" über den ADI Treiber verändert wer- den.	keine	•
Factory Settings Pa	nel		
Device ID	Hexwertanzeige der Gerätekennung des Automation Panels.	keine	
Comp. ID	Hier wird die Kompatibilitätskennung des Automation Panels angezeigt.	keine	-
Serial Nr.	Hier wird die Serialnummer des Automation Panels angezeigt.	keine	-
Product Name	Hier wird der Produktname des Automation Panels angezeigt.	keine	-

Tabelle 58: BIOS Device Information Menü (Forts.)

1.3.9 Miscellaneous Configuration

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Miscellaneous Configuration
Boot Logo Configuration
Boot Logo: Enabled
Clear Boot Logo: Enabled
Boot Logo Timeout: 0000
Summary Screen Configuration
Summary Screen: Enabled
Summary Screen Timeout: 0000
PC Speaker Configuration
AC Beeper: Enabled
Security Option
Password: None

Enable/Disable display of Boot Logo
```

Abbildung 85: Miscellaneous Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Logo ¹⁾	Anzeige eines Boot Logos während des Startens vom Panel PC 300.	Disabled	Es wird kein User Boot Logo während des Bootens angezeigt.
		Enabled	Ein User Boot Logo wird während des Bootens angezeigt.
Clear Boot Logo	Das BIOS löscht automatisch nach dem	Disabled	Das Boot Logo wird Gelöscht.
	Start das Boot Logo um die Zeit des Bootens zu verkürzen.	Enabled	Deaktivierung der Funktion.
Boot Logo Timeout	Zeitdefinition, wie lange die Meldung "Press DEL for Setup" am Display angezeigt wird und wie lange der Anwender Zeit hat, um in die BIOS Konfiguration zu wechseln. Hinweis: Durch Drücken einer beliebigen Tastekann vor Ablauf des Timeouts fortgesetzt werden.	0000	Kein Warten.
		1-65535 [Millisekunden]	Der manuell eingestellte Wert in Millisekunden wird gewartet, bis der Bootvorgang fortgesetzt wird.
Summary Screen	Zeigt Informationen über BIOS, VGA,	Disabled	Summary Screen anzeigen.
	VSA Version, gefundene Geräte, etc. an.	Enabled	Summary Screen ausblenden.
Summary Screen	Zeitdefinition, wie lange der Summary Screen angezeigt wird. Hinweis: Durch Drücken einer beliebigen Taste kann vor Ablauf des Timeouts fortge- setzt werden.	0	Kein Warten.
Timeout		1-65535 [Millisekunden]	Der manuell eingestellte Wert in Millisekunden wird gewartet, bis der Bootvorgang fortgesetzt wird.

Tabelle 59: BIOS Miscellaneous Configuration Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
AC Beeper	Der Pieton nach dem Starten kann hier	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	ein-/ausgeschaltet werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
Password	Hier kann ein Passwort für das BIOS Se-	None	Kein Passwort.
	tup eingegeben werden. Ohne Passwort können keine Änderungen vorgenommen werden.	Enter Password	Manuelle Eingabe eines Passwortes (max. 8 Zeichen).

Tabelle 59: BIOS Miscellaneous Configuration Menü (Forts.)

1) Im Auslieferungszustand ist kein Boot Logo vorkonfiguriert.

1.3.10 Boot Order

```
XpressROM Setup
Fl/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice

Boot Order Configuration
1. USB Floppy Disk
2. USB CD-ROM Drive
3. Hard Drive
4. USB Hard Drive
CF card Info
Model Number: SILICONSYSTEMS INC 128MB
Capabilities: LBA, PIO 4, MDMA 2
Phy. Geometry: 993 Cyl, 8 Hds, 32 SpT
Log. Geometry: 993 Cyl, 8 Hds, 32 SpT
```

Abbildung 86: Boot Order

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten		Wirkung
Boot Order Configuration	Einstellung der Bootreihenfolge der Speichermedien. Wenn zwei gleiche Geräte ausgewählt werden, wird eine "Conflict" Warnung angezeigt.	1	USB Floppy Disk	Es wird versucht, von diesem eingestellten Laufwerk als Erstes zu booten.
			USB CD-ROM Drive	
			Hard Drive	
			USB Hard Drive / Flash Drive	
			None	
			USB Floppy Disk	Es wird versucht, von diesem eingestellten Laufwerk als Zweites zu booten.
			USB CD-ROM Drive	
		2	Hard Drive	
			USB Hard Drive / Flash Drive	
			None	
			USB Floppy Disk	Es wird versucht, von diesem eingestellten Lauf-
			USB CD-ROM Drive	werk als Drittes zu booten.
		3	Hard Drive	
			USB Hard Drive / Flash Drive	
			None	
		4	USB Floppy Disk	Es wird versucht, von diesem eingestellten Lauf werk als Viertes zu booten.
			USB CD-ROM Drive	werk als viertes zu dooten.
			Hard Drive	
			USB Hard Drive / Flash Drive	
			None	
Model Number	Anzeige der CompactFlash Modellbezeichnung.		keine	-
Capabilities	Anzeige der möglichen Datentransfermo- degeschwindigkeiten von bzw. zu der gesteckten CompactFlash Karte.		keine	-
Phy. Geometry	Anzeige der physikalischen Geometrie der gesteckten CompactFlash Karte in Zylinder, Heads und Sektoranzahl.		keine	-
Log. Geometry	Anzeige der logischen Geometrie der gesteckten CompactFlash Karte in Zylinder, Heads und Sektoranzahl.		keine	-

Tabelle 60: BIOS Drive Configuration Menü

1.3.11 Load Defaults

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice
                                 Main Menu
T. Time
          = Info
D. Date
        Defaults set!
B. Moth
M. Memc
C. Syst
P. Powe
  Devi
H. Misc
O. Boot
  Save
        Hit any key to continue
X. Save values and Exit
Set the current time in the RTC
```

Abbildung 87: Load Defaults

Bei diesem BIOS Menüpunkt (Shortcut "L") werden die BIOS Default Werte für alle Einstellungen wiederhergestellt. Alle Änderungen, die bis dahin gemacht wurden, gehen damit verloren.

Wiederherstellen der BIOS Defaultwerte

Für den Fall, dass die BIOS Einstellungen derart verstellt wurden (z.B. USB Keyboard Support deaktiviert, Absturz beim Betriebssystemstart) besteht die Möglichkeit nach dreimaligem Drücken des Reset Tasters (Ablauf: Drücken - Warten auf Pieps - Drücken - Warten auf Pieps) automatisch die BIOS Defaultwerte wiederherzustellen.

1.3.12 Save Values Without Exit

```
XpressROM Setup
F1/ALT+H:Show Help ESC:Exit ALT+Q:Go to Main Menu ENTER:Select +/-:Choice
                                 = Main Menu =
T. Time
          = Info =
D. Date
        Settings Saved!
B. Moth
M. Memo
C. Syst
P. Powe
I. Devi
H. Misc
O. Boot
L. Load
S. Save Q. Exit Hit any key to continue_
X. Save values and Exit
Set the current time in the RTC
```

Abbildung 88: Save Values Without Exit

Bei diesem BIOS Menüpunkt (Shortcut "S") werden die BIOS Werte gesichert. Danach kann man weitere Einstellungen vornehmen oder das BIOS Setup verlassen.

1.3.13 Exit Without Save

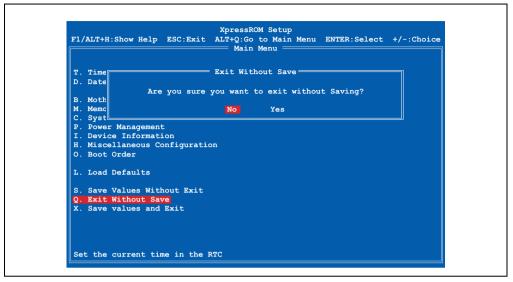


Abbildung 89: Exit Without Save

Bei diesem BIOS Menüpunkt (Shortcut "Q") kann man das BIOS Setup durch Bestätigung von "Yes" verlassen, ohne eventuell gemachte Veränderungen zu speichern. Danach wird das System automatisch neu gestartet.

Information:

Wenn man eine deutsche Tastatur verwendet, wird "y" durch drücken der Taste "z" eingegeben.

1.3.14 Save values and Exit

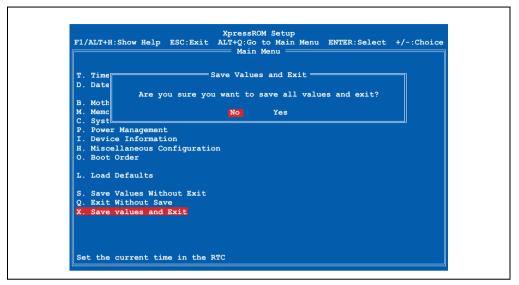


Abbildung 90: Save values and Exit

Bei diesem Menüpunkt (Shortcut "X") werden die Einstellungen durch Bestätigung von "Yes" gespeichert, das BIOS Setup automatisch beendet und ein Reboot des Systems durchgeführt.

Information:

Wenn man eine deutsche Tastatur verwendet, wird "y" durch drücken der Taste "z" eingegeben.

1.4 BIOS Defaultwerte

Die BIOS Default Werte sind die BIOS Einstellungen, welche den Auslieferungszustand des PPC300 entsprechen.

1.4.1 Motherboard Device Configuration

Drive Configuration	Defaultwert
IDE BIOS Support	Enabled
DMA/UDMA BIOS Support	Enabled
Force mode for CF Card	Auto
Floppy BIOS Support	Enabled
CD-ROM Boot BIOS Support	Enabled
USB BIOS Support	Enabled
I/O Configuration	
COM C	0x3f8 IRQ 4
COM D	0x2f8 IRQ 3
Video and Flat Panel Configuration	
Graphics Memory	008
Output Display	
Туре	-
Contrast	Auto
Brightness	Auto
PCI Configuration	
PCI INTA#	IRQ 10
PCI INTB#	IRQ 11
PCI INTC#	IRQ 5
PCI INTD#	IRQ 7
USB Configuration	
OHCI	Enabled
EHCI	Enabled
UDC	Enabled
OTG	Disabled
Overcurrent reporting	Disabled
Port 4 assignment	Host
Thermal Configuration	
CPU Intern	-
Board I/O	-
Display	-

Tabelle 61: Motherboard Device Configuration Defaultwerte

Drive Configuration	Defaultwert
Fan	-
Battery	

Tabelle 61: Motherboard Device Configuration Defaultwerte (Forts.)

1.4.2 Memory and Cache Optimization

Einstellung	Defaultwert
Cache Mode	Write-Back
Cache Allocate	Disabled
Refresh Rate	Auto

Tabelle 62: Memory and Cache Optimization Defaultwerte

1.4.3 System Clock/PLL Configuration

Einstellung	Defaultwert
Clock Determined By	H/W Strapping
CPU Multiplier	500 MHz
RAM Multiplier	333 MHz

Tabelle 63: System Clock/PLL Configuration Defaultwerte

1.4.4 Power Management

Einstellung	Defaultwert
BIOS PM at Boot	Disabled
APM Available	Yes
ACPI Available	Yes
S1 Clocks	Off
CPU Clock Gating	Enabled
Chipset Clock Gating	Enabled
Power Loss Control	Power On
Power Button	ACPI Mode

Tabelle 64: Power Management Defaultwerte

1.4.5 Device Information

Diese BIOS Seite dient nur als Informtationsseite - somit sind keine BIOS Defaultwerte verfügbar.

1.4.6 Miscellaneous Configuation

Einstellung	Defaultwert
Boot Logo	Enabled
Clear Boot Logo	Enabled
Boot Logo Timeout	00000
Summary Screen	Enabled
Summary Screen Timeout	00000
AC Beeper	Enabled
Password	None

Tabelle 65: Miscellaneous Configuation Defaultwerte

1.4.7 Boot Order

Einstellung	Defaultwert
1.	USB Floppy Disk
2.	USB CD-ROM Drive
3.	Hard Drive
4.	USB Hard Drive/Flash Drive

Tabelle 66: Boot Order Defaultwerte

1.4.8 Wiederherstellen der BIOS Defaultwerte

Für den Fall, dass die BIOS Einstellung derart verstellt wurden (z.B. USB Keyboard Support deaktiviert, Absturz beim Betriebssystemstart) besteht die Möglichkeit nach dreimaligem Drücken des Reset Tasters (Ablauf: Drücken - Warten auf Pieps - Drücken - Warten auf Pieps) automatisch die BIOS Defaultwerte wiederherzustellen.

1.5 BIOS und Firmware (MTCX) Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

 Um die implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder Komponenten hinzuzufügen (Informationen über Änderungen können der Liesmich bzw. der Readme Dateien entnommen werden).

Aktuelle BIOS und Firmware Upgrades können direkt über den Servicebereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden kann.

1.5.1 BIOS Upgrade Vorgang

- 1. Kopieren Sie alle Dateien auf eine bootfähige Diskette (USB Diskettenlaufwerk erforderlich) oder einen bootfähigen USB Memory Stick.
- 2. Stecken Sie das Diskettenlaufwerk samt Diskette bzw. USB Memory Stick an einen freien USB Steckplatz an das Automation Panel 900 Gerät.

Vor dem BIOS Upgrade eventuell vorgenommene BIOS Einstellungen notieren!

- 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenü mit folgenden Optionen angezeigt:
- 1. Update BIOS => Default nach 5 sec

Nach einem BIOS Update werden vom BIOS automatisch die CMOS Defaulteinstellungen verwendet. Wenn Sie Einstellungen im BIOS Setup geändert haben, müssen Sie diese nach dem Update wieder neu einstellen!

Ein BIOS Upgrade darf nicht unterbrochen werden.

2. Save BIOS (into directory SAVED)

Das BIOS wird automatisch im Verzeichnis SAVED gesichert. Auf der Diskette müssen ca. 256 kBytes freier Platz vorhanden sein.

3. Exit

Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade Diskette / USB Stick entfernen und das Gerät neu starten.

Information:

Ein BIOS Upgrade kann auch direkt mittels B&R Control Center (über direkten Auswahl der BIOS ROM Datei) unter den Betriebssystemen Windows XP embedded und Windows CE durchgeführt werden.

1.5.2 MTCX Firmware Upgrade

- 1. Kopieren Sie alle Dateien auf eine bootfähige Diskette (USB Diskettenlaufwerk erforderlich) oder einen bootfähigen USB Memory Stick.
- 2. Stecken Sie das Diskettenlaufwerk samt Diskette bzw. USB Memory Stick an einen freien USB Steckplatz an das Automation Panel 900 Gerät.
- 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenü mit folgenden Optionen angezeigt:
- 1. Upgrade MTCX Firmware FPGA and PX32 (PC3F/PC3P)

Die MTCX Firmware FPGA und PX32 wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec).

Der Update-Vorgang darf nicht abgebrochen werden!

2. Exit.

Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade Diskette / USB Stick entfernen und das Gerät neu starten.

Information:

Ein BIOS Upgrade kann auch direkt mittels B&R Control Center (über direkte Auswahl der BIOS ROM Datei) unter den Betriebssystemen Windows XP embedded und Windows CE durchgeführt werden.

1.5.3 User Boot Logo

Es ist möglich ein eigens erstelltes User Boot Logo (Bitmap Datei) auf den PPC300 zu übertragen. Zum Erstellen der Datei ist das "B&R User Boot Logo Konvertierungsprogramm" (zu finden als kostenloser Download im Servicebereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) erforderlich, welches aus der Bitmap Datei eine *.rom Datei generiert, welche danach z.B. mittels B&R Control Center auf den PPC300 übertragen wird.

1.6 CMOS Backup

Zum Schutz der CMOS Daten wurde im BIOS ein CMOS Backup integriert. Wenn das BIOS Setup mit "Save Values and Exit" (siehe Abschnitt 1.3.14 "Save values and Exit", auf Seite 134) beendet wurde und der PPC300 erfolgreich neu startet, werden die CMOS Daten in das Flash Memory gebrannt. Wenn bei einem Start die CMOS Prüfsumme falsch ist (Batterie leer) oder der PPC300 dreimal hintereinander nicht korrekt bootet, werden die default BIOS Werte aus dem Flash Memory wieder in das CMOS kopiert und das System startet normal.

2. Windows CE



Abbildung 91: Windows CE Logo

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Anmerkung
5SWWCE.0523-ENG	WinCE5.0 Pro PPC300 LX800 Microsoft Windows CE 5.0 Professional englisch inklusive Lizenz; für PPC300 Geräte 5PC310.L800-00 und 5PC310.L800-01, CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MB).	
5SWWCE.0623-ENG	WinCE5.0 ProPlus PPC300 LX800 Microsoft Windows CE 5.0 Professional Plus englisch inklusive Lizenz; für PPC300 Geräte 5PC310.L800-00 und 5PC310.L800-01, CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MB).	

Tabelle 67: Bestellnummern Windows CE

2.1 Allgemeines

Windows CE ist ein Betriebssystem, das für das von B&R angebotene Gerät optimal zugeschnitten ist, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Dadurch ist dieses Betriebssystem äußerst robust und stabil.

2.1.1 Vorteile / Features

- Internet Explorer 6.0 for Windows® CE Standard Components
- Fonts für eine ansprechende Repräsentation von Texten
- TCP/IP f
 ür Netzwerk und Internet Kommunikation
- Remote Desktop Protocol (RDP) f
 ür Thin Client
- ActiveSync f
 ür den Abgleich mit dem PC
- Windows® Media Player Application
- Compact Framework V1.0 Service Pack 2
- Network Utilities
- VBScript 6.0
- JScript 6.0

Software • Windows CE

- Viewer f
 ür Excel, Word, Image, Pdf, PowerPoint (nur in Windows CE 5.0 ProPlus enthalten)
- Windows CE ist günstiger als eine andere Windows-Lizenz.

2.2 Unterschiede der verschiedenen CE Versionen (Pro - ProPlus)

	Pro ProPlus		
Ausstattung	5SWWCE.0523-ENG	5SWWCE.0623-ENG	
Windows CE Version	CE Version 5.0		
Bildschirmauflösung	VGA (TFT), SVGA	(TFT), XGA (TFT)	
Farbtiefe ¹⁾	16 Bit / 65	536 Farben	
Grafikkartentreiber	AMD Geode LX Grafikkartentreib	er mit Screenrotation ohne DirectX	
RAM	Automatische Erkennung und Verwendung von bis zu 512 MByte RAM		
Bootuptime	ca. 20 Sekunden		
Screenrotation	Der Desktop kann in 90° Schritten gedreht werden		
Webbrowser	Internet Explorer 6.0 für Windows CE		
.Net	Compact Framework 2.0 mit SP2		
Imagegröße	ca. 24 MByte nicht komprimiert ca. 25MByte nicht komprimiert		
Kundenspezifische Tasten Werden unterstützt		unterstützt	
PVI	Ja		
Automation Device Interface	Ja		
Serielle Schnittstellen	1 zur freien Verwendung		
PDF, Excel, Word, Power Point und Image Viewer	- Ja		

Tabelle 68: Unterschiede der CE Versionen (Pro - ProPlus)

2.3 Installation

Generell wird das Windows CE schon im Hause B&R vorinstalliert.

2.3.1 B&R eMbedded OS Installer

Mit dem B&R eMbedded OS Installer ist es möglich bestehende B&R Windows CE Images zu installieren. Es müssen dazu die 4 Dateien NK.BIN, BLDR, LOGOXRES.BMP und LOGOQV-GA.BMP von einer bereits funktionierenden B&R Windows CE Installation vorliegen.

Der B&R eMbedded OS Installer kann im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind der Online Hilfe des B&R eMbedded OS Installers zu entnehmen.

¹⁾ Die Farbtiefe ist abhängig vom verwendeten Display.

3. Windows XP embedded



Abbildung 92: Windows XP embedded Logo

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Anmerkung
5SWWXP.0423-ENG	WinXPe FP2007 PPC300 LX800 Microsoft Windows XP embedded englisch, Feature Pack 2007; für PPC300 Geräte 5PC310.L800-00 und 5PC310.L800-01, CompactFlash separat bestellen (mind. 512 MB). Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen Panel PC.	

Tabelle 69: Bestellnummern Windows XP embedded

3.1 Allgemeines

Windows XP embedded ist die modularisierte Version des Desktop Betriebssystems Windows XP Professional, das die schnelle Entwicklung von zuverlässigen verbundenen Geräten ermöglicht. Windows XP embedded basiert auf den gleichen Binaries wie Windows XP Professional und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows XP Professional liefert Windows XP embedded in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

3.2 Features mit FP2007 (Feature Pack 2007)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows XP embedded mit Feature Pack 2007 (FP2007).

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter	✓
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 6.0 + SP2	√

Tabelle 70: Gerätefunktionen unter Windows XP embedded mit FP2007

Software • Windows XP embedded

Funktion	vorhanden
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	/
Windows Firewall	/
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	/
Remote Desktop	/
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Codepages/User Locale/Keyboard	/
Disk Management Service	/
Windows Installer Service	/
Class Installer	/
CoDevice Installer	/
Media Player	-
DirectX	-
Accessories	/
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 70: Gerätefunktionen unter Windows XP embedded mit FP2007 (Forts.)

3.3 Installation

Generell wird das Windows XP embedded schon im Hause B&R auf einer geeigneten Compact-Flash Karte (mind. 512 MB - muss bei der Bestellung mitangegeben werden) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

Eine kurze Anleitung für die Erstellung eigener Windows XP embedded Images sowie ein passendes Target Designer Exportfile können im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

4. Automation Device Interface - ADI

Der ADI (Automation Device Interface) Treiber ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden. Das Control Center ist in den B&R Windows XP embedded und Windows CE Betriebssystemen bereits implementiert.

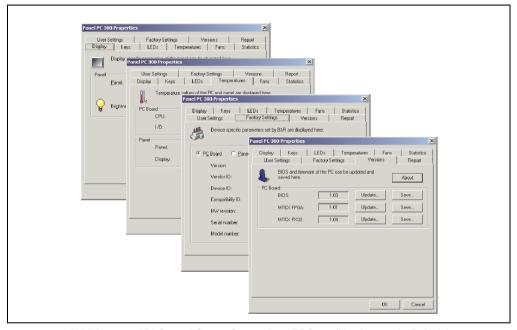


Abbildung 93: ADI Control Center Screenshots PPC300 (Version 1.10) - Beispiel

Features (geräteabhängig)

- Ändern der Displayhelligkeit von angeschlossenen Panels
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten (dazu muss auf dem Gerät eine Tastenkonfiguration installiert sein, die mit dem B&R Key Editor erstellt wurde)
- Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten und Statistikdaten
- Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von Firmware, Boot Logo
- Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)

Software • Automation Device Interface - ADI

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1. Gültige europäische Richtlinien

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Maschinenrichtlinie 98/37/EG ab 29.12.2009: 2006/42/EG

2. Normenübersicht

Die PPC300 als Gesamtgerät erfüllen folgende aufgelistete Normen:

Norm	Beschreibung
EN 55022 Klasse A	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktnorm Funkstöreigenschaften; Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte), Grenzwerte und Messverfahren
EN 55024	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Produktnorm Störfestigkeit; Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte), Grenzwerte und Messverfahren
EN 60060-1	Hochspannungs-Prüftechnik - Teil 2: Messsysteme
EN 60068-2-1	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfgruppe A: Kälte
EN 68068-2-2	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfgruppe B: Trockene Wärme
EN 60068-2-3	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung und Leitfaden: Feuchte Wärme, konstant
EN 60068-2-6	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung: Schwingen, sinusförmig
EN 60068-2-14	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung N: Temperaturwechsel
EN 60068-2-27	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung und Leitfaden: Schocken
EN 60068-2-30	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung und Leitfaden: Feuchte Wärme, zyklisch
EN 60068-2-31	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung: Kippfallen und Umstürzen, vornehmlich für Geräte
EN 60068-2-32	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung: Frei Fallen
EN 60664-1	Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen
EN 60721-1	Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 1: Vorzugswerte für Einflussgrößen
EN 60721-3-2	Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte, Hauptabschnitt 2: Transport
EN 60721-3-3	Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte, Hauptabschnitt 3: Ortsfester Einsatz, wettergeschützt

Tabelle 71: Normenübersicht

Normen und Zulassungen • Normenübersicht

Norm	Beschreibung
EN 61000-4-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität
EN 61000-4-3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestig- keit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
EN 61000-4-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestig- keit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst
EN 61000-4-5	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
EN 61000-4-6	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-6: Prüf- und Messverfahren; Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder
EN 61000-4-8	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-8: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestig- keit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
EN 61000-4-11	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-11: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
EN 61000-4-12	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-12: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen gedämpfte Schwingungen
EN 61000-6-2 (EN 50082-2)	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Fachgrundnorm Störfestigkeit - Teil 2: Industriebereich (EN 50082-2 wurde durch EN 61000-6-2 ersetzt)
EN 61000-6-4 (EN 50081-2)	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Fachgrundnorm Störaussendung - Teil 2: Industriebereich (EN 50081-2 wird durch EN 61000-6-4 ersetzt und darf noch bis 01.07.2004 verwendet werden)
EN 61131-2 IEC 61131-2	Produktnorm, Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 61508-2	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme - Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
UL 508	Industrial Control Equipment (UL = Underwriters Laboratories)
VDE 0701-1	Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
47 CFR	Federal Communications Commission (FCC), 47 CFR Part 15 Subpart B class A

Tabelle 71: Normenübersicht (Forts.)

3. Störaussendungsanforderungen (Emission)

Emission	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	
Netzgebundene Emission	EN 55022	EN 55022: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE Geräte), Klasse A (Industriebereich)	
		EN 61000-6-4: Fachgrundnorm (Industriebereich)	
		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		47 CFR Part 15 Subpart B class A (FCC)	
Störaussendung	EN 55022	EN 55022: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE Geräte), Klasse A (Industriebereich)	
		EN 61000-6-4: Fachgrundnorm (Industriebereich)	
		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		47 CFR Part 15 Subpart B class A (FCC)	

Tabelle 72: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Emission

3.1 Netzgebundene Emission

Prüfdurchführung nach EN 55022	Grenzwerte nach EN 55022 Klasse A	Grenzwerte nach EN 61000-6-4	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach 47 CFR Part 15 Subpart B class A
Netzanschlüsse ¹⁾ 150 kHz - 500 kHz	79 dB (μV) Quasispitzenwert 66 dB (μV) Mittelwert	-	79 dB (μV) Quasispitzenwert 66 dB (μV) Mittelwert	-
Netzanschlüsse 500 kHz - 30 MHz	73 dB (μV) Quasispitzenwert 60 dB (μV) Mittelwert	-	73 dB (μV) Quasispitzenwert 60 dB (μV) Mittelwert	-
AC Netzanschlüsse 150 kHz - 500 kHz	-	79 dB (μV) Quasispitzenwert 66 dB (μV) Mittelwert	-	79 dB (μV) Quasispitzenwert 66 dB (μV) Mittelwert
AC Netzanschlüsse 500 kHz - 30 MHz	-	73 dB (μV) Quasispitzenwert 60 dB (μV) Mittelwert	-	73 dB (μV) Quasispitzenwert 60 dB (μV) Mittelwert
Sonstige Anschlüsse 150 kHz - 500 kHz	97 - 87 dB (μV) und 53 - 43 dB (μA) Quasispitzenwert 84 - 74 dB (μV) und 40 - 30 dB (μA) Mittelwert	-	Nur informativ bei Leitungslängen > 10 m 40 - 30 dB (µA) Quasispitzenwert 30 - 20 dB (µA) Mittelwert	

Tabelle 73: Prüfanforderung netzgebundene Emission Industriebereich

Normen und Zulassungen • Störaussendungsanforderungen (Emission)

Prüfdurchführung nach EN 55022	Grenzwerte nach EN 55022 Klasse A	Grenzwerte nach EN 61000-6-4	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach 47 CFR Part 15 Subpart B class A
Sonstige Anschlüsse 500 kHz - 30 MHz	87 dB (μV) und 43 dB (μA) Quasispitzenwert 74 dB (μV) und 30 dB (μA) Mittelwert		Nur informativ bei Leitungslängen > 10 m 30 dB (μA) Quasispitzenwert 20 dB (μA) Mittelwert	-

Tabelle 73: Prüfanforderung netzgebundene Emission Industriebereich (Forts.)

3.2 Störaussendung, Elektromagnetische Strahlung

Prüfdurchführung nach EN 55022	Grenzwerte nach EN 55022 Klasse A	Grenzwerte nach EN 61000-6-4	Grenzwerte nach EN 61131-2
30 MHz - 230 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 40 dB (μV/m) Quasispitzenwert	< 40 dB (μV/m) Quasispitzenwert	< 40 dB (μV/m) Quasispitzenwert
230 MHz - 1 GHz gemessen in 10 m Entfernung	< 47 dB (μV/m) Quasispitzenwert	< 47 dB (μV/m) Quasispitzenwert	< 47 dB (μV/m) Quasispitzenwert
Prüfdurchführung	Grenzwerte nach 47 CFR Part 15 Subpart B class A		
30 MHz - 88 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 90 dB (μV/m) Quasispitzenwert		
88 MHz - 216 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 150 dB (μV/m) Quasispitzenwert		
216 MHz - 960 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 210 dB (μV/m) Quasispitzenwert		
> 960 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 300 dB (μV/m) Quasispitzenwert		

Tabelle 74: : Prüfanforderung Elektromagnetische Strahlung Industriebereich

¹⁾ Bei EN 61131-2 nur Wechselspannungsnetzanschlüsse.

4. Störfestigkeitsanforderung (Immunität)

Immunität	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	
Elektrostatische Entladung (ESD)	EN 61000-4-2	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	
Störfestigkeit gegen hochfrequente	EN 61000-4-3	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
elektromagnetische Felder (HF Feld)		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
, ,		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	
Störfestigkeit gegen schnelle tran-	EN 61000-4-4	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
siente elektrische Störgrößen (Burst)		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
,		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	
Störfestigkeit gegen Stoßspannun-	EN 61000-4-5	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
gen (Surge)		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	
Störfestigkeit gegen leitungsge-	EN 61000-4-6	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
führte Störgrößen		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	
Störfestigkeit gegen Magnetfelder EN 61000-4-8		EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
mit energietechnischen Frequen- zen		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	
Störfestigkeit gegen Spannungs-	EN 61000-4-11	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
einbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerunger	
Spannungsschwankungen		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	
Störfestigkeit gegen gedämpfte	EN 61000-4-12	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie)	
Schwingungen		EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		EN 55024: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte)	

Tabelle 75: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Immunität

Normen und Zulassungen • Störfestigkeitsanforderung (Immunität)

Bewertungskriterien nach EN 61000-6-2

Kriterium A:

Das Betriebsmittel muss während der Prüfung weiterhin bestimmungsgemäß arbeiten. Es darf keine Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens oder kein Funktionsausfall unterhalb einer vom Hersteller beschriebenen minimalen Betriebsqualität auftreten.

Kriterium B:

Das Betriebsmittel muss <u>nach</u> der Prüfung weiterhin bestimmungsgemäß arbeiten. Es darf keine Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens oder kein Funktionsausfall unterhalb einer vom Hersteller beschriebenen minimalen Betriebsqualität auftreten.

Kriterium C:

Ein zeitweiliger Funktionsausfall ist erlaubt, wenn die Funktion sich selbst wiederherstellt, oder die Funktion durch Betätigung der Einstell- bzw. Bedienelemente wiederherstellbar ist.

Kriterium D:

Minderung oder Ausfall der Funktion, die nicht mehr hergestellt werden kann (Betriebs-mittel zerstört).

4.1 Elektrostatische Entladung (ESD)

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach
EN 61000-4-2	EN 61000-6-2	EN 61131-2	EN 55024
Kontaktentladung auf pulverbe- schichtete und blanke Metallteile des Gehäuses	± 4 kV, 10 Entladungen, Kriterium B	± 4 kV, 10 Entladungen, Kriterium B	± 4 kV, 10 Entladungen, Kriterium B
Luftentladung auf Kunststoffteile des Gehäuses	± 8 kV, 10 Entladungen,	± 8 kV, 10 Entladungen,	± 8 kV, 10 Entladungen,
	Kriterium B	Kriterium B	Kriterium B

Tabelle 76: Prüfanforderung elektrostatische Entladung (ESD)

4.2 Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach
EN 61000-4-3	EN 61000-6-2	EN 61131-2	EN 55024
Gehäuse, verdrahtet	80 MHz - 1 GHz, 10 V/m, 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	80 MHz - 1 GHz, 1,4 - 2 GHz, 10 V/m, 80 % Amplitudenmodula- tion mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A 800-960 MHz (GSM), 10 V/m, Pulsmodulation mit 50 % Ein- schaltdauer, Kriterium A	80 MHz - 1 GHz, 1,4 - 2 GHz, 3 V/m, 80 % Amplitudenmodulati- on mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

Tabelle 77: Prüfanforderung hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)

4.3 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-4	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 55024
AC Netzein-/-ausgänge	± 2 kV, Kriterium B	-	± 1 kV, Kriterium B
AC Netzeingänge	-	± 2 kV, Kriterium B	-
AC Netzausgänge	-	± 1 kV, Kriterium B	-
DC Netzein-/-ausgänge >10 m 1)	± 2 kV, Kriterium B	-	± 0,5 kV, Kriterium B
DC Netzeingänge >10 m	-	± 2 kV, Kriterium B	-
DC Netzausgänge >10 m	-	± 1 kV, Kriterium B	-
Funktionserdanschlüsse, Signalleitungen und I/Os >3 m	± 1 kV, Kriterium B	± 1 kV, Kriterium B	± 0,5 kV, Kriterium B
Ungeschirmte AC Ein-/Ausgänge >3 m	-	± 2 kV, Kriterium B	-
Analoge I/Os	± 1 kV, Kriterium B	± 1 kV, Kriterium B	-

Tabelle 78: Prüfanforderung schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)

4.4 Stoßspannungen (Surge)

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-5	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 55024
AC Netzein-/-ausgänge, L zu L	± 1 kV, Kriterium B	± 1 kV, Kriterium B	± 1 kV, Kriterium B
AC Netzein-/-ausgänge, L zu PE	± 2 kV, Kriterium B	± 2 kV, Kriterium B	± 2 kV, Kriterium B
DC Netzein-/-ausgänge, L+ zu L-, >10 m	± 0,5 kV, Kriterium B	-	-
DC Netzein-/-ausgänge, L zu PE, >10 m	± 0,5 kV, Kriterium B	-	± 0,5 kV, Kriterium B
DC Netzeingänge, L+ zu L-	-	± 0,5 kV, Kriterium B	-
DC Netzeingänge, L zu PE	-	± 1 kV, Kriterium B	-
DC Netzausgänge, L+ zu L-	-	± 0,5 kV, Kriterium B	-
DC Netzausgänge, L zu PE	-	± 0,5 kV, Kriterium B	-
Signalanschlüsse >30 m	± 1 kV, Kriterium B	± 1 kV, Kriterium B	± 1 kV, Kriterium B
Alle geschirmten Kabel	-	± 1 kV, Kriterium B	-

Tabelle 79: Prüfanforderung Stoßspannungen (Surge)

¹⁾ Bei EN 55024 ohne Längenbeschränkung.

4.5 Leitungsgeführte Störgrößen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-6	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 55024
AC Netzein-/-ausgänge	150 kHz - 80 MHz, 10 V, 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Am- plitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Kriterium A
DC Netzein-/-ausgänge	150 kHz - 80 MHz, 10 V, 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Am- plitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Kriterium A
Funktionserdanschlüsse	0,15 - 80 MHz, 10 V, 80 % Ampli- tudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Am- plitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	-
Signalanschlüsse >3 m	0,15 - 80 MHz, 10 V, 80 % Ampli- tudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Am- plitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Kriterium A

Tabelle 80: Prüfanforderung leitungsgeführte Störgrößen

4.6 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-8	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 55024
Prüfrichtung x, Prüfung im Feld einer Induktionsspule 1 m x 1 m	30 A/m, Kriterium A	30 A/m, Kriterium A	50 Hz, 1 A/m, Kriterium A
Prüfrichtung y, Prüfung im Feld einer Induktionsspule 1 m x 1 m	30 A/m, Kriterium A	30 A/m, Kriterium A	50 Hz, 1 A/m, Kriterium A
Prüfrichtung z, Prüfung im Feld einer Induktionsspule 1 m x 1 m	30 A/m, Kriterium A	30 A/m, Kriterium A	50 Hz, 1 A/m, Kriterium A

Tabelle 81: Prüfanforderung Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

4.7 Spannungseinbrüche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-11	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 55024
AC Netzeingänge	Spannungseinbruch 70 % (30 % Reduktion), 0,5 Perio- den, Kriterium B	70 % (30 % Reduktion), 0,5 Perio-	
AC Netzeingänge	Spannungseinbruch 40 % (60 % Reduktion), 5 Perio- den, Kriterium C	40 % (60 % Reduktion), 5 Perio-	
AC Netzeingänge	Spannungseinbruch 40 % (60 % Reduktion), 50 Perio- den, Kriterium C	-	-
AC Netzeingänge	Spannungsunterbrechung < 5 % (> 95 % Reduktion), 250 Perioden, Kriterium C	-	Spannungsunterbrechung < 5 % (> 95 % Reduktion), 250 Halbschwingungen, Kriterium C
AC Netzeingänge	-	20 Unterbrechungen, 0,5 Perio- den, Kriterium A	-

Tabelle 82: Prüfanforderung Spannungseinbrüche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen

Rapitel 5 Jormen und Zulassungen

Normen und Zulassungen • Störfestigkeitsanforderung (Immunität)

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach
EN 61000-4-11	EN 61000-6-2	EN 61131-2	EN 55024
DC Netzeingänge	-	20 Unterbrechungen für 10 ms < UN - 15 %, Kriterium A	-

Tabelle 82: Prüfanforderung Spannungseinbrüche, -schwankungen und Kurzzeitunterbrechungen (Forts.)

4.8 Gedämpfte Schwingungen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-12	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Netzein-/-ausgänge, L zu L	± 1 kV, 1 MHz, Wiederholrate 400/Sekunde, Dauer 2 Sekunden, Anschlusslänge 2 m, Kriterium B	
Netzein-/-ausgänge, L zu PE	± 2,5 kV, 1 MHz, Wiederholrate 400/Sekunde, Dauer 2 Sekunden, Anschlusslänge 2 m, Kriterium B	

Tabelle 83: Prüfanforderung gedämpfte Schwingungen

5. Mechanische Bedingungen

Vibration	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Vibration Betrieb	EN 60068-2-6	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
		EN 60721-3-3 Klasse 3M4
Vibration Transport (verpackt)	EN 60068-2-6	EN 60721-3-2 Klasse 2M1
		EN 60721-3-2 Klasse 2M2
		EN 60721-3-2 Klasse 2M3
		B&R
Schock Betrieb	EN 60068-2-27	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
		EN 60721-3-3 Klasse 3M4
Schock Transport (verpackt)	EN 60068-2-27	EN 60721-3-2 Klasse 2M1
		EN 60721-3-2 Klasse 2M2
		EN 60721-3-2 Klasse 2M3
		B&R
Kippfallen (verpackt)	EN 60068-2-31	EN 60721-3-2 Klasse 2M1
		EN 60721-3-2 Klasse 2M2
		EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Freier Fall (verpackt)	EN 60068-2-32	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
		B&R

Tabelle 84: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Vibration

5.1 Vibration Betrieb

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-6	Grenzwerte nach EN 61131-2		Grenzwerte nach EN 60721-3-3 Klasse 3M4		
Vibration Betrieb: Dauerbeanspru-	10 Sweeps je Achse		10 Sweeps je Achse		
chung mit gleitender Frequenz in allen 3 Achsen (x, y, z), 1 Oktave	Frequenz	Grenzwert	Frequenz	Grenzwert	
pro Minute	5 - 9 Hz	Amplitude 3,5 mm	2 - 9 Hz	Amplitude 3 mm	
	9 - 150 Hz	Beschleuni- gung 1 g	9 - 200 Hz	Beschleuni- gung 1 g	

Tabelle 85: Prüfanforderung Vibration Betrieb

5.2 Vibration Transport (verpackt)

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-6	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M1		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M3	
Vibration Transport: Dauerbean-	10 Sweeps je Achse, verpackt		10 Sweeps je A	Achse, verpackt	10 Sweeps je Achse, verpackt	
spruchung mit gleitender Frequenz in allen 3 Achsen (x, y, z)	Frequenz	Grenzwert	Frequenz	Grenzwert	Frequenz	Grenzwert
	2 - 9 Hz	Amplitude 3,5 mm	2 - 9 Hz	Amplitude 3,5 mm	2 - 8 Hz	Amplitude 7,5 mm
	9 - 200 Hz	Beschleuni- gung 1 g	9 - 200 Hz	Beschleuni- gung 1 g	8 - 200 Hz	Beschleuni- gung 2 g
	200 - 500 Hz	Beschleuni- gung 1,5 g	200 - 500 Hz	Beschleuni- gung 1,5 g	200 - 500 Hz	Beschleuni- gung 4 g
	Grenzwerte nach B&R					
	10 Sweeps je Achse, <u>nicht ver-</u> <u>packt</u>					
	2 - 8 Hz	Amplitude 7,5 mm				
	8 - 200 Hz	Beschleuni- gung 2 g				
	200 - 500 Hz	Beschleuni- gung 4 g				

Tabelle 86: Prüfanforderung Vibration Transport (verpackt)

5.3 Schock Betrieb

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	
EN 60068-2-27	EN 61131-2	EN 60721-3-3 Klasse 3M4	
Schock Betrieb: Impulsförmige	Beschleunigung 15 g,	Beschleunigung 15 g,	
(Halbsinus) Beanspruchung in allen 3 Achsen (x, y, z)	Dauer 11 ms, 18 Schocks	Dauer 11 ms	

Tabelle 87: Prüfanforderung Schock Betrieb

5.4 Schock Transport (verpackt)

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach
EN 60068-2-27	EN 60721-3-2 Klasse 2M1	EN 60721-3-2 Klasse 2M2	EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Impulsförmige (Halbsinus) Bean-	Beschleunigung 10 g,	Beschleunigung 30 g,	Beschleunigung 100 g,
spruchung in allen 3 Achsen (x, y,	Dauer 11 ms, je 3 Schocks,	Dauer 6 ms, je 3 Schocks,	Dauer 6 ms, je 3 Schocks,
z)	verpackt	verpackt	verpackt
	Grenzwerte nach B&R		
	Beschleunigung 30 g, Dauer 11 ms, je 3 Schocks, nicht verpackt		

Tabelle 88: Prüfanforderung Schock Transport

Normen und Zulassungen • Mechanische Bedingungen

5.5 Kippfallen

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-31	5.1.511	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M1		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M3	
Kippfallen und Umstürzen	en Geräte: Kippen/Umstürzen Geräte: Kippen/Umstürzen um jede Kante um jede Kante			Geräte: Kippen/Umstürzen um jede Kante			
	Gewicht	erforderlich	Gewicht	erforderlich	Gewicht	erforderlich	
	<20 kg	Ja	<20 kg	Ja	<20 kg	Ja	
	20 - 100 kg	-	20 - 100 kg	Ja	20 - 100 kg	Ja	
	>100 kg	-	>100 kg	-	>100 kg	Ja	

Tabelle 89: Prüfanforderung Kippfallen

5.6 Freier Fall (verpackt)

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-32		Grenzwerte nach EN 61131-2		erte nach 3-2 Klasse M1	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M3	
Freier Fall	packung je	Geräte mit Versandver- packung jeweils 5 Fall- tests		verpackt	Geräte	verpackt	Geräte v	verpackt
	Gewicht	Höhe	Gewicht	Höhe	Gewicht	Höhe	Gewicht	Höhe
	<10 kg	1,0 m	<20 kg	0,25 m	<20 kg	1,2 m	<20 kg	1,5 m
	10 - 40 kg	0,5 m	20 - 100 kg	0,25 m	20 - 100 kg	1,0 m	20 - 100 kg	1,2 m
	>40 kg	0,25 m	>100 kg	0,1 m	>100 kg	0,25 m	>100 kg	0,5 m
	packung je	Geräte mit Produktver- packung jeweils 5 Fall- tests						
	Gewicht	Höhe						
	<10 kg	0,3 m						
	10 - 40 kg	0,3 m						
	>40 kg	0,25 m						
		erte nach &R						
	Geräte	Geräte verpackt						
	Gewicht	Höhe						
	<40 kg	1 m						

Tabelle 90: Prüfanforderung Kippfallen

6. Klimabedingungen

Temperatur und Feuchte	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Worst Case Betrieb	UL 508	UL 508: Industrial Control Equipment EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Trockene Wärme	EN 60068-2-2	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Trockene Kälte	EN 60068-2-1	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Große Temperaturschwankungen	EN 60068-2-14	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Temperaturschwankungen im Betrieb	EN 60068-2-14	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Feuchte Wärme zyklisch	EN 60068-2-30	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Feuchte Wärme konstant (Lager)	EN 60068-2-3	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Tabelle 91: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Temperatur und Feuchte

6.1 Worst Case Betrieb

Prüfdurchführung	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	
nach UL 508	UL 508	EN 61131-2	
Worst Case Betrieb. Betrieb des Gerätes mit der laut Datenblatt spezifizierten max. Umgebungs- temperatur bei der max. spezifizier- ten Belastung	3 Stunden bei max. Umgebungs- temperatur (min. +40 °C) Dauer ca. 5 Stunden	3 Stunden bei max. Umgebungs- temperatur (min. +40 °C) Dauer ca. 5 Stunden	

Tabelle 92: Prüfanforderung Worst Case Betrieb

6.2 Trockene Wärme

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Trockene Wärme	16 Stunden bei +70 °C, 1 Zyklus anschließend 1 Stunde Akklimati- sierung und auf Funktion prüfen, Dauer ca. 17 Stunden	

Tabelle 93: Prüfanforderung trockene Wärme

6.3 Trockene Kälte

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-1	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Trockene Kälte	16 Stunden bei -40 °C, 1 Zyklus anschließend 1 Stunde Akklimati- sierung und auf Funktion prüfen, Dauer ca. 17 Stunden	

Tabelle 94: Prüfanforderung trockene Kälte

Normen und Zulassungen • Klimabedingungen

6.4 Große Temperaturschwankungen

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-14	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Große Temperaturschwankungen	3 Stunden bei -40 °C und 3 Stunden bei +70 °C, 2 Zyklen anschließend 2 Stunden Akklima- tisierung und auf Funktion prüfen, Dauer ca. 14 Stunden	

Tabelle 95: Prüfanforderung große Temperaturschwankungen

6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-14	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Offene Geräte: Diese können auch eine Gehäuse (housing) besitzen und werden in Schaltschränke ein- gebaut	3 Stunden bei +5 °C und 3 Stunden bei 55 °C, 5 Zyklen, Temperaturgradient 3 °C / min, während der Prüfung wird der Prüfling gelegentlich mit Span- nung versorgt, Dauer ca. 30 Stunden	
Geschlossene Geräte: Das sind Geräte, die laut Datenblatt ein um- hüllendes Gehäuse (enclosure) mit den entsprechenden Sicherheits- maßnahmen besitzen.	3 Stunden bei +5 °C und 3 Stunden bei +55 °C, 5 Zyklen, Temperaturgradient 3 °C / min, während der Prüfung wird der Prüfling gelegentlich mit Span- nung versorgt, Dauer ca. 30 Stunden	

Tabelle 96: Prüfanforderung Temperaturschwankungen im Betrieb

6.6 Feuchte Wärme zyklisch

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-30	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Wechselklima	24 Stunden bei +25 °C / +55 °C und 97 % / 83 % RH, 2 Zyklen, an- schließend 2 Stunden Akklimati- sierung sowie Funktions- und Isolationsprüfung durchführen, Dauer ca. 50 Stunden	

Tabelle 97: Prüfanforderung Feuchte Wärme zyklisch

6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager)

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-3	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Feuchte Wärme konstant (Lager)	48 Stunden bei +40 °C und 92,5 % RH, anschließend inner- halb von 3 Stunden Isolationsprü- fung, Dauer ca. 49 Stunden	

Tabelle 98: Prüfanforderung Feuchte Wärme konstant (Lager)

7. Sicherheit

Sicherheit	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	
Erdungswiderstand	EN 61131-2		
		EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen	
Isolationswiderstand			
Hochspannung	EN 60060-1	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		UL 508: Industrial Control Equipment	
Restspannung	EN 61131-2		
		EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen	
Ableitstrom		VDE 0701-1: Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Ge te	
		B&R	
Überlast	UL 508	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		UL 508: Industrial Control Equipment	
Simulation Bauteildefekt	UL 508	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen	
		UL 508: Industrial Control Equipment	
Spannungsbereich		EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen	

Tabelle 99: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Sicherheit

7.1 Erdungswiderstand

Prüfdurchführung nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Erdungswiderstand: Gehäuse (von beliebigen Metallteil auf Erdungs- klemme)	Prüfstrom 30 A für 2 min, < 0,1 Ohm	

Tabelle 100: Prüfanforderung Erdungswiderstand

Normen und Zulassungen • Sicherheit

7.2 Hochspannung

Prüfdurchführung nach EN 60060-1	Grenzwerte nach EN 61131-2 ¹⁾				Grenzwerte nach UL 508			
Hochspannung: Primärkreise zu	Eingangsspan-	F	Prüfspannung		Eingangs-	Prüfspa	Prüfspannung	
Sekundärkreise und zu Schutzlei- ter (vor dem Test dürfen Transfor- matoren, Spulen, Varistoren, Kondensatoren, oder Bauteile, die	nung	1,2/50 µs Spannungs- stoß Spitze	AC, 1 min	DC, 1 min	spannung	AC, 1 min	DC, 1 min	
zum Schutz vor Überspannungen dienen, entfernt werden)	0 - 50 VAC 0 - 60 VDC	850 V	510 V	720 V	≤ 50 V	500 V	707 V	
	50 - 100 VAC 60 - 100 VDC	1360 V	740 V	1050 V	> 50 V	1000 V + 2 x U _N	(1000 V + 2 x U _N) x 1,414	
	100 - 150 VAC 100 - 150 VDC	2550 V	1400 V	1950 V				
	150 - 300 VAC 150 - 300 VDC	4250 V	2300 V	3250 V				
	300 - 600 VAC 300 - 600 VDC	6800 V	3700 V	5250 V				
	600 - 1000 VAC 600 - 1000 VDC	10200 V	5550 V	7850 V				

Tabelle 101: Prüfanforderung Hochspannung

7.3 Restspannung

Prüfdurchführung nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Restspannung nach dem Abschalten	< 60 V nach 5 sec (aktive Teile) < 60 V nach 1 sec (Steckstifte)	

Tabelle 102: Prüfanforderung Restspannung

7.4 Ableitstrom

Prüfdurchführung	Grenzwerte nach VDE 0701-1	B&R	
Ableitstrom: Phase zu Erde	< 3,5 mA	< 1 mA	

Tabelle 103: Prüfanforderung Ableitstrom

¹⁾ Siehe EN61131-2:2003 Seite 104, Tabelle 59.

7.5 Überlast

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	
UL 508	EN 61131-2	UL 508	
Überlast von Transistorausgängen	50 Schaltungen, 1,5 I _N , 1 sec Ein / 9 sec Aus	50 Schaltungen, 1,5 I _N , 1 sec Ein / 9 sec Aus	

Tabelle 104: Prüfanforderung Überlast

7.6 Bauteildefekt

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach	Grenzwerte nach	
UL 508	EN 61131-2	UL 508	
Simulation des Defektwerdens von Bauteilen bei Netzteilen	Kein entzünden des umhüllenden Baumwollgewebes Keine spannungsführenden be- rührbare Teile	Kein entzünden des umhüllenden Baumwollgewebes Keine spannungsführenden berührbare Teile	

Tabelle 105: Prüfanforderung Bauteildefekt

7.7 Spannungsbereich

Prüfdurchführung nach	Grenzwe EN 61		
Versorgungsspannung	Bemessungs- wert	Toleranz min/max	
	24 VDC 48 VDC 125 VDC	-15 % +20 %	
	24 VAC 48 VAC 100 VAC 110 VAC 120 VAC 200 VAC 230 VAC 240 VAC 400 VAC	15 % +10 %	

Tabelle 106: Prüfanforderung Spannungsbereich

Normen und Zulassungen • Sonstige Prüfungen

8. Sonstige Prüfungen

Sonstige Prüfungen	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Schutzart	-	EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Verschmutzungsgrad	-	EN 60664-1: Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen
Montagemaße	-	B&R

Tabelle 107: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen sonstige Prüfungen

8.1 Schutzart

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach EN 60529	
Bedeutung für den Schutz des Betriebsmittels	IP6. Schutz gegen Eindringen von fes- ten Fremdkörpern: staubdicht	
Bedeutung für den Schutz von Personen	IP6. Schutz gegen Zugang zu gefährli- chen Teilen mit Draht	
Schutz gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Wirkungen	IP.5 Strahlwasser geschützt	

Tabelle 108: Prüfanforderung Schutzart

8.2 Verschmutzungsgrad

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach EN 60664-1	
Definition	Verschmutzungsgrad II	

Tabelle 109: Prüfanforderung Verschmutzungsgrad

9. Internationale Zulassungen

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

	Zulassungen		
USA und Kanada	Alle wichtigen B&R Produkte sind von Underwriters Laboratories geprüft und gelistet und werden vierteljährlich durch einen UL-Inspektor überprüft. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert Ihnen die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirschaftsraum.		
Europa	Alle für die gültigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden selbstverständlich erfüllt.		

Tabelle 110: Internationale Zulassungen

Kapitel 6 • Zubehör

1. Übersicht

Bestellnummer	Produktbezeichnung	Anmerkung
0TB103.9	Stecker 24V 5.08 3p Schraubklemme Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Schraubklemme, 2,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.	
0TB103.91	Stecker 24V 5.08 3p Federzugklemme Steckverbinder 24VDC 3polig, female. Federzugklemme, 2,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.	
0AC201.9	Lithium Batterien 5 Stk. Lithium Batterien 5 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stk. Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
5AC900.104X-03	Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP951.1043-01 und 5A981.1043-01, für 1 Gerät.	
5AC900.104X-04	Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP952.1043-01 und 5A982.1043-01, für 1 Gerät.	
5AC900.104X-05	Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP980.1043-01, für 3 Geräte.	
5AC900.150X-01	Einschubstreifenvordruck 15 " für Automation Panel 5AP951.1505-01, 5AP980.1505-01 und 5A981.1505-01, für 4 Geräte.	
5AC900.1200-00	USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) Frontseitige USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) für Automation Panel 900 und Panel PC 700 Geräten.	
5MMUSB.2048-00	USB Memory Stick 2 GB SanDisk USB 2.0 Memory Stick 2 GB	
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Drive DVD-RW/CD-RW FDD CF USB USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, Compact- Flash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC; (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 64 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle.	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 128 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 256 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 512 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1024 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 1024 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	

Tabelle 111: Bestellnummern Zubehör

Zubehör • Übersicht

Bestellnummer	Produktbezeichnung	Anmerkung
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2048 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 2048 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4096 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 4096 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8192 MB SSI CompactFlash Steckkarte mit 8192 MB SLC NAND Flash und IDE/ATA Schnittstelle	

Tabelle 111: Bestellnummern Zubehör (Forts.)

Kapitel 6

2. TB103 3poliger Spannungsversorgungsstecker

2.1 Allgemeines

Diese einreihige 3polige Feldklemme wird als Spannungsversorgungsklemme benötigt.

2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Beschreibung	Abbildung
0TB103.9	Stecker für die 24 V Spannungsversorgung (Schraubklemme)	
OTB103.91	Stecker für die 24 V Spannungsversorgung (Federzug- klemme)	
		0TB103.9
		OTB103.91

Tabelle 112: TB103 Bestelldaten

2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bezeichnung	0TB103.9	0TB103.91	
Anzahl der Pole	3		
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme Ausführung als Federzugklemme		
Kontaktabstand	5,08 mm		
Kontaktübergangswiderstand	≤ 5 mΩ		
Nennspannung nach VDE / UL,CSA	250 V / 300 V		
Strombelastung nach VDE / UL,CSA	14,5 A / 10 A pro Kontakt		
Klemmstärke	0,08 mm² - 3,31 mm²		
Kabelart	nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)		

Tabelle 113: TB103 Versorgungsstecker Technische Daten

3. Ersatz CMOS Batterien

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten, der Echtzeituhr benötigt.

3.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Beschreibung	Abbildung
0AC201.9	Lithium Batterien 5 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle	20
		STA TA

Tabelle 114: Lithium Batterie Bestelldaten

3.2 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Ausstattung	0AC201.9	4A0006.00-000
Kapazität	950 mAh	
Spannung	3 V	
Selbstentladung bei 23°C	< 1% pro Jahr	
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30 °C	
Umwelt Eigenschaften		
Lagertemperatur	-20 °C b	is +60 °C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 % (nich	t kondensierend)

Tabelle 115: Lithium Batterien Technische Daten

4. Einschubstreifenvordrucke

Automation Panel Geräte mit Tasten sind bei der Auslieferung mit eingelegten, teilweise vorbeschrifteten Einschubstreifen (F1, F2, ...) ausgestattet. Die dafür vorgesehenen Schlitze für die Einschubstreifen sind auf der Rückseite der Automation Panel Geräte zugänglich (oben und unten).

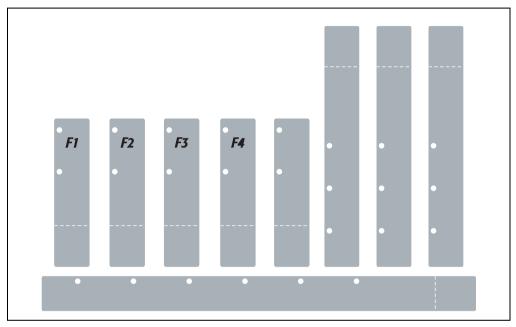


Abbildung 94: Einschubstreifenbeispiele

Bedruckbare Einschubstreifen (Format A4) können bei B&R bestellt werden (siehe Tabelle 10 "Bestellnummern Zubehör", auf Seite 20). Diese können mit einem handelsüblichen Laserdrucker (Schwarzweiß- bzw. Farblaser) im Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C bedruckt werden. Eine Bedruckungsvorlage (erhältlich für Corel Draw Version 7, 9 und 10) für die jeweiligen Einschubstreifenvordrucke kann von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Die Bedruckungsvorlagen sind auch auf der HMI Treiber & Utilities DVD (Best.Nr. 5SWHMI.0000-00) zu finden.

4.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Beschreibung	Abbildung
5AC900.104X-03	Einschubstreifenvordruck 10,4" Einschubstreifenvordrucke für Automation Panel 5AP951.1043-01 und 5A981.1043-01. Für 1 Gerät.	Beispiele für Einschubstreifenvordrucke + +
5AC900.104X-04	Einschubstreifenvordruck 10,4" Einschubstreifenvordrucke für Automation Panel 5AP952.1043-01 und 5A982.1043-01. Für 1 Gerät.	
5AC900.104X-05	Einschubstreifenvordruck 10,4" Einschubstreifenvordrucke für Automation Panel 5AP980.1043-01. Für 3 Geräte.	
5AC900.150X-01	Einschubstreifenvordruck 15" Einschubstreifenvordrucke für Automation Panel 5AP951.1505-01, 5AP980.1505-01 und 5A981.1505-01. Für 4 Geräte.	Authorities and Authorities (Authorities Control Authorities Control Authorities Control Authorities Control Authorities Control Authorities Control C
		ACTIONATION NO. TO CONTINUE PROVIDENCE PROGRAM TO THE STATE OF THE STA

Tabelle 116: Einschubstreifenvordrucke Bestelldaten

5. USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar)

Frontseitige USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) für Automation Panel 900 und Panel PC 700 Geräte.

5.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Beschreibung	Abbildung
5AC900.1200-00	USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) Frontseitige USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) für Automation Panel 900 und Panel PC 700 Geräten.	
		<u></u>

Tabelle 117: USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) Bestelldaten

5.2 Montage

- Alte Abdeckung entfernen.
- USB Schnittstellenabdeckung durch die kleine Öffnung durchfädeln (siehe rote Markierungen).

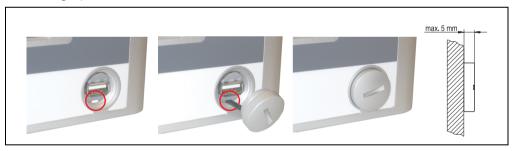


Abbildung 95: Frontseitige USB Schnittstellenabdeckung - Montage

 Bei eingeschraubter Abdeckungen ergibt sich eine Erhebung an der Frontseite des Displays von maximal 5 mm.

6. USB Memory Stick

Information:

Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbaren bzw. der kurzen Lebenszyklen der USB Sticks behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein (wie z.B.: beim SanDisk Cruzer Micro USB Stick mit 2 GB), folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk /mbr" auf den USB Memory Stick ausgeführt wird.

6.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund des schnelles Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) verwandelt sich der USB Memory Stick sofort in ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können. Es kommen USB Memory Sticks des Speicherspezialisten SanDisk zum Einsatz.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Beschreibung	Abbildung
5MMUSB.2048-00	USB Memory Stick 2 GB SanDisk Cruzer Micro	Cruzer micro

Tabelle 118: Bestelldaten USB Memory Sticks

6.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Ausstattung	5MMUSB.2048-00
LED	1 LED (grün), signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung)
Versorgung Stromaufnahme	über den USB Port 650 µA Schlafmodus, 150 mA Lesen/Schreiben
Schnittstelle Typ Übertragungsgeschwindigkeit sequentielles Lesen sequentielles Schreiben Anschluss	USB Spezifikation 2.0 High Speed Device, Mass Storage Class, USB-IF und WHQL zertifiziert USB 1.1 und 2.0 kompatibel bis zu 480 MBit (High Speed) max. 8,7 MB/Sekunde max. 1,7 MB/Sekunde an jede USB Typ A Schnittstelle
MTBF (bei 25 °C)	100000 Stunden
Datenerhaltung	10 Jahre
Wartung	Keine
Betriebssystemunterstützung	Windows CE 5.0, Windows XP embedded
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen Länge Breite Dicke	52,2 mm 19 ,mm 7,9 mm
Umwelt Eigenschaften	
Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung Transport	0 °C bis +45 °C -20 °C bis +60 °C -20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	10 % bis 90 %, nicht kondensierend 5 % bis 90 %, nicht kondensierend 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
Vibration Betrieb Lagerung Transport	2 g (10 bis 500 Hz), Schwingungsrate 1/Minute 4 g (10 bis 500 Hz), Schwingungsrate 1/Minute 4 g (10 bis 500 Hz), Schwingungsrate 1/Minute
Schock Betrieb Lagerung Transport	40 g und 11 ms Dauer (alle Achsen) 80 g und 11 ms Dauer (alle Achsen) 80 g und 11 ms Dauer (alle Achsen)

Tabelle 119: Technische Daten USB Memory Stick - 5MMUSB.2048-00

Ausstattung	5MMUSB.2048-00
Meereshöhe Betrieb Lagerung Transport	3048 Meter 12192 Meter 12192 Meter

Tabelle 119: Technische Daten USB Memory Stick - 5MMUSB.2048-00 (Forts.)

6.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

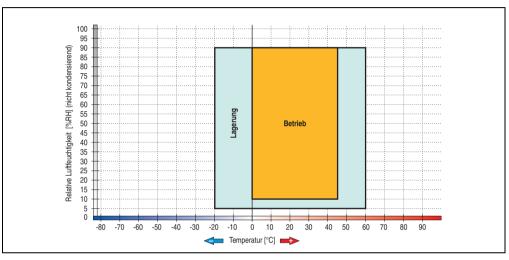


Abbildung 96: Temperatur Luftfeuchtediagramm USB Memory Stick - 5MMUSB.2048-00

6.4 Lieferumfang

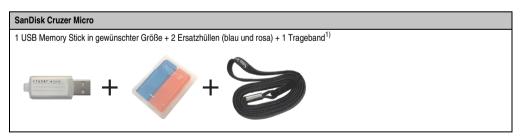


Tabelle 120: Lieferumfang USB Memory Sticks 5MMUSB.2048-00

 1) Aufgrund des von Seiten des Herstellers geänderten Lieferumfanges besteht die Möglichkeit dass der USB Memorystick (mit weißer Hülle) ohne die Ersatzhüllen und Trageband geliefert wird.

Zubehör • USB Memory Stick

6.5 Erzeugung eines bootbaren (bootable) USB Memory Sticks

Von den bei B&R erhältlichen USB Memory Sticks ist es möglich in Verbindung mit einem Automation PC 620 / Panel PC 700 das System zu booten. Dazu ist der USB Memory Stick speziell vorzubereiten.

6.5.1 Was wird benötigt?

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen eines bootbaren USB Memory Sticks benötigt:

- B&R USB Memory Stick (siehe Best. Nr. "USB Memory Sticks", auf Seite 30)
- Automation PC 620 oder Panel PC 700
- USB Floppy Laufwerk (extern oder Slide-In USB Floppy 5AC600.FDDS-00)
- PS/2 oder USB Tastatur
- Eine mit MS-DOS 6.22 oder Windows 98 erzeugte Startdiskette 1,44MB HDD (Windows Millennium, NT4.0, 2000, XP Startdisketten k\u00f6nnen nicht verwendet werden).
 Auf der Diskette m\u00fcssen sich die Tools "format.com" und "fdisk.exe" befinden!

6.5.2 Vorgangsweise

- USB Memory Stick anstecken und von der Startdiskette booten.
- Die Partition am USB Memory Stick mit "fdisk" aktiv schalten (Set active partition!!) und den weiteren Anweisungen folgen.
- System von der Startdiskette neu booten.
- Formatierung und gleichzeitige Übertragung der Systemdateien auf den USB Memory Stick mit dem Befehl "format c: /s".

7. USB Media Drive - 5MD900.USB2-01



Abbildung 97: USB Media Drive - 5MD900.USB2-01

7.1 Features

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes USB Diskettenlaufwerk
- Integriertes DVD-RW/CD-RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss (bis zu 480 MBit High Speed)
- Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB/B 2.0 Anschluss rückseitig
- optionale Frontklappe (siehe auch Abschnitt 7.8 "Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive", auf Seite 185)

7.2 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Ausstattung Gesamtgerät	5MD900.USB2-01
Übertragungsgeschwindigkeit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s)
maximale Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Versorgung Nennspannung	24 VDC ±25%
Ausstattung Diskettenlaufwerk	
Datenkapazität	720 KB / 1.25 MB / 1.44 MB (formatiert)
Datentransferrate	250 kbits (720 KB) bzw. 500 kbits (1.25 MB und 1.44 MB)
Rotationsgeschwindigkeit	bis zu 360 rpm
Diskettenmedien	High Density (2HD) oder Normal Density (2DD) 3.5" Disketten
MTBF	30000 POH (Power on Hours)
Ausstattung DVD-RW/CD-RW Laufwerk	
Schreibgeschwindigkeit CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD-RAM ¹⁾ DVD-RAM ¹⁾ DVD+R DVD+R (Double Layer) DVD+RW	24x, 16x, 10x und 4x 10x und 4x 8x, 4x und 2x 4x und 2x 3x und 2x 8x, 4x und 2x 2,4x 4x und 2x
Lesegeschwindigkeit CD DVD	24x 8x
Datentransferrate	max. 33,3 MBytes/sec.
Zugriffszeit (Durchschnitt) CD / DVD	130 ms (24x) / 130 ms (8x)
Umdrehungsgeschwindigkeit	max. 5090 rpm ± 1%
Hochlaufzeit (0 rpm auf Lesezugriff) CD DVD	14 Sekunden (maximal) 15 Sekunden (maximal)
Host Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Lesbare Medien CD DVD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW

Tabelle 121: Technische Daten USB Media Drive 5MD900.USB2-01

Zubehör • USB Media Drive - 5MD900.USB2-01

Ausstattung DVD-RW/CD-RW Laufwerk	5MD900.USB2-01	
Beschreibbare Medien CD DVD	CD-R, CD-RW DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)	
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW	
Schreibmethoden CD DVD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session	
Laserklasse	Class 1 Laser	
Datenpufferkapazität	8 MB	
Geräuschpegel (voller Lesezugriff)	ca. 48 dBA in 50 cm Entfernung	
Lebensdauer Öffnen/Schliessen der Lade	60000 POH (Power On Hours) > 10000 mal	
Ausstattung CompactFlash Slot		
CompactFlash Typ Anzahl Anschluss	Typ I 1 Slot IDE/ATAPI	
CompactFlash LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte	
Hot-Plug fähig	Ja	
Ausstattung USB Anschlüsse		
USB A frontseitig Stromversorgung Typ Übertragungsgeschwindigkeit	Anschluss weiterer Peripheriegeräte max. 500 mA 2.0 Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 Mbit/s)	
USB B rückseitig	Anschluss an das System	
Mechanische Eigenschaften		
Außenabmessungen (ohne Slide-In) Breite Länge Höhe	70 mm 100 mm 9,5 mm	
Gewicht	ca. 1,1 kg (ohne Frontklappe)	
Umwelt Eigenschaften		
Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung Transport	+5 °C +45 °C -20 °C +60 °C -40 °C +60 °C	
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	20 - 80 % nicht kondensierend 5 - 90 % nicht kondensierend 5 - 95 % nicht kondensierend	

Tabelle 121: Technische Daten USB Media Drive 5MD900.USB2-01 (Forts.)

Zubehör • USB Media Drive - 5MD900.USB2-01

Umwelt Eigenschaften	5MD900.USB2-01			
Vibration Betrieb Lagerung Transport	5 - 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s ² 0-peak) 10 - 100 Hz: 2 g (19,6 m/s ² 0-peak) 10 - 100 Hz: 2 g (19,6 m/s ² 0-peak)			
Schock Betrieb Lagerung Transport	max. 5 g (49 m/s ² 0-peak) und 11 ms Dauer max. 60 g (588 m/s ² 0-peak) und 11 ms Dauer max. 60 g (588 m/s ² 0-peak) und 11 ms Dauer			
Meereshöhe	max. 3000 Meter			

Tabelle 121: Technische Daten USB Media Drive 5MD900.USB2-01 (Forts.)

1) DVD RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Unterstützung der DVD RAM Funktion durch die Brennsoftware "Nero" (Best. Nr. 5SWUTI.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.

7.3 Abmessungen

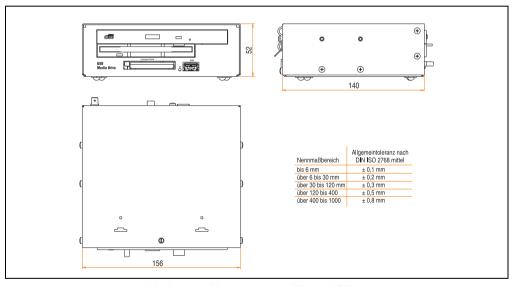


Abbildung 98: Abmessungen - 5MD900.USB2-01

7.4 Abmessungen mit Frontklappe

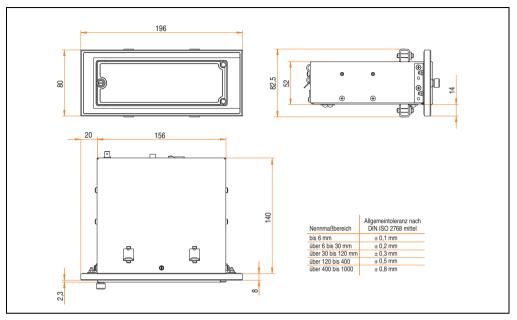


Abbildung 99: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

7.4.1 Einbau in Wanddurchbrüche

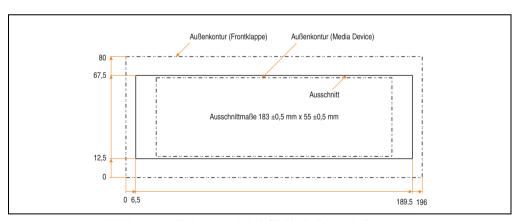


Abbildung 100: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

7.5 Lieferumfang

Anzahl	Komponente	
1	USB Media Drive Gesamtgerät	
2	Hutschienenwinkel	

Tabelle 122: Lieferumfang USB Media Drive 5MD900.USB2-01

7.6 Schnittstellen

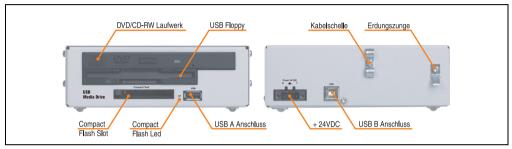


Abbildung 101: Schnittstellen - 5MD900.USB2-01

7.7 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienenwinkel werden beigepackt) geeignet.

7.7.1 Einbaulagen

Auf Grund der beschränkten Einbaulage bei den verwendeten Komponenten (Floppy, DVD-CDRW Laufwerk) darf das USB Media Drive Laufwerk nur wie folgt abgebildet montiert und betrieben werden.

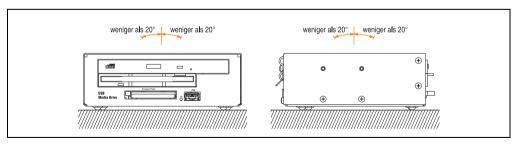


Abbildung 102: Einbaulage - 5MD900.USB2-01

7.8 Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr. 5MD900.USB2-00 bzw. 5MD900.USB2-01) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

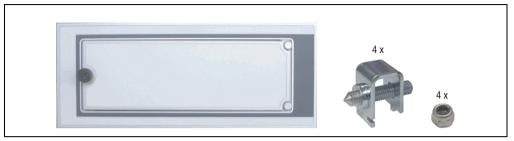


Abbildung 103: Frontklappe 5A5003.03

7.8.1 Technische Daten

Ausstattung	5A5003.03	
Frontklappendesign / Farben dunkelgrauer Rand um die Klappe hellgrauer Hintergrund	Pantone 432CV Pantone 427CV	

Tabelle 123: Technische Daten - 5A5003.03

7.8.2 Abmessungen

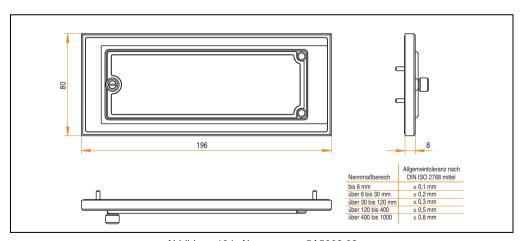


Abbildung 104: Abmessung - 5A5003.03

Zubehör • USB Media Drive - 5MD900.USB2-01

7.8.3 Montage

Die Frontklappe wird mittels den 2 Hutschienenwinkel (beigepackt beim USB Media Drive) und den 4 M3 Sicherungsmuttern befestigt. Mit den 4 beiliegenden Halteklammern kann das Gesamtgerät (USB Media Drive + Frontklappe) z.B. in einer Schaltschranktür montiert werden.

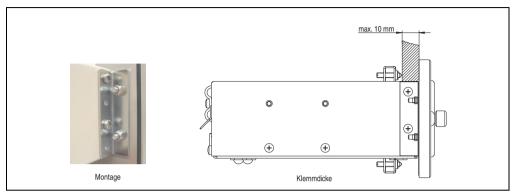


Abbildung 105: Frontklappenmontage und Klemmdicke

7.8.4 Einbau in Wanddurchbrüche

Siehe dazu Abbildung 100 "Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe", auf Seite 183.

Zubehör

8. CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03

8.1 Allgemeines

CompactFlash Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt- (Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

8.2 Bestelldaten

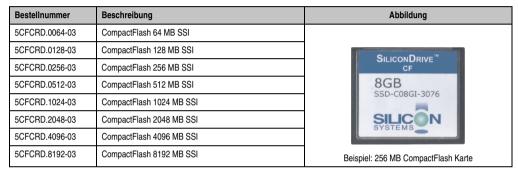


Tabelle 124: CompactFlash Karten Bestelldaten

8.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Ausstattung	5CFCRD.xxxx-03			
MTBF (bei 25 °C)	> 4000000 Stunden			
Wartung	Keine			
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen			
Lösch/Schreibvorgänge	> 2000000 Mal			
Datenerhaltung	10 Jahre			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen Länge Breite Dicke	$36,4 \pm 0,15$ mm $42,8 \pm 0,10$ mm $3,3 \pm 0,10$ mm			
Gewicht	11,4 Gramm			
Umwelt Eigenschaften				
Umgebungstemperatur Betrieb Lagerung Transport	0 °C bis +70 °C -50 °C bis +100 °C -50 °C bis +100 °C			
Luftfeuchtigkeit Betrieb/Lagerung	8% bis 95%, nicht kondensierend			
Vibration Betrieb Lagerung/Transport	max. 16,3 g (159 m/s ² 0-peak) max. 30 g (294 m/s ² 0-peak)			
Schock Betrieb Lagerung/Transport	max. 1000 g (9810 m/s ² 0-peak) max. 3000 g (29430 m/s ² 0-peak)			
Meereshöhe	max. 80000 Fuß (24383 Meter)			

Tabelle 125: Technische Daten CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03

8.3.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

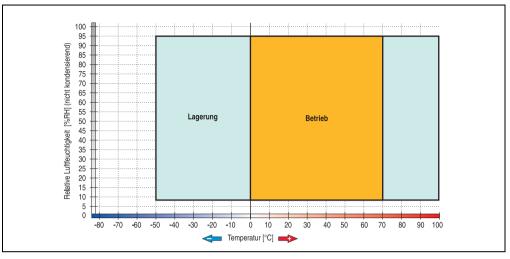


Abbildung 106: Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten - 5CFCRD.xxxx-03

8.4 Abmessungen

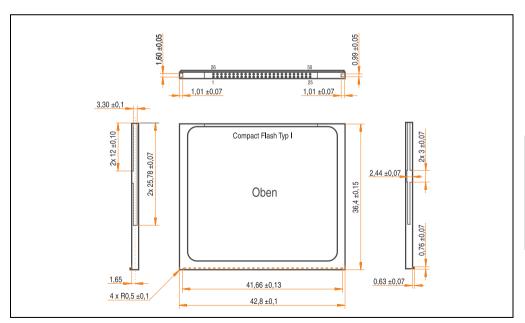


Abbildung 107: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

8.5 Lebensdauerberechnung

Silicon Systems stellt für die Lebensdauerberechnung von CompactFlash Karten ein 9-seitiges "White Paper" zur Verfügung (siehe nachfolgende Seiten). Dieses kann auch auf der Silicon Systems Homepage (www.siliconsystems.com) bezogen werden.

Information:

Ein Softwaretool für die Berechnung der statistischen Lebensdauer der Silicon Systems CompactFlash Karten bei verschiedensten Einstellungen kann von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.





SILICONDRIVE TM WHITE PAPER ENDURANCE CONSIDERATIONS

SILICONSYSTEMS, INC. 26940 Aliso Viejo Parkway Aliso Viejo, CA 92656 Phone: 949.900.9400 Fax: 949.900.9500 http://www.siliconsystems.com

> WP401 Revision D January 2006

SILICONSYSTEMS, INC.

Abbildung 108: Silicon Systems White Paper - Seite 1 von 9





SILICONDRIVE™ WHITE PAPER WP401D

INTRODUCTION

SiliconSystems' SiliconDrive™ technology is specifically designed to meet the high performance and high reliability requirements of Enterprise System OEMs in the netcom, military, industrial, interactive kiosk and medical markets. One of the measures of storage reliability in Enterprise System OEM applications is endurance – the number of write/erase cycles that can be performed before the storage product "wears out."

BACKGROUND

It is important to note that endurance is not just a function of the storage media. Rather, it is the combination of the storage media and the controller technology that determines the endurance. For example, magnetic media is an order of magnitude less reliable than NAND flash, yet the controller technology employed by rotating hard drives can compensate for this deficiency to yield reliability results that meet those of solid-state storage.

(NOTE: This is a completely different discussion from the mechanical reliability involving rotating hard drives versus solid-state storage that has no moving parts. This is just an example of how a controller, if it is good enough, can compensate for the deficiencies of the media).

Write/erase cycle endurance for solid-state storage is specified in many ways by many different vendors. Some specify the endurance at the physical block level, while others specify at the logical block level. Still others specify it at the card or drive level. Since endurance is also related to data retention, endurance can be specified at a higher level if the data retention specification is lower. For these reasons, it is often difficult to make an "apples to apples" comparison of write/erase endurance by solely relying on these numbers in a datasheet.

A better way to judge endurance is to break the specification down into the main components that affect the endurance calculation:

- 1. Storage Media
- 2. Wear Leveling Algorithm
- 3. Error Correction Capabilities

Other factors that affect endurance include the amount of spare sectors available and whether or not the write is done using a file system or direct logical block addressing. While these issues can contribute to the overall endurance calculation, their effects on the resulting number is much lower than the three parameters above. Each of those factors will be examined individually, assuming ten-year data retention.

PAGE 2 OF 9

SILICONSYSTEMS PROPRIETARY

SILICONSYSTEMS
The Future of Storage...TodayTM

Abbildung 109: Silicon Systems White Paper - Seite 2 von 9



SILICONDRIVE™ WHITE PAPER WP401D

STORAGE MEDIA

The scope of this white paper is confined to non-volatile storage – systems that do not lose their data when the power is turned off. The dominant technology for non-volatile solid-state storage is NAND flash. While NOR flash is also a possible solution, implementation of NOR technology is generally confined to applications like cell phones that require the functionality of DRAM, boot PROM and storage component in a single chip. The economies of scale and component densities of NAND relative to NOR make it the ideal solution for non-volatile, solid-state storage subsystems.

The two dominant NAND technologies available today are SLC (single-level cell, sometimes called binary) and MLC (multi-level cell). SLC technology stores one bit per cell and MLC stores two bits. A comparison of SLC and MLC is shown in figure 1.



SLC NAND is generally specified at 100,000 write/erase cycles per block with 1-bit ECC (this is explained below). MLC NAND is specified at 10,000 write/erase cycles per block with ECC. The MLC datasheet does not specify a number of bits of ECC required. Therefore, when using the same controller, a storage device using SLC will have an endurance value roughly 10x that of a similar MLC-based product. In order to achieve maximum endurance, capacity and speed, SiliconSystems currently uses SLC NAND in our SiliconDrive technology.

PAGE 3 OF 9 SILICONSYSTEMS PROPRIETARY
SILICONSYSTEMS
The Future of Storage...Today™

Abbildung 110: Silicon Systems White Paper - Seite 3 von 9





SILICONDRIVE™ WHITE PAPER WP401D

A more thorough discussion of SLC vs. MLC can be found from the component manufacturers:

Samsung: http://www.samsung.com
http://www.toshiba.com

WEAR LEVELING

Wear leveling is defined as the allowing data writes to be evenly distributed over the entire storage device. More precisely, wear leveling is an algorithm by which the controller in the storage device re-maps logical block addresses to different physical block addresses in the solid-state storage array. The frequency of this re-map, the algorithm to find the "least worn" area to which to write and any data swapping capabilities are generally considered proprietary intellectual property of the controller vendor.

It is important to note that the wear leveling is done in the solid-state memory controller and is independent of the host system. The host system performs its reads and writes to logical block addresses only, so as far as the host is concerned, the data stays in the same place.

To illustrate the effects of wear leveling on overall endurance, assume three different storage devices with the following characteristics:

- Flash Card with No Wear Leveling
- 2. Flash Card with Dynamic Wear Leveling
- 3. SiliconDrive with Static Wear Leveling

In addition, assume that all three storage devices use the same solid-state storage technologies (SLC or MLC – for purposes of this discussion, it doesn't matter). All three devices will have 75% of the capacity as static data, which is defined below:

Static Data: Any data on a solid-state storage device that does not change. Examples include: operating system files, look-up tables and executable files.

Finally, the same type of write is performed to all three systems. The host system is writing a single block of data to the same logical block address over and over again.

PAGE 4 OF 9

SILICONSYSTEMS PROPRIETARY

SILICONSYSTEMS
The Future of Storage...TodayTM

Abbildung 111: Silicon Systems White Paper - Seite 4 von 9

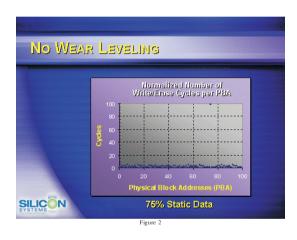


SILICONDRIVE™ WHITE PAPER WP401D

No Wear Leveling

Figure 2 shows a normalized distribution of writes to a flash card that does not use wear leveling. In this instance, the data gets written to the same physical block. Once that physical block wears out and all spare blocks are exhausted (see discussion below), the device ceases to operate, even though only a small percentage of the card was used.

In this instance, the endurance of the card is only dependent on the type of flash used and any error correction capabilities in excess of one byte per sector. Early flash cards did not use wear leveling and thus failed in write-intensive applications. For this reason, flash cards with no wear leveling are only useful in consumer electronic applications.



PAGE 5 OF 9

SILICONSYSTEMS PROPRIETARY

SILICONSYSTEMS
The Future of Storage...TodayTM

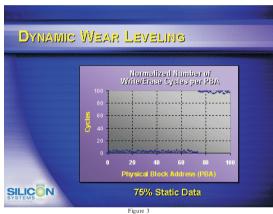
Abbildung 112: Silicon Systems White Paper - Seite 5 von 9



SILICONDRIVE™ WHITE PAPER

Dynamic Wear Leveling

Figure 3 shows a normalized distribution of writes to a flash card that employs dynamic wear leveling. This algorithm only wear levels over "free" or "dynamic" data areas. That is to say, if there is static data as defined above, this area is never involved in the wear leveling process. In the current example, since 75% of the flash card is used for static data, only 25% of the card is available for wear leveling. The endurance of the card is calculated to be 25 times better than for the card with no wear leveling, but only one-fourth that of static wear leveling.



PAGE 6 OF 9

SILICONSYSTEMS PROPRIETARY

SILICONSYSTEMS The Future of Storage...Today $^{\text{TM}}$

Abbildung 113: Silicon Systems White Paper - Seite 6 von 9



SILICONDRIVETM WHITE PAPER WP401D

Static Wear Leveling

Figure 4 shows a normalized distribution of writes to a SiliconDrive that employs static wear leveling. This algorithm evenly distributes the data over the entire SiliconDrive. The algorithm searches for the least-used physical blocks and writes the data to that location. If that location is empty, the write occurs normally. If that location contains static data, the static data is moved to a more heavily-used location prior to the new data being written. The endurance of the SiliconDrive is calculated to be 100 times better than for the card with no wear leveling and four times the endurance of the card that uses dynamic wear leveling.



PAGE 7 OF 9

SILICONSYSTEMS PROPRIETARY

SILICONSYSTEMS
The Future of Storage...TodayTM

Abbildung 114: Silicon Systems White Paper - Seite 7 von 9





SILICONDRIVE™ WHITE PAPER WP401D

ERROR CORRECTION

Part of the solid-state memory components specification is related to error correction. For example, SLC NAND components are specified at 100,000 write/erase cycles with one-bit ECC. It goes to reason that the specification increases with a better error correction algorithm. Most flash cards employ error correction algorithms ranging from two-bit to four-bit correction. SiliconSystems' SiliconDrive technology uses six-bit correction.

The term six-bit correction may be slightly confusing. Six-bit correction really defines the capability of correcting up to six bytes in a 512-byte sector. Since a byte is eight bits, this really means the SiliconDrive can correct 48 bits as long as those bits are confined to six bytes in the sector. The same definition holds for two-bit and four-bit correction.

The relationship between the number of bytes per sector the controller can correct does not appear to be directly proportional to the overall endurance, since the bit error rate of the NAND flash is not linear. To state it another way, six-bit error correction is not necessarily three times better than two-bit ECC. In most cases, it is significantly better than that.

SUMMARY OF MEDIA, WEAR LEVELING AND ECC

The matrix below summarizes the effects of the different items discussed above. In the table, a "1" indicates the best possible scenario, and a "10" indicates the least desirable in terms of endurance.

N = No Wear Leveling; D = Dynamic Wear Leveling; S = Static Wear Leveling

ECC	SLC NAND			MLC NAND		
	N	D	S	N	D	S
2-bit	6	5	4	10	9	8
4-bit	5	4	2	9	8	7
6-bit	4	3	1*	8	7	6

= SiliconSystems' SiliconDrive Configuration

PAGE 8 OF 9

SILICONSYSTEMS PROPRIETARY

SILICONSYSTEMS
The Future of Storage...TodayTM

Abbildung 115: Silicon Systems White Paper - Seite 8 von 9



SILICONDRIVE™ WHITE PAPER WP401D

ENDURANCE CALCULATIONS

To get an idea of how long a solid-state storage device will last in an application, the following calculations can be used. Note: These calculations are valid only for products that use either dynamic or static wear leveling. Use the solid-state memory component specifications for products that do not use wear leveling.

To calculate the expected life in years a product will last:

Years =
$$\frac{(\alpha - \beta) \times \lambda \times (1 - \phi)}{(\omega \times \xi) \times k}$$

Where:

 α = Capacity in MB (when converting from MB to GB, MB = GB x 1,024)

β = Amount of Static Data in MB (this value should be 0 for static wear leveling)

 λ = Endurance Specification

φ = Safety Margin

 ω = File Size in MB (when converting from KB to MB, KB = MB x 1,024)

 ξ = Number of Writes of file size ω per minute

k = Number of minutes per year = 525,600

To calculate the number of data transactions:

Transactions =
$$\frac{(\alpha - \beta) \times \lambda \times (1 - \phi)}{\omega}$$

Where:

 α = Capacity in MB (when converting from MB to GB, MB = GB x 1,024)

 β = Amount of Static Data in MB (this value should be 0 for static wear leveling)

λ = Endurance Specification

φ = Safety Margin Percentage (usually 25%)

 ω = File Size in MB (when converting from KB to MB, KB = MB x 1,024)

The information contained in this bulletin ("Information") is for general guidance on matters of interest relating to the products referred to herein. While SiliconSystems and the author of this bulletin have made every attempt to ensure the accuracy of the Information, SiliconSystems, its officers, and employees shall not be responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this Information. All Information is provided "as is," with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this Information, and without warranty of any kind, express or implied. In no event shall SiliconSystems or its employees be liable for any decision made or action taken in reliance on the Information or for any consequential, special or similar damages, even if advised of the possibility of such damages.

PAGE 9 OF 9

SILICONSYSTEMS PROPRIETARY

SILICONSYSTEMS
The Future of Storage...TodayTM

Abbildung 116: Silicon Systems White Paper - Seite 9 von 9

Kapitel 7 • Wartung und Instandhaltung

1. Batteriewechsel

- Zuleitung zum PPC300 spannungslos (z.B. Netzteil ausstecken) machen.
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Fixierschrauben lösen und Panel PC 300 Einschub vorsichtig herausziehen.

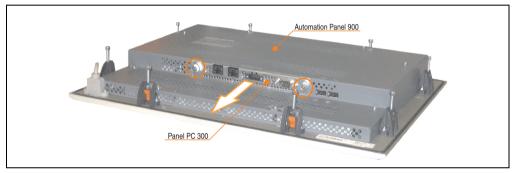


Abbildung 117: Panel PC 300 Einschub entfernen

Die verbrauchte Batterie entfernen und die neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.
 Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.

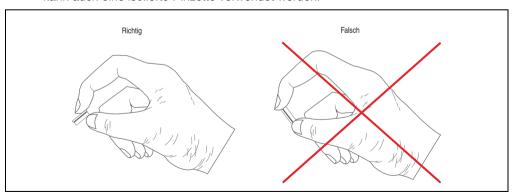


Abbildung 118: Batteriehandhabung

Wartung und Instandhaltung • Reinigung

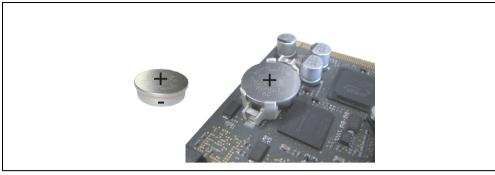


Abbildung 119: Batteriepolarität

- Panel PC 300 in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
- Hat der Wechsel länger als 10 Minuten (maximale Pufferzeit beim Batterietausch) gedauert, so kann es vorkommen dass die Uhrzeit neu eingestellt werden muss.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

2. Reinigung

Gefahr!

Die Reinigung des PPC300 Gerätes darf man nur bei ausgeschaltenem Gerät durchführen, damit beim Berühren des Touch Screens oder Drücken der Tasten oder Befehlsgeräte nicht unbeabsichtigte Funktionen ausgelöst werden können.

Zum Reinigen des PPC300 Gerätes ist ein feuchtes Tuch zu verwenden. Zum Befeuchten des Tuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Automation Panel 900 Gerät sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel, Druckluft oder Dampfstrahler verwenden.

Information:

Das Display mit dem Touch Screen sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

3. Vermeidung des Einbrenneffekts bei LCD / TFT Monitoren

Der bei LCD / TFT Monitoren auftretbare Einbrenneffekt (After-Images, Display-Memory Effekt, Image Retention oder auch Image Sticking genannt) tritt auf, wenn ein über längeren Zeitraum statischer Bildinhalt angezeigt wird. Dieser statische Bildinhalt bewirkt den Aufbau parasitärer Kapazitäten innerhalb der LCD Komponenten, die die Flüssigkristall-Moleküle daran hindern, in ihren ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Dieser Zustand kann auftreten, ist zeitlich nicht absehbar und u.a. von folgenden Faktoren abhängig:

- · Art des dargestellten Bildes
- Farbzusammenstellung des Bildes
- Dauer der Bildausgabe
- Umgebungstemperatur

3.1 Was kann man dagegen tun?

Eine 100% Abhilfe gibt es nicht, jedoch kann man Maßnahmen treffen, die diesen Effekt deutlich reduzieren:

- Vermeiden von statischen Bilder bzw. Bildinhalten
- · Verwendung von Bildschirmschonern (beweglich) wenn das Display nicht benutzt wird
- Häufigerer Bildwechsel
- Ausschalten des Displays bei Nichtbenutzung

Die Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung (Backlight) kann die Vermeidung des Einbrenneffektes nicht verhindern.

4. Austausch der Leuchtstofflampen

Gefahr!

Ein Tauschen der Leuchtstofflampen darf nur in spannungslosem Zustand des Automation Panel 900 Gerätes sowie in abgeschaltenem Zustand der Anlage und nur von einem unterwiesenen Fachpersonal erfolgen.

4.1 Allgemeines

Die Leuchtstofflampen in den TFT-Displays sind ein Verschleißteil. Je nach Betriebsstunden (siehe "Technische Daten" der Automation Panel) müssen sie nach einigen Jahren ausgetauscht werden.

Die Leuchtstofflampen können bei den Automation Panel 900 Geräten 10,4", 12,1" und 15" ausgetauscht werden.

Bei den Automation Panel 900 Geräten 17", und 19" können diese nicht ausgetauscht werden!

Warnung!

Um die Leuchtstofflampen beim Tausch nicht zu beschädigen sollten sie am Plastikrahmen (10,4" Gerät) oder an dem weißen Blech (12,1" Gerät und 15" Gerät) mit einer kleinen Flachzange herausgezogen werden. Nicht an den Kabeln anziehen da die Röhren brechen können.

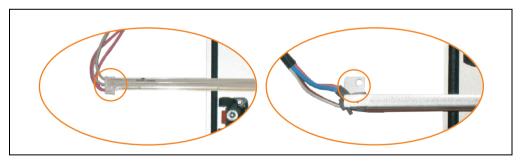


Abbildung 120: Warnhinweis - Austausch der Leuchtstofflampen

4.2 Vorgangsweise

4.2.1 Erster Schritt bei allen Geräten (10,4", 12,1", 15").

Demontage der Abdeckhaube. Fixierschrauben lösen (1) und Steckkarte herausziehen (2). Schrauben an der Abdeckhaube lösen (mittels Torx Schraubendreher Größe 10) und Abdeckhaube abnehmen (3).

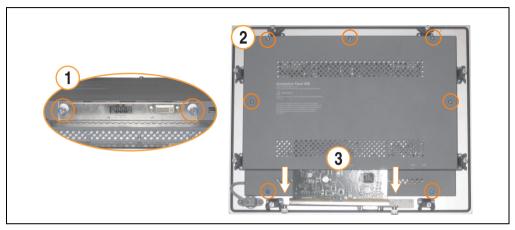


Abbildung 121: Demontage der Abdeckhaube

Wartung und Instandhaltung • Austausch der Leuchtstofflampen

4.2.2 Vorgangsweise Automation Panel 10,4"

1) Die Schrauben an der Platine (mittels Torx Schraubendreher Größe 10) lösen (1) und Platine zur Seite klappen um an die Stecker der Leuchtstoffröhre zu gelangen. Stecker lösen (2).

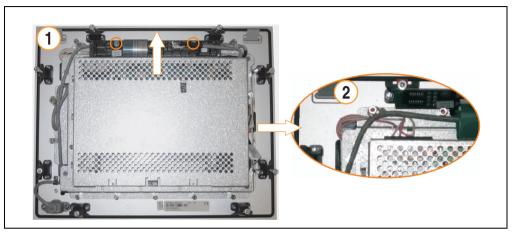


Abbildung 122: Automation Panel 10,4" - Schrauben und Stecker lösen

2) Leuchtstoffröhre tauschen. Dazu die Leuchtstoffröhre vorsichtig aus ihrer Halterung ziehen und gegen eine Neue austauschen.

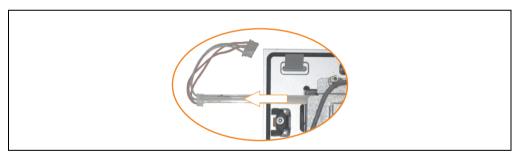


Abbildung 123: Automation Panel 10,4" - Leuchtstoffröhre tauschen

4.2.3 Vorgangsweise Automation Panel 12,1"

1) Die Schraube an der Leuchtstoffröhre (mittels kleinem Kreuzschlitzschraubendreher) und die Stecker der Leuchtstoffröhre lösen.

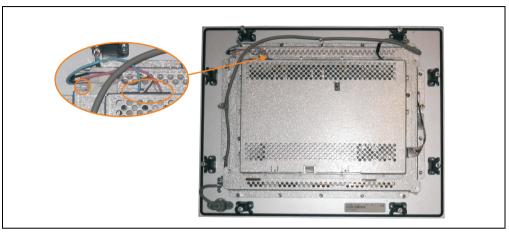


Abbildung 124: Automation Panel 12,1" - Schrauben und Stecker lösen

2) Leuchtstoffröhre tauschen. Dazu die Leuchtstoffröhre vorsichtig aus ihrer Halterung ziehen und gegen eine Neue austauschen.

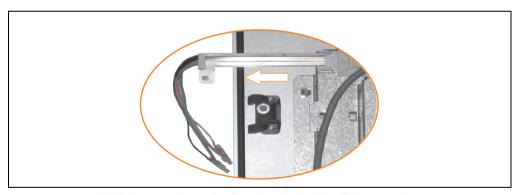


Abbildung 125: Automation Panel 12,1" - Leuchtstoffröhre tauschen

Wartung und Instandhaltung • Austausch der Leuchtstofflampen

4.2.4 Vorgangsweise Automation Panel 15"

 Stecker lösen (1). Schrauben (2) an den Leuchtstofflampen (mittels kleinem Kreuzschlitzschraubendreher) und Erdung (3) am Gehäuse (mittels Torx Schraubendreher Größe 10) lösen.

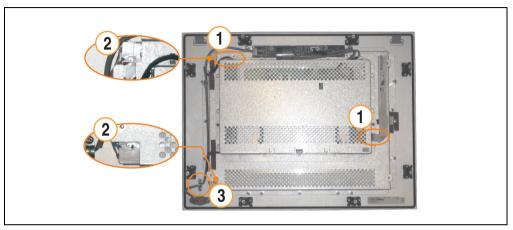


Abbildung 126: Automation Panel 15" - Schrauben und Stecker lösen

Stecker der zweiten Leuchtstoffröhre lösen. Schrauben (mittels Torx Schraubendreher Größe 10) lösen (1) und Abdeckhaube nach oben schieben (2), hochklappen und Stecker lösen (3).

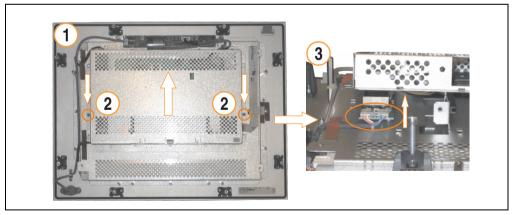


Abbildung 127: Automation Panel 15" - Demontage der Abdeckhaube und Stecker lösen

Wartung und Instandhaltung • Austausch der Leuchtstofflampen

3) Leuchtstofflampen tauschen. Dazu die Leuchtstofflampen vorsichtig aus ihren Halterungen ziehen und gegen Neue austauschen.

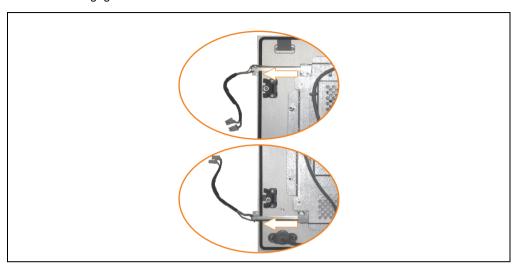
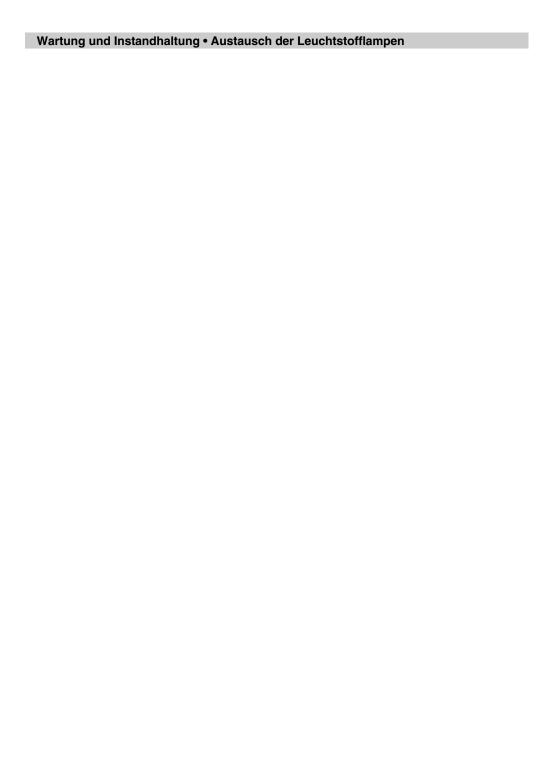


Abbildung 128: Automation Panel 15" - Leuchtstofflampen tauschen



Anhang A

1. Touch Screen - Elo Accu Touch

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Elo Accu Touch Screen	Spezifikationen		
Hersteller	<u>Elo</u>		
Genauigkeit bei Diagonalen < 18" bei Diagonalen > 18"	typisch < als 0,080 inches (2,032 mm) maximaler Fehler in alle Richtungen 0,180 inches (4,752 mm) maximal 1 % der Diagonale von der aktiven Fläche des Touch Screens		
Reaktionszeit	< 10 ms		
Auslösedruck	< 113 Gramm		
Auflösung	4096 x 4096 Touchpunkte		
Lichtdurchlässigkeit	bis zu 80 % ±5 %		
Temperatur Betrieb Lagerung Transport	- 10 °C bis + 50 °C - 40 °C bis + 71 °C - 40 °C bis + 71 °C		
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	max. 90 % bei max. 35 °C max. 90 % bei max. 35 °C für 240 Stunden, nicht kondensierend max. 90 % bei max. 35 °C für 240 Stunden, nicht kondensierend		
Abdichtbarkeit	IP65		
Lebensdauer	35 Millionen Berührungen an der gleichen Stelle		
Chemische Widerstandsfähigkeit 1)	Aceton, Ammoniak basierende Glasreiniger, gebräuchliche Nahrungsmittel und Gertränke, Hexan, Methylen Chlorid, Methyl Ethyl Keton, Mineralspiritus, Terpentin, Isopropylalkohol		
Aktivierung	Finger, Stift, Kreditkarte, Handschuh		
Treiber	Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Home- page (www.br-automation.com) zum Download bereit. Weiters sind diese auf der B&R HMI Treiber und Utilities DVD (Best. Nr. 5SWHMI.0000-00) zu finden		

Tabelle 126: Technische Daten Elo Accu Touch Screen 5 Draht

¹⁾ Der aktive Bereich des Touch Screens ist gegenüber diesen Chemikalien für einen Zeitraum von einer Stunde bei 21 °C resistent.

1.1 Temperatur Luftfeuchtediagramm für Betrieb und Lagerung

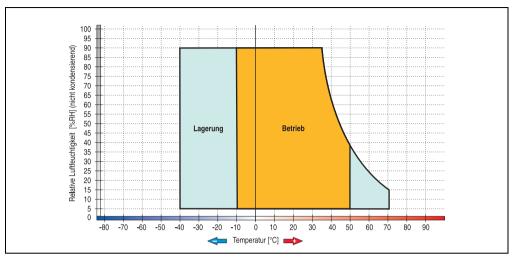


Abbildung 129: Temperatur Luftfeuchtediagramm Elo Accu Touch Screen

1.2 Kalibrierung

Die B&R Touch Screen Geräte sind mit einem Touch Controller, welcher eine Hardware Kalibrierung unterstützt, ausgestattet. D.h. diese Geräte sind bereits ab Werk vorkalibriert (pre calibration). Diese Eigenschaft bringt gerade im Ersatzteilfall große Vorteile, da bei einem Gerätetausch (identes Modell / Typ) in der Regel eine neuerliche Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um beste Resultate zu erzielen und den Touch Screen an die Bedürfnisse des Benutzers wieder anzupassen, empfehlen wir dennoch diesen zu kalibrieren.

Unabhängig davon erfordert der Touch Treiber während bzw. nach der Installation einmalig die Durchführung einer Kalibrierung.

1.2.1 Windows CE

In der Standardkonfiguration (Auslieferungsstand) startet Windows CE während des ersten Bootens die Touchkalibrierung.

1.2.2 Windows XP embedded

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows XP embedded auf dem Gerät muss zum Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit. Während der Installation des Treibers ist der Touch Screen über das Setup zu kalibrieren.

1.3 Reinigung

Der Touch Screen ist mit einem angefeuchteten faserfreien Tuch zu reinigen. Zum Befeuchten des Tuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Touch Screen sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel, Druckluft oder Dampfstrahler verwenden.

Information:

Das Display mit dem Touch Screen sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Um den Touch Screen auch im laufenden Betrieb unter Windows CE reinigen zu können, kann der Touch Screen für 20 Sekunden deaktiviert werden. Diese Funktion ist unter **Start** > **Settings** > **Control Panel** > **Touch Screen**, Registerkarte **Screen Cleaning** aktivierbar.

2. Dekorfolie

Die Dekorfolie ist beständig nach DIN 42115 Teil 2 gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von mehr als 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen:

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Äthanol Cyclohexanol Diacetonalkohol Glykol Isopropanol Glyzerin Methanol Triacetin Dowandol DRM/PM	Formaldehyd 37%-42% Acetaldehyd Aliphatische Kohlenwasserstoffe Toluol Xylol Verdünner (white spirit)	1.1.1.Trichloräthan Ethylacetat Diethyläther N-Butyl Acetat Amylacetat Butylcellosolve Äther
Aceton Methyl-Äthyl-Keton Dioxan Cyclohexanon MIBK Isophoron	Ameisensäure <50% Essigsäure <50% Phosphorsäure <30% Salzsäure <36% Salpetersäure <10% Trichloressigsäure <50% Schwefelsäure <10%	Chlornatron <20% Wasserstoffperoxid <25% Kaliseife Waschmittel Tenside Weichspüler Eisenchlor (FeCl2)
Ammoniak <40% Natronlauge <40% Kaliumhydroxyd Alkalikarbonat Bichromate Blutlaugensalz Acetonitril Natriumbisulfat	Bohremulsion Dieselöl Firnis Paraffinöl Ricinusöl Silikonöl Terpentinölersatz Bremsflüssigkeit Flugzeugkraftstoff Benzin Wasser Salzwasser Decon	Eisenchlor (FeCl3) Dibutyl Phthalat Dioctyl Phthalat Natriumkarbonat

Tabelle 127: Chemische Beständigkeit der Dekorfolie

Die Dekorfolie ist nach DIN 42115 Teil 2, bei einer Einwirkung von weniger als einer Stunde, gegenüber Eisessig ohne sichtbaren Schaden beständig.

3. Blickwinkel

Die Blickwinkelangaben (R, L, U, D) können den technischen Daten der Einzelkomponenten entnommen werden.

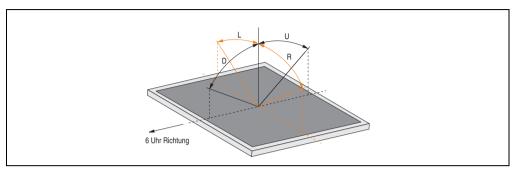


Abbildung 130: Blickwinkel

4. B&R Key Editor

Eine häufig auftretende Anforderung bei Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und problemlos möglich. Der PPC300 wird erst ab Version 2.60 unterstützt.

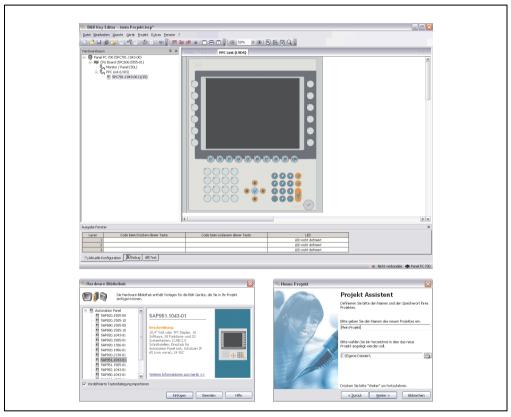


Abbildung 131: B&R Key Editor Screenshots (Version 2.70)

Features:

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A,B,C, etc.)
- Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
- Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
- 4 fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Geräte bei Automation PC 620 und Panel PC 700.

Unterstützt werden folgende Systeme (Version 2.70):

- Automation PC 800
- Automation PC 620 (ETX, XTX, Embedded)
- Panel PC 300
- Panel PC 700 (ETX, XTX)
- Power Panel 100, 200
- Power Panel 300/400
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100, 200
- Provit 2000
- Provit 5000

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs ist in Online Hilfe des B&R Key Editors zu finden.

Der B&R Key Editor kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-auto-mation.com</u>) heruntergeladen werden.

5. B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dem ADI Development Kit kann man die Funktionen des ADI Treibers ansprechen. Es werden die Programmiersprachen C (mit Import Libraries für Microsoft Visual C++ 6.0 und Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0) und Visual Basic (für Microsoft Visual Basic 6.0) unterstützt.

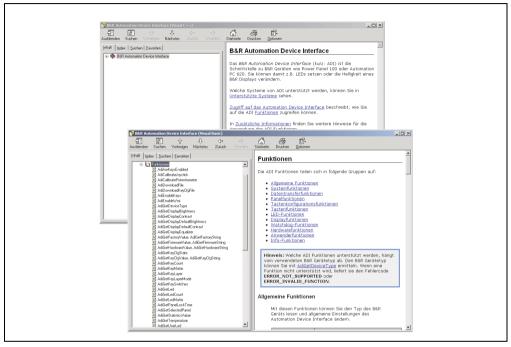


Abbildung 132: ADI Development Kit Screenshots (Version 2.20)

Features:

- Umfangreiche Bibliothek an API Funktionen
- Unterstützte Programmiersprachen Visual Basic, Visual C++
- Online Dokumentation (Deutsch, Englisch)
- Installation über eigenes Setup

Unterstützt werden folgende Systeme:

- Automation PC 800
- Automation PC 620
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Panel PC 300

Anhang A • B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

- Panel PC 700
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen. Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

5.1 Installation

Die aktuellste Version des B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit steht im Downloadbereich (Service - Produktbezogene Downloads - BIOS / Treiber / Updates) auf der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit. Installation erfolgt durch Starten der Datei Setup.exe (z.B. durch Doppelklick im Explorer).

6. Glossar

Α

ACPI

Abkürzung für »Advanced Configuration and Power Interface« Konfigurationsschnittstelle, das es dem Betriebssystem gestattet, die Stromversorgung für jedes an den PC angeschlossene Gerät zu kontrollieren. Mit ACPI ist das BIOS des Rechners nur noch für die Details der Kommunikation mit der Hardware verantwortlich.

API

Abkürzung für »Application Program Interface« nennt man die Schnittstelle, über die Applikationen mit anderen Applikationen oder mit dem Betriebssystem kommunizieren können.

В

Baudrate

Maß für die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Sie gibt die Anzahl der Zustände eines übertragenen Signals pro Sekunde an und wird in der Einheit Baud gemessen. 1 Baud = 1 Bit/s bzw. 1 bps.

BIOS

Abkürzung für »Basic Input/Output System«, zu deutsch »grundlegendes Eingabe-Ausgabe-System«. Kernsoftware bei Computersystemen mit grundlegenden Routinen um Ein- und Ausgabevorgänge an Hardwarekomponenten zu steuern, nach dem Systemstart Tests durchzuführen und das Betriebssystem zu laden. Der Anwender kommt mit dem BIOS gewöhnlich nicht in Berührung, wenngleich es für die Leistung eines Systems mitbestimmend ist.

Bit

Binary Digit > Binärstelle, Binärzeichen, Binärziffer kleinste diskrete Informationseinheit. Ein Bit kann mit dem Wert 0 oder 1 belegt sein.

Bitrate

Anzahl von Bits, die innerhalb einer Zeiteinheit übertragen werden. 1 Bit/s = 1 Baud.

Byte

Datenformat [1 Byte = 8 Bit] bzw. Einheit zur Charakterisierung von Informationsmengen und Speicherkapazitäten. Geläufige Steigerungsstufen sind: KB, MB, GB.

C

Cache

Hintergrundspeicher, auch Schattenspeicher oder Schnellpufferspeicher genannt, der den schnellen Hauptspeicher eines Rechners entlastet. Daten, die z.B. vom Arbeitsspeicher an langsamere Komponenten wie Plattenspeicher oder Drucker ausgegeben werden sollen, werden im Cache zwischengelagert und von dort mit einer für die Zielgeräte angemessenen Geschwindigkeit ausgegeben.

CE-Kennzeichnung

eines Produkts. Sie besteht aus den Buchstaben CE und weist auf die Übereinstimmung mit allen EU-Richtlinien hin, von denen das gekennzeichnete Produkt erfasst wird. Sie besagt, dass die natürliche oder juristische Person, die die Anbringung durchgeführt oder veranlasst hat, sich vergewissert hat, dass das Erzeugnis alle Gemeinschaftsrichtlinien zur vollständigen Harmonisierung erfüllt und allen vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen worden ist.

CMOS

Mit »CMOS« wird der akkugespeiste Speicher bezeichnet, in dem fundamentale Parameter eines IBM Personal Computers oder eines kompatiblen Computers gespeichert werden. Die Informationen werden vor allem beim Booten des Computers benötigt und umfassen u.a. den Typ der Festplatte, die Größe des Arbeitsspeichers sowie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum. Der Speicher basiert, wie es der Name andeutet, in aller Regel auf der CMOS-Technologie.

COM

Ist im Betriebssystem MS-DOS ein Gerätename, mit dem die seriellen Ports angesprochen werden. Der erste serielle Port ist dabei unter COM1 zu erreichen, der zweite unter COM2 usw. An einem seriellen Port wird typischerweise ein Modem, eine Maus oder ein serieller Drucker angeschlossen.

CompactFlash®

CompactFlash Speicherkarten [CF-Karten] sind austauschbare nichtflüchtige Massen-Speichersysteme sehr kleiner Abmessung [43 x 36 x 3,3 mm, etwa halbes Scheckkartenformat]. Auf den Karten ist außer den Flash-Memory-Speicherbausteinen auch der Controller untergebracht. CF-Karten bieten die vollständige PC Card-ATA Funktionalität und Kompatibilität. Eine 50-Pin-CF-Karte kann einfach in eine passive 68 Pin Type II Adapter Karte eingeschoben werden und erfüllt alle elektrischen and mechanischen PC Card Interface Spezifikationen. CF-Karten wurden bereits 1994 von SanDisk eingeführt. Zur Zeit verfügbare Speicherkapazitäten reichen bis 8 GByte je Einheit. Seit 1995 kümmert sich die CompactFlash Association [CFA] um die Normung und die weltweite Verbreitung der CF-Technologie.

CPU

Abkürzung für »Central Processing Unit« Die Rechen- und Steuereinheit eines Computers; die Einheit, die Befehle interpretiert und ausführt. Wird auch als »Mikroprozessor« oder kurz als »Prozessor« bezeichnet. Ein Prozessor besitzt die Fähigkeit, Befehle zu holen, zu decodieren und auszuführen sowie Informationen von und zu anderen Ressourcen über die Hauptleitung des Computers, den Bus, zu übertragen.

CTS

Abkürzung für »Clear To Send«, zu deutsch »Sendebereitschaft«. Ein Signal bei der seriellen Datenübertragung, das von einem Modem an den angeschlossenen Computer gesendet wird, um damit die Bereitschaft zum Fortsetzen der Übertragung anzuzeigen. CTS ist ein Hardwaresignal, das über die Leitung Nummer 5 nach dem Standard RS-232-C übertragen wird.

D

DCD

Abkürzung für » Data Carrier Detected« In der seriellen Kommunikation verwendetes Signal, das ein Modem an den eigenen Computer sendet, um anzuzeigen, dass es für die Übertragung bereit ist.

DMA

Direct **M**emory **A**ccess > Beschleunigter Direktzugriff auf den Arbeitsspeicher eines Rechners unter Umgehung des Zentralprozessors.

DRAM

Abkürzung für »Dynamic Random Access Memory« Dynamische RAMs stellen integrierte Halbleiterschaltungen dar, die Informationen nach dem Kondensator-Prinzip speichern. Kondensatoren verlieren in relativ kurzer Zeit ihre Ladung. Deshalb müssen dynamische RAM-Platinen eine Logik zum ständigen »Auffrischen« (zum Wiederaufladen) der RAM-Chips enthalten. Da der Prozessor keinen Zugriff auf den dynamischen RAM hat, wenn dieser gerade aufgefrischt wird, können ein oder mehrere Wartezustände beim Lesen oder Schreiben auftreten. Dynamische RAMs werden häufiger eingesetzt als statische RAMs, obwohl sie langsamer sind, da die Schaltung einfacher konstruiert ist und viermal so viele Daten wie ein statischer RAM-Chip speichern kann.

DSR

Abkürzung für » **D**ata **S**et **R**eady« Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Modem an den eigenen Computer gesendet wird, um die Arbeitsbereitschaft anzuzeigen. DSR ist ein Hardwaresignal, das in Verbindungen nach dem Standard RS-232-C über die Leitung 6 gesendet wird.

DTR

Abkürzung für »Data Terminal Ready« Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Computer an das angeschlossene Modem gesendet wird, um die Bereitschaft des Computers zur Entgegennahme eingehender Signale anzuzeigen.

Ε

Echtzeit

ein System arbeitet in Echtzeit bzw. ist echtzeitfähig, wenn es Eingangsgrößen (z.B. Signale, Daten) in einer definierten Zeitspanne aufnimmt, verarbeitet und die Ergebnisse rechtzeitig für ein Partnersystem oder die Systemumgebung bereitstellt. Hierzu siehe auch Echtzeitanforderungen und Echtzeitsystem.

EDID Daten

Abkürzung für »Extended Display Identification Data« Die EDID Daten enthalten die Kenndaten von Monitoren / TFT Displays, die über den Display Data Channel (DDC) als 128 kB-Datenblock an die Grafikkarte übermittelt werden. Anhand dieser EDID Daten kann sich die Grafikkarte auf die Monitoreigenschaften einstellen.

EMV

»Elektromagnetische Verträglichkeit« Fähigkeit eines Gerätes, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere in dieser Umwelt vorhandene Geräte unannehmbar wären [IEV 161-01-07].

EPROM

Erasable PROM > (mit ultraviolettem Licht vollständig) löschbarer PROM.

Ethernet

Ein IEEE 802.3-Standard für Netzwerke. Ethernet verwendet eine Bus- oder Sterntopologie und regelt den Verkehr auf den Kommunikationsleitungen über das Zugriffsverfahren CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Die Verbindung der Netzwerk-Knoten erfolgt durch Koaxialkabel, Glasfaserkabel oder durch Twisted Pair-Verkabelung. Die Datenübertragung auf einem Ethernet-Netzwerk erfolgt in Rahmen variabler Länge, die aus Bereitstellungs- und Steuerinformationen sowie 1500 Byte Daten bestehen. Der Ethernet-Standard sieht Basisband-Übertragungen bei 10 Megabit bzw. 100 Megabit pro Sekunde vor.

F

FIFO

Abkürzung für »First In First Out« Organisationsprinzip einer Warteschlange, bei dem die Entnahme der Elemente in der gleichen Reihenfolge wie beim Einfügen abläuft - das zuerst hinzugefügte Element wird zuerst wieder entnommen. Eine derartige Anordnung ist typisch für eine Liste von Dokumenten, die auf ihren Ausdruck warten.

Firmware

Programme, die in Nur-Lese-Speichern fest eingebrannt sind. Das ist Software für den Betrieb von computergesteuerten Geräten, die im allgemeinen während der Gerätelebensdauer oder über einen längeren Zeitraum konstant bleibt wie z.B. Betriebssysteme für CPUs und Applikationsprogramme für Industrie-PCs und speicherprogrammierbare Steuerungen, beispielsweise die Software in einer Waschmaschinensteuerung. Sie ist in einem Festwertspeicher [ROM, PROM, EPROM] hinterlegt und kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werden.

Floppy

Auch als Diskette bezeichnet. Eine runde Kunststoffscheibe mit einer Eisenoxid-Beschichtung, die ein Magnetfeld speichern kann. Wenn die Floppy Disk in ein Diskettenlaufwerk eingelegt wird, rotiert sie, so dass die verschiedenen Bereiche (oder Sektoren) der Disk-Oberfläche unter den Schreib-Lese-Kopf gelangen, der die magnetische Orientierung der Partikel verändern und aufzeichnen kann. Die Orientierung in eine Richtung stellt eine binäre 1, die entgegengesetzte Orientierung eine binäre 0 dar.



GB

Gigabyte (1 GB = 230 bzw. 1.073.741.824 Bytes)

Н

Handshake

Verfahren zur Synchronisation der Datenübertragung bei unregelmäßig anfallenden Daten. Der Sender signalisiert, wenn er neue Daten senden kann und der Empfänger, wenn er für neue Daten aufnahmebereit ist.

IDE

Abkürzung für »Integrated **D**evice **E**lectronics« Eine Schnittstelle (Interface) für Laufwerke, bei der sich die Controller-Elektronik im Laufwerk selbst befindet.

L

LCD

Abkürzung für »Liquid Crystal Display« Ein Display-Typ auf der Basis von Flüssigkristallen, die eine polare Molekülstruktur aufweisen und als dünne Schicht zwischen zwei transparenten Elektroden eingeschlossen sind. Legt man an die Elektroden ein elektrisches Feld an, richten sich die Moleküle mit dem Feld aus und bilden kristalline Anordnungen, die das hindurchtretende Licht polarisieren. Ein Polarisationsfilter, der lamellenartig über den Elektroden angeordnet ist, blockt das polarisierte Licht ab. Auf diese Weise kann man eine Zelle (Pixel), die Flüssigkristalle enthält, über ein Elektrodengitter selektiv »einschalten« und damit an diesem Punkt eine

Schwarzfärbung erzeugen. In einigen LCD-Displays befindet sich hinter dem LCD-Schirm eine Elektrolumineszenzplatte zu seiner Beleuchtung. Andere Typen von LCD-Displays können auch Farbe wiedergeben.

LED

Abkürzung für »Light-Emitting Diode« Eine Halbleiterdiode, die elektrische Energie in Licht umwandelt. LEDs arbeiten nach dem Prinzip der Elektrolumineszenz und weisen einen hohen Wirkungsgrad auf, da sie, bezogen auf die Menge des abgestrahlten Lichts, wenig Wärme erzeugen. Beispielsweise handelt es sich bei den »Betriebsanzeigen« an Diskettenlaufwerken um Leuchtdioden.

М

MB

Megabyte (1 MB = 220 bzw. 1.048.576 Bytes)

Mikroprozessor

Hochintegrierte Schaltung mit der Funktionalität der CPU eines Computersystems, die in der Regel auf einem Chip untergebracht ist. Sie besteht im wesentlichen aus Steuerwerk, Rechenwerk, mehreren Registern und einem Verbindungssystem zur Anbindung von Speicher- und Peripheriekomponenten. Wesentliche Leistungsmerkmale sind interne und externe Datenbus- und Adressbusbreite, Befehlssatz und Taktfrequenz. Darüber hinaus ist zwischen CISC- und RISC-Prozessoren zu unterscheiden. Der weltweit erste kommerziell verfügbare Mikroprozessor war der Intel 4004. Er kam 1971 auf den Markt.

MIPS

Million Instructions Per Second > Eine Million Befehle je Sekunde (Maß für die Arbeitsgeschwindigkeit von Rechnern).

MTBF

Abkürzung für »Mean Time Between Failure« Die durchschnittliche Zeit, gewöhnlich ausgedrückt in Tausenden oder Zehntausenden von Stunden (manchmal als power-on hours oder POH bezeichnet), die wahrscheinlich vergehen wird, bevor eine Hardwarekomponente ausfällt und eine Instandsetzung erforderlich wird.

MTC

Abkürzung für »Maintenance Controller« Der MTC ist ein eigenständiges Prozessorsystem, das zusätzliche Funktionen, die in einem "normalen" PC nicht vorhanden sind, bei einem B&R Industrie PC zur Verfügung stellt. Der MTC kommuniziert mit dem B&R Industrie PC über den ISA-Bus (mittels Koppelregister).

MTCX

Abkürzung für »Maintenance Controller EXtended«

0

OEM

Original Equipment Manufacturer; Unternehmen, das fremd- und eigengefertigte Komponenten in das eigene Erzeugnissortiment integriert und diese Produkte unter eigenem Namen vertreibt.

Р

Panel

Ist ein Sammelbegriff für die B&R Displayeinheiten (mit und ohne Tasten).

POH

Abkürzung für »Power On Hours« siehe MTBF.

POST

Abkürzung für »Power - On Self Test« Ein Satz von Routinen, die im Nur-Lese-Speicher (ROM) des Computers abgelegt sind und verschiedene Systemkomponenten testen, z.B. den RAM, die Diskettenlaufwerke und die Tastatur, um deren ordnungsgemäße Verbindung und Betriebsbereitschaft festzustellen. Bei auftauchenden Problemen alarmieren die POST-Routinen den Benutzer durch mehrere Signaltöne oder Anzeigen einer häufig von einem Diagnosewert begleiteten Meldung auf der Standardausgabe oder dem Standardfehlergerät (in der Regel dem Bildschirm). Verläuft der Post erfolgreich, geht die Steuerung an den Urlader des Systems über.

R

RAM

Abkürzung für »Random Access Memory« (Speicher mit wahlfreiem Zugriff). Ein Halbleiterspeicher, der vom Mikroprozessor oder anderen Hardwarebausteinen gelesen und beschrieben werden kann. Auf die Speicherorte lässt sich in jeder beliebigen Reihenfolge zugreifen. Zwar erlauben auch die verschiedenen ROM-Speichertypen einen wahlfreien Zugriff, diese können aber nicht beschrieben werden. Unter dem Begriff RAM versteht man dagegen im allgemeinen einen flüchtigen Speicher, der sowohl gelesen als auch beschrieben werden kann.

ROM

Abkürzung für »Read-Only Memory«, zu deutsch »Nur-Lese-Speicher« Ein Halbleiterspeicher, in dem bereits während der Herstellung Programme oder Daten dauerhaft abgelegt werden.

RS232

Recommended Standard Number 232 (älteste und am weitesten verbreitete Schnittstellen-Norm, auch V.24-Schnittstelle genannt; alle Signale sind auf Masse bezogen, so dass es sich um eine erdunsymmetrische Schnittstelle handelt. High-Pegel: -3 ... -30 V, Low-Pegel: +3 ... +30 V; zulässige Kabellänge bis 15 m, Übertragungsraten bis 20 kbit/s; für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen 2 Teilnehmern.

RXD

Abkürzung für »Receive (**RX**) **D**ata« Eine Leitung für die Übertragung der empfangenen, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen - z.B. von einem Modem zu einem Computer. Bei Verbindungen nach der Norm RS-232-C wird RXD auf den Anschluss 3 des Steckverbinders geführt.



Schnittstelle

(Aus Sicht der Hardware kennzeichnet eine Schnittstelle/Interface die Verbindungsstelle zweier Baugruppen/Geräte/Systeme. Die beiderseits der Schnittstelle liegenden Einheiten sind über Schnittstellenleitungen miteinander verbunden, über die Daten, Adressen und Steuersignale ausgetauscht werden. Der Begriff Schnittstelle/Interface umfasst dabei die Gesamtheit der funktionellen, elektrischen und konstruktiven Bedingungen [Kodierung, Signalpegel, Steckerbelegung], welche die Verbindungsstelle zwischen den Baugruppen, Geräten bzw. Systemen charakterisiert. Je nach Art der Datenübertragung ist zwischen parallelen [z.B. Centronics, IEEE 488] und seriellen Schnittstellen [z.B. V.24, TTY, RS232, RS422, RS485] zu unterscheiden, die für unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten und Übertragungsentfernungen ausgelegt sind. Softwaremäßig gesehen bezeichnet der Begriff Schnittstelle/Interface den Übergang an der Grenze zwischen Programmbausteinen mit den dafür vereinbarten Regeln für die Übergabe von Programmdaten).

SDRAM

Abkürzung für »Synchronic Dynamic Random Access Memory« Eine Bauform dynamischer Halbleiterbausteine (DRAM), die mit höheren Taktraten betrieben werden kann als konventionelle DRAM-Schaltkreise. Dies wird durch Blockzugriffe ermöglicht, bei denen das DRAM jeweils die Adresse der nächsten anzusprechenden Speicheradresse angibt.

SVGA

Abkürzung für »Super Video Graphics Array« Grafikstandard mit einer Auflösung von mindestens 800x600 Bildpunkten [Pixels] und mindestens 256 Farben.

SXGA

Abkürzung für Super Extended Graphics Array. Grafikstandard mit einer Bildauflösung von 1280 × 1024 Bildpunkten (Seitenverhältnis 5:4).



TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Suit of Protocols (Netzwerkprotokoll, allgemein aner-kannter Standard für den Datenaustausch in heterogenen Netzen. TCP/IP wird sowohl in lokalen Netzen zur Kommunikation verschiedenartiger Rechner untereinander als auch für den Zugang von LAN zu WAN eingesetzt.

TFT-Display

Technik bei Flüssigkristall-Displays (LCD), bei der sich das Display aus einem großen Raster von LCD-Zellen zusammensetzt. Jedes Pixel wird durch eine Zelle dargestellt, wobei die in den Zellen erzeugten elektrischen Felder durch Dünnfilmtransistoren (thin-film transistor, TFT) unterstützt werden (daher auch »aktive Matrix«) - in der einfachsten Form durch genau einen Dünnfilmtransistor pro Zelle. Displays mit aktiver Matrix werden hauptsächlich in Laptops und Notebooks eingesetzt, da sie eine geringe Dicke aufweisen, hochqualitative Farbdarstellungen bieten und das Display aus allen Blickwinkeln gut erkennbar ist.

Touch Screen

Bildschirm mit Berührungssensoren zur Aktivierung eines angebotenen Menüs durch Antippen mit dem Finger.

TXD

Abkürzung für »Transmit (**TX**) **D**ata« Eine Leitung für die Übertragung der gesendeten, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen - z.B. von einem Computer zu einem Modem. Bei Verbindungen nach dem Standard RS-232-C wird TXD auf den Anschluss 2 des Steckverbinders geführt.

U

UART

Abkürzung für »Universal Asynchronous Receiver-Transmitter« (»universeller asynchroner Sende- und Empfangsbaustein«) Ein meist nur aus einem einzelnen integrierten Schaltkreis bestehendes Modul, das die erforderlichen Schaltungen für die asynchrone serielle Kommunikation sowohl zum Senden als auch zum Empfangen vereinigt. In Modems für den Anschluss an Personalcomputer stellt der UART den gebräuchlichsten Schaltkreistyp dar.

USB

Abkürzung für »Universal Serial Bus« (Universeller, serieller Bus) Ein serieller Bus mit einer Bandbreite von bis zu 12 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Mikrocomputer. Über den USB-Bus können an das System über einen einzelnen Mehrzweckanschluss bis zu 127 Geräte angeschlossen werden, z.B. externe CD-Laufwerke, Drukker, Modems sowie Maus und Tastatur. Dies wird durch Hintereinanderreihen der Geräte realisiert. USB ermöglicht einen Gerätewechsel bei eingeschalteter Stromversorgung (»Hot Plugging«) und mehrfach überlagerte Datenströme.

UXGA

Ist die Abkürzung für »**U**ltra **E**xtended **G**raphics **A**rray« Üblicherweise eine Bildauflösung von 1600 × 1200 Bildpunkten (Seitenverhältnis 4:3, 12:9).



VGA

Abkürzung für »Video Graphics Adapter« Ein Video-Adapter, der alle Video-Modi des EGA (Enhanced Graphics Adapter) beherrscht und mehrere neue Modi hinzufügt.



Windows CE

Kompaktes 32-Bit-Betriebssystem mit Multitasking und Multithreading, das die Firma Microsoft speziell für den OEM-Markt entwickelt hat. Es ist auf unterschiedliche Prozessortypen portierbar und hat hohe Echtzeitfähigkeit. Die Entwicklungsumgebung verwendet bewährte, weit verbreitete Entwicklungswerkzeuge. Es ist eine offene und skalierbare Windows-Betriebssystem-Plattform für eine Vielzahl von Geräten. Beispiele für solche Geräte sind Handheld-PCs, digitale Funkrufempfänger, intelligente Handys, Multimediakonsolen u.ä. In embedded systems ist Windows CE hervorragend auch für den Einsatz in der Automatisierungstechnik geeignet.



XGA

Abkürzung für »eXtended Graphics Array« Ein erweiterter Standard für Grafik-Controller und die Bildschirmdarstellung, der 1990 von IBM eingeführt wurde. Dieser Standard unterstützt die Auflösung 640 * 480 mit 65.536 Farben oder die Auflösung 1024 * 768 mit 256 Farben. Dieser Standard wird hauptsächlich in Workstation-Systemen eingesetzt.

Tabelle 1:	Handbuchhistorie	13
Tabelle 2:	Gestaltung von Sicherheitshinweisen	17
Tabelle 3:	Bestellnummern Panel PC 300 Steckkarten	18
Tabelle 4:	Bestellnummern Automation Panel 10,4" VGA	18
Tabelle 5:	Bestellnummern Automation Panel 12,1" SXGA	18
Tabelle 6:	Bestellnummern Automation Panel 15" XGA	19
Tabelle 7:	Bestellnummern Automation Panel 17" SXGA	19
Tabelle 8:	Bestellnummern Automation Panel 19" SXGA	
Tabelle 9:	Bestellnummern Software	19
Tabelle 10:	Bestellnummern Zubehör	
Tabelle 11:	Umgebungstemperaturen in Abhängigkeit der Einbaulage	23
Tabelle 12:	Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten	24
Tabelle 13:	Leistungshaushalt in Abhängigkeit der Einbaulage	
Tabelle 14:	Ethernet Anschluss (ETH1)	
Tabelle 15:	Ethernet Anschluss (ETH2)	
Tabelle 16:	Technische Daten Status LEDs	
Tabelle 17:	Power Taster	
Tabelle 18:	Reset Taster	
Tabelle 19:	Pinbelegung COM	
Tabelle 20:	Technische Daten Batterie	
Tabelle 21:	USB Schnittstellen	
Tabelle 22:	Technische Daten 5PC310.L800-00	
Tabelle 23:	Technische Daten 5PC310.L800-01	
Tabelle 24:	Technische Daten 5AP920.1043-01	
Tabelle 25:	Lieferumfang 5AP920.1043-01	
Tabelle 26:	Technische Daten 5AP980.1043-01	
Tabelle 27:	Lieferumfang 5AP980.1043-01	47
Tabelle 28:	Technische Daten 5AP981.1043-01	
Tabelle 29:	Lieferumfang 5AP981.1043-01	
Tabelle 30:	Technische Daten 5AP982.1043-01	
Tabelle 31:	Lieferumfang 5AP982.1043-01	59
Tabelle 32:	Technische Daten 5AP920.1214-01	
Tabelle 33:	Lieferumfang 5AP920.1214-01	
Tabelle 34:	Technische Daten 5AP920.1505-01	
Tabelle 35:	Lieferumfang 5AP920.1505-01	
Tabelle 36:	Technische Daten 5AP980.1505-01	
Tabelle 37:	Lieferumfang 5AP980.1505-01 Technische Daten 5AP981.1505-01	
Tabelle 38:	Lieferumfang 5AP981.1505-01	
Tabelle 39:		
Tabelle 40:	Technische Daten 5AP920.1706-01	
Tabelle 41:	Lieferumfang 5AP920.1706-01 Technische Daten 5AP920.1906-01	
Tabelle 42:		
Tabelle 43: Tabelle 44:	Lieferumfang 5AP920.1906-01	
Tabelle 44:	Einbaulagen -45 ° und +45 °	
Tabelle 45:	Biosrelevante Tasten	
Tabelle 46.	Übersicht BIOS Hauptmenü Funktionen	
i abelle 47.	Obersion BIOS Hauptmenu Funktionen	12

Tabellenverzeichnis

Tabelle 48:	BIOS Motherboard Device Configuration Menü	115
Tabelle 49:	BIOS Drive Configuration Menü	116
Tabelle 50:	BIOS Super I/O Configuration Menü	118
Tabelle 51:	BIOS Video Configuration Menü	
Tabelle 52:	BIOS PCI Configuration Menü	120
Tabelle 53:	BIOS USB Configuration Menü	121
Tabelle 54:	BIOS Thermal Configuration Menü	
Tabelle 55:	BIOS Memory and Cache Optimization Menü	124
Tabelle 56:	System Clock/PLL Configuration	124
Tabelle 57:	BIOS Power Management Menü	125
Tabelle 58:	BIOS Device Information Menü	
Tabelle 59:	BIOS Miscellaneous Configuration Menü	
Tabelle 60:	BIOS Drive Configuration Menü	
Tabelle 61:	Motherboard Device Configuration Defaultwerte	
Tabelle 62:	Memory and Cache Optimization Defaultwerte	
Tabelle 63:	System Clock/PLL Configuration Defaultwerte	
Tabelle 64:	Power Management Defaultwerte	136
Tabelle 65:	Miscellaneous Configuation Defaultwerte	137
Tabelle 66:	Boot Order Defaultwerte	
Tabelle 67:	Bestellnummern Windows CE	
Tabelle 68:	Unterschiede der CE Versionen (Pro - ProPlus)	
Tabelle 69:	Bestellnummern Windows XP embedded	143
Tabelle 70:	Gerätefunktionen unter Windows XP embedded mit FP2007	
Tabelle 71:	Normenübersicht	
Tabelle 72:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Emission	
Tabelle 73:	Prüfanforderung netzgebundene Emission Industriebereich	
Tabelle 74:	: Prüfanforderung Elektromagnetische Strahlung Industriebereich	
Tabelle 75:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Immunität	
Tabelle 76:	Prüfanforderung elektrostatische Entladung (ESD)	
Tabelle 77:	Prüfanforderung hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)	
Tabelle 78:	Prüfanforderung schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)	
Tabelle 79:	Prüfanforderung Stoßspannungen (Surge)	
Tabelle 80:	Prüfanforderung leitungsgeführte Störgrößen	
Tabelle 81:	Prüfanforderung Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen	
Tabelle 82:	Prüfanforderung Spannungseinbrüche, -schwankungen und Kurzzeitunte	
T	chungen	
Tabelle 83:	Prüfanforderung gedämpfte Schwingungen	
Tabelle 84:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Vibration	
Tabelle 85:	Prüfanforderung Vibration Betrieb	
Tabelle 86:	Prüfanforderung Vibration Transport (verpackt)	
Tabelle 87:	Prüfanforderung Schock Betrieb	
Tabelle 88:	Prüfanforderung Schock Transport	
Tabelle 89:	Prüfanforderung Kippfallen	
Tabelle 90:	Prüfanforderung Kippfallen	
Tabelle 91:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Temperatur und Fe 159	
Tabelle 92:	Prüfanforderung Worst Case Betrieb	159

Tabelle 93:	Prüfanforderung trockene Wärme	. 159
Tabelle 94:	Prüfanforderung trockene Kälte	
Tabelle 95:	Prüfanforderung große Temperaturschwankungen	. 160
Tabelle 96:	Prüfanforderung Temperaturschwankungen im Betrieb	. 160
Tabelle 97:	Prüfanforderung Feuchte Wärme zyklisch	
Tabelle 98:	Prüfanforderung Feuchte Wärme konstant (Lager)	
Tabelle 99:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Sicherheit	. 161
Tabelle 100:	Prüfanforderung Erdungswiderstand	. 161
Tabelle 101:	Prüfanforderung Hochspannung	. 162
	Prüfanforderung Restspannung	
	Prüfanforderung Ableitstrom	
	Prüfanforderung Überlast	
	Prüfanforderung Bauteildefekt	
	Prüfanforderung Spannungsbereich	
Tabelle 107:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen sonstige Prüfungen	. 164
	Prüfanforderung Schutzart	
	Prüfanforderung Verschmutzungsgrad	
	Internationale Zulassungen	
Tabelle 111:	Bestellnummern Zubehör	. 167
	TB103 Bestelldaten	
	TB103 Versorgungsstecker Technische Daten	
	Lithium Batterie Bestelldaten	
	Lithium Batterien Technische Daten	
Tabelle 116:	Einschubstreifenvordrucke Bestelldaten	. 173
	USB Schnittstellenabdeckung (unverlierbar) Bestelldaten	
	Bestelldaten USB Memory Sticks	
	Technische Daten USB Memory Stick - 5MMUSB.2048-00	
	Lieferumfang USB Memory Sticks 5MMUSB.2048-00	
	Technische Daten USB Media Drive 5MD900.USB2-01	
	Lieferumfang USB Media Drive 5MD900.USB2-01	
	Technische Daten - 5A5003.03	
	CompactFlash Karten Bestelldaten	
	Technische Daten CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	
Tabelle 126:	Technische Daten Elo Accu Touch Screen 5 Draht	. 209
Tabelle 127	Chemische Beständigkeit der Dekorfolie	212

Tabellenverzeichnis

Abbildung 1:	Panel PC 300 Einschub	21
Abbildung 2:	PPC300 montiert im AP900	22
Abbildung 3:	Gesamtgerät - PPC300 und AP900	23
Abbildung 4:	Spannungsversorgungsanschluss	
Abbildung 5:	CompactFlash Slot	
Abbildung 6:	AP Slide-In PC 5PC310.L800-00	
Abbildung 7:	AP Slide-In PC 5PC310.L800-01	
Abbildung 8:	Vorderansicht 5AP920.1043-01	
Abbildung 9:	Rückansicht 5AP920.1043-01	
Abbildung 10:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1043-01	
Abbildung 11:	Abmessungen 5AP920.1043-01	
Abbildung 12:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1043-01	
Abbildung 13:	Vorderansicht 5AP980.1043-01	
Abbildung 14:	Rückansicht 5AP980.1043-01	
Abbildung 15:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP980.1043-01	
Abbildung 16:	Abmessungen 5AP980.1043-01	
Abbildung 17:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP980.1043-01	
Abbildung 18:	Vorderansicht 5AP981.1043-01	
Abbildung 19:	Rückansicht 5AP981.1043-01	
Abbildung 20:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP981.1043-01	
Abbildung 21:	Abmessungen 5AP981.1043-01	
Abbildung 22:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP981.1043-01	
Abbildung 23:	Vorderansicht 5AP982.1043-01	
Abbildung 24:	Rückansicht 5AP982.1043-01	
Abbildung 25:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP982.1043-01	
Abbildung 26:	Abmessungen 5AP982.1043-01	59
Abbildung 27:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP982.1043-01	
Abbildung 28:	Vorderansicht 5AP920.1214-01	
Abbildung 29:	Rückansicht 5AP920.1214-01	
Abbildung 30:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1214-01	
Abbildung 31:	Abmessungen 5AP920.1214-01	
Abbildung 32:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1214-01	
Abbildung 33:	Vorderansicht 5AP920.1505-01	
Abbildung 34:	Rückansicht 5AP920.1505-01	
Abbildung 35:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1505-01	
Abbildung 36:	Abmessungen 5AP920.1505-01	
Abbildung 37:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1505-01	
Abbildung 38:	Vorderansicht 5AP980.1505-01	
Abbildung 39:	Rückansicht 5AP980.1505-01	
Abbildung 40:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP980.1505-01	
Abbildung 41:	Abmessungen 5AP980.1505-01	
Abbildung 42:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP980.1505-01	
Abbildung 43:	Vorderansicht 5AP981.1505-01	
Abbildung 44:	Rückansicht 5AP981.1505-01	
Abbildung 45:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP981.1505-01	
Abbildung 46:	Abmessungen 5AP981.1505-01	
Abbildung 47:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP981.1505-01	84

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 48:	Vorderansicht 5AP920.1706-01	
Abbildung 49:	Rückansicht 5AP920.1706-01	85
Abbildung 50:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1706-01	88
Abbildung 51:	Abmessungen 5AP920.1706-01	89
Abbildung 52:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1706-01	
Abbildung 53:	Vorderansicht 5AP920.1906-01	91
Abbildung 54:	Rückansicht 5AP920.1906-01	91
Abbildung 55:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 5AP920.1906-01	94
Abbildung 56:	Abmessungen 5AP920.1906-01	95
Abbildung 57:	Einbau in Wanddurchbrüche 5AP920.1906-01	96
Abbildung 58:	PPC300 Montage im AP900	97
Abbildung 59:	PPC300 im AP900 fixieren	98
Abbildung 60:	Klemmblöcke	99
Abbildung 61:	Kabelschellenfixierung	102
Abbildung 62:	Funktionserdelasche	
Abbildung 63:	Beispiel - Hardwarenummer im B&R Key Editor bzw. im B&R Control 103	
Abbildung 64:	Darstellung - Tasten und LEDs in der Matrix	103
Abbildung 65:	Hardwarenummern - 5AP981.1043-01	
Abbildung 66:	Hardwarenummern - 5AP982.1043-01	
Abbildung 67:	Hardwarenummern - 5AP980.1043-01	
Abbildung 68:	Hardwarenummern - 5AP981.1505-01	
Abbildung 69:	Hardwarenummern - 5AP980.1505-01	
Abbildung 70:	Summary Screen	
Abbildung 71:	Main Menu	
Abbildung 72:	Time	
Abbildung 73:	Date	
Abbildung 74:	Motherboard Device Configuration	
Abbildung 75:	Motherboard Device Configuration - Drive Configuration	
Abbildung 76:	Motherboard Device Configuration - I/O Configuration	
Abbildung 77:	Motherboard Device Configuration - Video and Flat Configuration	
Abbildung 78:	Motherboard Device Configuration - PCI Configuration	
Abbildung 79:	Motherboard Device Configuration - USB Configuration	121
Abbildung 80:	Motherboard Device Configuration - Thermal Configuration	
Abbildung 81:	Memory and Cache Optimization	
Abbildung 82:	System Clock/PLL Configuration	
Abbildung 83:	Power Management	
Abbildung 84:	Device Information	
Abbildung 85:	Miscellaneous Configuration	
Abbildung 86:	Boot Order	
Abbildung 87:	Load Defaults	
Abbildung 88:	Save Values Without Exit	
Abbildung 89:	Exit Without Save	
Abbildung 90:	Save values and Exit	
Abbildung 91:	Windows CE Logo	
Abbildung 92:	Windows XP embedded Logo	
Abbildung 93:	ADI Control Center Screenshots PPC300 (Version 1.10) - Beispiel	145

Abbildung 94:	Einschubstreifenbeispiele	172
	Frontseitige USB Schnittstellenabdeckung - Montage	
	Temperatur Luftfeuchtediagramm USB Memory Stick - 5MMUSB.2048-00	
	USB Media Drive - 5MD900.USB2-01	
	Abmessungen - 5MD900.USB2-01	
	Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe	
Abbildung 100:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe	183
	Schnittstellen - 5MD900.USB2-01	
Abbildung 102:	Einbaulage - 5MD900.USB2-01	184
Abbildung 103:	Frontklappe 5A5003.03	185
Abbildung 104:	Abmessung - 5A5003.03	185
Abbildung 105:	Frontklappenmontage und Klemmdicke	186
	Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten - 5CFCRD.xxxx-0	
	189	
Abbildung 107:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I	189
Abbildung 108:	Silicon Systems White Paper - Seite 1 von 9	190
Abbildung 109:	Silicon Systems White Paper - Seite 2 von 9	191
Abbildung 110:	Silicon Systems White Paper - Seite 3 von 9	192
Abbildung 111:	Silicon Systems White Paper - Seite 4 von 9	193
Abbildung 112:	Silicon Systems White Paper - Seite 5 von 9	194
Abbildung 113:	Silicon Systems White Paper - Seite 6 von 9	195
Abbildung 114:	Silicon Systems White Paper - Seite 7 von 9	196
Abbildung 115:	Silicon Systems White Paper - Seite 8 von 9	197
Abbildung 116:	Silicon Systems White Paper - Seite 9 von 9	198
Abbildung 117:	Panel PC 300 Einschub entfernen	199
Abbildung 118:	Batteriehandhabung	199
Abbildung 119:	Batteriepolarität	200
Abbildung 120:	Warnhinweis - Austausch der Leuchtstofflampen	202
Abbildung 121:	Demontage der Abdeckhaube	203
Abbildung 122:	Automation Panel 10,4" - Schrauben und Stecker lösen	204
	Automation Panel 10,4" - Leuchtstoffröhre tauschen	
Abbildung 124:	Automation Panel 12,1" - Schrauben und Stecker lösen	205
Abbildung 125:	Automation Panel 12,1" - Leuchtstoffröhre tauschen	205
Abbildung 126:	Automation Panel 15" - Schrauben und Stecker lösen	206
Abbildung 127:	Automation Panel 15" - Demontage der Abdeckhaube und Stecker lösen	206
	Automation Panel 15" - Leuchtstofflampen tauschen	
Abbildung 129:	Temperatur Luftfeuchtediagramm Elo Accu Touch Screen	210
Abbildung 130:	Blickwinkel	213
	B&R Key Editor Screenshots (Version 2.70)	
Abbildung 132:	ADI Development Kit Screenshots (Version 2.20)	216

Abbildungsverzeichnis

Bestellnummernindex

Bestellnummernindex

5AP920.1906-01......19, 91 0 5AP980.1043-01...... 18, 43, 106 0AC201.9.....20, 31, 167, 171 0TB103.920, 167, 169 5AP981.1043-01...... 18, 49, 104 0TB103.9120, 167, 169 5AP981.1505-01.......19, 79, 107 5AP982.1043-01...... 18, 55, 105 5CFCRD.0064-03......20, 167, 187 4 5CFCRD.0128-03......20, 167, 187 5CFCRD.0256-03.......20, 167, 187 4A0006.00-00020, 31, 167, 171 5CFCRD.0512-03.......20, 167, 187 5CFCRD.1024-03.......20, 167, 187 5 5CFCRD.2048-03.......20, 168, 187 5CFCRD.4096-03......20, 168, 187 5A5003.03185 5CFCRD.8192-03.......20, 168, 187 5AC900.104X-0320, 167, 173 5MD900.USB2-0120, 167, 179 5MMUSB.2048-00 20, 167, 175 5AC900.104X-0520, 167, 173 5PC310.L800-0018, 33 5AC900.1200-00......20, 167, 174 5PC310.L800-0118, 35 5AC900.150X-0120, 167, 173 5SWWCE.0523-ENG19, 141 5AP920.1043-01.......18, 37 5SWWCE.0623-ENG19, 141 5AP920.1214-01.......18, 61 5SWWXP.0423-ENG......19, 143

Bestellnummernindex

Α		CMOS	219
		CMOS Batterie	171
Ableitwiderstand	34, 36	COM	34, 36, 219
Abmessungen		COM Schnittstelle	29
5AP920.1043-01		CompactFlash	187, 219
5AP920.1214-01	65	Abmessungen	189
5AP920.1505-01	71	Allgemeines	187
5AP920.1706-01	89	Bestelldaten	187
5AP920.1906-01	95	Technische Daten	188
5AP980.1043-01	47	CompactFlash Slot	30
5AP980.1505-01	77	Control Center	145
5AP981.1043-01	53	CPU	220
5AP981.1505-01	83	CTS	220
5AP982.1043-01	59		
ACPI	218	D	
After-Images	201	D	
Anhang A	209	Datenverlust	28 29
Anzugsmoment	99	DCD	•
API	218	Dekorfolie	
ATX Netzteil	28	Derating 40, 46, 52, 58, 64, 70	
Austausch der Leuchtstofflampen	202	Display-Memory Effekt	
Automation Device Interface	145	DMA	
		DRAM	_
В		DSR	_
Ь		DTR	-
B&R Control Center	145		
B&R eMbedded OS Installer		_	
Batterie		E	
Batteriestatus	,	Eahtzoit	221
Baudrate		Echtzeit Echtzeituhr	
Bestellnummern		EDID	
Automation Panel 10,4" VGA			
Automation Panel 12,1" SXGA		Einbaulage + 45°	
Automation Panel 15" XGA		0 °	
Automation Panel 17" SXGA		bis - 45°	
Automation Panel 19" SXGA		Einbrenneffekt	
Zubehör			
BIOS		Einschubstreifen	
BIOS Upgrade and Utilities		Einschubstreifenvordrucke	
Bit		Einzelkomponenten	
Bitrate		Automation Panel 900	
Byte	_	Elo Accu Touch	
Dyto		eMbedded OS Installer	142
		EN 43 /	~~ .
		EMV	
С		EPROM	221
	040	EPROM	221 27
CacheCE-Kennzeichnung		EPROM	221 27

Stichwortverzeichnis

Einzelbauteile15	L	
Elektrische Baugruppen mit Gehäuse14	100	000
Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse .14	LCD	
Gerechte Handhabung14	LED	
Verpackung14	Leistungsverbrauch	
ETH126, 34, 35	Leuchtstofflampen	202
ETH226, 34, 36	Lieferumfang	
Ethernet221	5AP920.1043-01	
Ethernet 134, 35	5AP920.1214-01	
Ethernet 234, 36	5AP920.1505-01	
Ethernetanschluss26	5AP920.1706-01	
	5AP920.1906-01	
F	5AP980.1043-01	
•	5AP980.1505-01	
Federzugklemme27	5AP981.1043-01	
Feldklemme169	5AP981.1505-01	83
FIFO221	5AP982.1043-01	59
Firmware	Lithiumbatterie	31
Fixierschrauben34, 36	Luftfeuchtigkeit	24
Floppy222	Luftzirkulation	99
Freiraum99		
Frontklappe185	М	
Funktionserde	IVI	
1 41111101100100	MB	223
•	MDMA	
G	Mikroprozessor	
000	MIPS	
GB222	Montage	
Gewicht34, 36	Vorschriften	ga
	Motherboard	
Н	MTBF	_
	MTC	
Handbuchhistorie13	MTCX	_
Handshake222	WTOX20, 29,	220
Hibernate28		
Hutschienenwinkel179	N	
I	Netzgebundene Emission	
1	Normen	147
IDE222		
Image Retention201	0	
Image Sticking201	•	
inage Sticking201	OEM	224
V		
K	Р	
Key Editor103, 214	•	
Klemmblock	Panel	224

PIO 30 POH 224 POST 224 Power 28 Power Taster 28, 34, 36 pre calibration 210 Prozessor 33, 35 Pufferbatterie 31 Pufferdauer 31 Pufferzeit 34, 35 PXE 27	Software 19 Spannungsversorgung 27, 34, 36 Spannungsversorgungsstecker 169 Speicher 33, 35 Status LED 28 CF 28 Power 28 User 28 Suspend-to-Disk 28 SUXGA 225 SVGA 225 SXGA 225
R	Т
RAM224	1
Reinigung211	TCP/IP225
Touch Screen211	Technische Daten
Reset Taster29, 34, 36	5AP920.1043-0138
Richtlinien17	5AP920.1505-0162, 68
ROM224	5AP920.1706-0186
RS232224	5AP920.1906-0192
RTC31, 33, 35	5AP980.1043-0144
RXD225	5AP980.1505-0174
	5AP981.1043-0150
S	5AP981.1505-0180
3	5AP982.1043-0156
Schnittstelle225	Feldklemme170
Schnittstellenabdeckung174	Gesamtgerät23
Schraubklemme27	Leistungsverbrauch25
SDRAM225	Luftfeuchtigkeit24
Selbstentladung31	Umgebungstemperatur23
Serielle Schnittstelle29, 34, 36	TFT-Display226
Sicherheitshinweise14	Thermik101
Berühren elektrischer Teile16	Touch Screen209, 226
Bestimmungsgemäße Verwendung14	Touchkalibrierung
Betrieb16	Windows CE210
Gestaltung17	Windows XP embedded210
Montage16	TXD226
Programme17	
Schutz vor elektrostatischen Entladungen .	U
14	•
Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase 16	UART226
Transport und Lagerung15	UDMA30
Viren17	Umgebungstemperatur23
Vorschriften und Maßnahmen15	USB226
Soft-off28	Schnittstellenabdeckung174

Stichwortverzeichnis

USB Media Drive179	5AP920.1505-01	72
Abmessungen182	5AP920.1706-01	90
Abmessungen mit Frontklappe183	5AP920.1906-01	96
Einbaulagen184	5AP980.1043-01	48
Montage184	5AP980.1505-01	78
Schnittstellen184	5AP981.1043-01	54
Technische Daten180	5AP981.1505-01	84
USB Memory Stick	5AP982.1043-01	60
Allgemeines175	Windows CE	227
Bestelldaten175	Allgemeines	14 ⁻
Technische Daten176	eMbedded OS Installer	142
USB Schnittstelle34, 36	Windows XP Embedded	143
UXGA226	AllgemeinesInstallation	140 144
V		
Verschleißteil31, 202	X	
VGA227	XGA	227
W	Z	
Wanddurchbruch	Zubehör	167
5AP920.1043-01	Zulassungen	16